MAXIMUS VII IMPACT

用 户 手 册

Motherboard

C9439

1.00 版

2014 年 8 月发行

版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到着作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 http://www.asus.com.cn/support，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

（1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

（2）本产品序号模糊不清或丢失。

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上，版本数字的编码方式是用三个数字组成，并有一个小数点做间隔，如 1.02G、2.03G 等...数字越大表示版本越新，而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕联络。

请用剪刀沿虚线剪下

三年质保　　ASUS　　全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。

保修说明注意事项：

一、 请将此质量保证卡下方的用户数据填写完整，并由最终直接经销商加盖印章，如果没有加盖印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将以产品的出厂日期为参照进行保修。

二、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。

三、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行全国联保服务。注：

A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。

B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送修至原购买经销商处享受保修服务。

四、 若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权利收取维修费用：

A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。

B. 因遇不可抗拒外力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。

C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。

D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、更改组件、修改线路等。

E. 因用户自行安装软件即设置不当所造成之使用问题及故障。

F. 本公司产品序列号标贴撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。

G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。

五、 技术支持及维修服务：

1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站（http://vip.asus.com），对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术数据；

2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；

3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面（http://www.asus.com.cn/support）查询到相应的技术支持信息与常见问题排除；

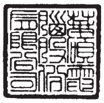
4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询（http://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm/TechQuery）；

5. 也欢迎您拨打华硕海星服务 7x24 小时免费技术支持专线 400-620-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；

6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。

7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必要明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写数据

用户名称		购买日期	
联系人		联系电话	
联系地址			
经销商名称		产品种类	
产品型号		产品序列号	
	经销商印章		

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

Google™ License Terms

Copyright© 2014 Google Inc. All Rights Reserved

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

目录内容

华硕产品质量保证卡 iii
安全性须知 ix
关于这本用户手册 xi
MAXIMUS VII IMPACT 规格列表 xiv
产品包装 xviii
创建 PC 系统所需的其他工具与元件 xix

第一章：产品介绍

1.1 特殊功能 1-1
1.1.1 产品特写 1-1
1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能 1-2
1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能 1-3
1.1.4 华硕独家功能 1-4
1.1.5 ROG 搭配软件 1-5
1.2 主板概述 1-6
1.2.1 主板安装前 1-6
1.2.2 主板结构图 1-7
1.2.3 中央处理器（CPU） 1-9
1.2.4 系统内存 1-10
1.2.5 扩展插槽 1-23
1.2.6 主板上的内置按钮与开关 1-25
1.2.7 内置 LED 指示灯 1-27
1.2.9 内部连接端口 1-35
1.2.9 ProbeIt（探针）功能 1-44
1.2.10 SupremeFX Impact II 声卡 1-45

第二章：硬件设备信息

2.1 创建您的电脑系统 2-1
2.1.1 安装主板 2-1
2.1.2 安装中央处理器 2-3
2.1.3 安装 SupremeFX Impact II 声卡 2-4
2.1.4 安装内存条 2-5
2.1.5 处理器散热片与风扇安装 2-6
2.1.6 安装 ATX 电源 2-9
2.1.7 安装 SATA 设备 2-10
2.1.8 安装前面板输出/输入连接端口 2-11
2.1.9 安装扩展卡 2-12
2.1.10 安装 Impact CoolHub 扩展卡 2-12
2.1.11 安装 mPCIe Combo IV 扩展卡 2-13
2.2 BIOS 更新应用程序 2-17
2.2.1 USB BIOS Flashback 2-17
2.3 主板后侧与音频连接端口 2-18
2.3.1 后侧面板连接端口 2-18

目录内容

2.3.2 音频输出/输入连接图标说明 2-20
2.4 第一次启动电脑 2-23
2.5 关闭电源 2-23

第三章：BIOS 程序设置

3.1 认识 BIOS 程序 3-1
3.2 BIOS 程序设置 3-2
3.2.1 EZ Mode 3-3
3.2.2 Advanced Mode 3-4
3.2.3 Q-Fan Control 3-7
3.2.4 EZ Tuning 向导 3-9
3.3 我的最爱（My Favorites）菜单 3-11
3.4 Extreme Tweaker 菜单 3-13
3.5 主菜单（Main Menu） 3-34
3.6 高级菜单（Advanced menu） 3-36
3.6.1 处理器设置（CPU Configuration） 3-37
3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration） 3-40
3.6.3 PCH 存储设备设置（PCH Storage Configuration） 3-42
3.6.4 系统代理设置（System Agent Configuration） 3-44
3.6.5 USB 设备设置（USB Configuration） 3-46
3.6.6 平台各项设置（Platform Misc Configuration） 3-47
3.6.7 内置设备设置（OnBoard Devices Configuration） 3-49
3.6.8 高级电源管理设置（APM Configuration） 3-51
3.6.9 网络协定堆栈（Network Stack） 3-52
3.6.10 ROG Effects 3-52
3.6.11 Intel(R) Rapid Storage Technology 3-53
3.7 监控菜单（Monitor menu） 3-54
3.8 启动菜单（Boot menu） 3-57
3.9 工具菜单（Tool menu） 3-63
3.9.1 ASUS EZ Flash 2 3-63
3.9.2 Secure Erase 3-63
3.9.3 显卡信息（Graphics Card Information） 3-64
3.9.4 ASUS Overclocking Profile 3-65
3.9.5 ASUS SPD Information 3-66
3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure 3-66
3.10 退出 BIOS 程序（Exit menu） 3-68
3.11 更新 BIOS 程序 3-69
3.11.1 EZ Update 3-69
3.11.2 华硕 EZ Flash 2 3-70
3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3 3-71
3.11.4 华硕 BIOS Updater 3-72

第四章：软件支持

目录内容

4.1 安装操作系统 4-1
4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息 4-1
4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘 4-1
4.2.2 取得软件用户手册 4-2
4.3 软件信息 4-3
4.4 华硕 AI Suite 3 程序 4-3
4.4.1 第五代双智能处理器 4-7
4.4.2 华硕 USB 3.0 Boost 程序 4-19
4.4.3 USB BIOS Flashback 向导 4-20
4.4.4 USB Charger+ 4-22
4.4.5 Wi-Fi Engine 4-23
4.4.6 EZ Update 4-25
4.4.7 推播信息（Push Notice） 4-27
4.4.8 系统信息 4-30
4.5 Wi-Fi GO! 4-32
4.5.1 登入华硕帐号 4-33
4.5.2 使用 Wi-Fi GO! 4-35
4.6 ASUS Media Streamer 4-44
4.6.1 系统需求 4-44
4.6.2 使用 ASUS Media Streamer 4-45
4.7 ROG 音频功能 4-46
4.7.1 Sonic Studio 4-46
4.7.2 Sonic SenseAmp 4-48
4.7.3 Sonic SoundStage 4-50
4.8 Sonic Radar II 4-52
4.9 GameFirst III 4-54
4.10 KeyBot 4-57
4.11 MemTweakIt 4-59
4.12 RAMDisk 4-61
4.13 ROG CPU-Z 4-64

第五章：RAID 支持

5.1 RAID 功能设置 5-1
5.1.1 RAID 定义 5-1
5.1.2 安装 Serial ATA（SATA）硬盘 5-2
5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID 5-2
5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序 5-3
5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘 5-7
5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘 5-7
5.2.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘 5-8
5.2.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序 5-8

附录

华硕的联络信息 A-1

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要卸除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的数据线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡之前，我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

REACH 信息

注意：谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm。

请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

产品回收与处理

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合，以保护我们的环境，确保工作者的安全，以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备，通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收信息与联络方式，请连线上网至 CSR（Corporate Social Responsibility）网页：http://csr.asus.com/english/Takeback.htm。

警语

经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自更改频率、加大功率或更改原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信，指依电信法规定操作之无线通信。

低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

射频（RF）设备须知

NCC: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装本主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：

- 第一章：产品介绍

  您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握本主板的各项特性，当然，在本章节中我们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

- 第二章：硬件设备信息

  本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有：处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

- 第三章：BIOS 程序设置

  本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

- 第四章：软件支持

  您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

- 第五章：RAID 支持

  本章节介绍 RAID 的各项设置。

- 附录

  在本附录里将列出相关的联络信息与认证信息。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

小心：提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。

重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。

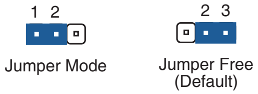
注意：提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套，里面有金属导线，可以套住选择区的任二只针脚（Pin）使其相连而成一通路（短路），本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置，兹利用以下图标说明。以下图为例，欲设置为「Jumper™ Mode」，需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽，本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置，而空白的部份则代表空接针。以文字表示为：[1-2]。

因此，欲设置为「JumperFree™ Mode」，以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」，以文字表示即为：[2-3]。



哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 http://www.asus.com.cn 华硕电脑互联网取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能会夹带其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。

电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示的环保使用期限，是指在一般正常使用状况下。

MAXIMUS VII IMPACT 规格列表

中央处理器	支持采用 LGA1150 规格插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium/Celeron 处理器 支持 22nm 处理器 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术* *对 Intel® Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器的类型而不同 **请访问 www.asus.com.cn 取得最新的 Intel 处理器支持列表
芯片组	Intel® Z97 Express 芯片组
内存	支持双通道内存架构 2 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 3300（超频）*/3200（超频）*/3100（超频）*/3000（超频）*/2933（超频）* /2800（超频）*/2666（超频）*/2600（超频）*/2500（超频）*/2400（超频）*/2200（超频）*/2133（超频）*/2000（超频）*/1866（超频）*/1800（超频）*/1600/1333 MHz 内存，最高可以扩展至 16GB 内存 支持 Intel® Extreme Memory Profile（XMP）技术 *对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响 **请访问 www.asus.com.cn 或参考本用户手册取得内存合格供应商支持列 表（QVL）
扩展槽	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 插槽 1 x mini-PCI Express 2.0 x1 插槽*，位于 mPCIe Combo IV 扩展卡上 *mini-PCI 插槽上已预装一组 Wi-Fi（无线网络）/蓝牙模块
图形显示控制器	集成式 Intel® HD 绘图处理器 支持 DisplayPort 1.2，最高分辨率可达 4096 x 2160 @ 24Hz 与 3840 x 2160 @60Hz 支持 HDMI，最高分辨率可达 4096 x 2160 @ 24Hz / 2560 x 1600 @60Hz 支持 Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD 技术 与 Intel® Insider™
存储设备连接槽	Intel® Z97 Express 芯片组： 4 x SATA 6Gb/s 连接端口* - Intel® Rapid Storage 技术 13 支持 RAID 0、1、5 与 10 - 支持 Intel® Smart Response（智能回应）技术、Intel® Rapid Start 技术，以及 Intel® Smart Connect（智能连线）技术* 1 x 具备 M Key 的 M.2 (NGFF) Socket 3 - 支持 PCI Express 3.0 x4 标准 - 支持 M.2 (NGFF) 类型 2242/2260/2280/22110 SSD 卡（长度最大可支持至 110mm）** *这些功能的运行取决于安装的处理器类型 **M.2 Socket 3 与 PCIe 3.0 x16 插槽共享带宽，若安装有 M.2 设备，则 PCIe 3.0 x16 的带宽会变为 x8

（下页继续）

MAXIMUS VII IMPACT 规格列表

网络功能	1 x Intel® I218-V Gigabit LAN 网络控制器—双向连接集成式网络控制器（MAC）与物理层（PHY） Anti-surge LANGuard 以太网端口 ROG GameFirst III
无线网络	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 支持双频 2.4/5 GHz 蓝牙 v4.0/3.0+HS *此模块已经安装在 mPCIe Combo IV 扩展卡上
音频功能	ROG SupremeFX Impact II 8 声道高保真音频编码器* - SupremeFX Shielding 技术 - ELNA® 高级音响电容 - 完整无失真 DVD 光盘音频、蓝光光盘音频与 HD-DVD 音频内容保护 - 支持音频接口检测、多音源独立输出（Multi-Streaming）技术与前端面板音频插孔功能* - 后侧面板具备光纤 S/PDIF 数字输出连接端口 音频功能： - Sonic SoundStage - Sonic SenseAmp - Sonic Studio - Sonic Radar II - DTS Connect *音频插孔检测功能支持通过拥有高保真音频模块的前置面板之机箱进行 8 声道高保真音频输出
USB	Intel® Z97 Express 芯片组： 6 x USB 3.0 连接端口（4 端口在主板后侧面板 [蓝色]；2 端口在主板中央 [红色]）* 6 x USB 2.0 连接端口（4 端口在主板后侧面板，2 端口在主板中央）** *支持华硕 USB 3.0 Boost，UASP 标准在 Intel® 原生 USB 3.0 上仅支持 Windows® 8 / 8.1 操作系统 **2 x USB 2.0 连接端口位于主板中央（USB1213），与 ROG 扩展端口（ROG_EXT）共享
后侧面板设备连接端口	1 x 光纤 S/PDIF 输出端口 1 x HDMI 连接端口 1 x DisplayPort 连接端口 1 x Q-Code 指示灯 1 x Sonic SoundStage 按钮 1 x keybot 按钮 1 x 清除 CMOS 按钮 1 x ROG Connect 按钮 4 x USB 2.0 端口（1 端口可切换为 ROG Connect 连接端口） 4 x USB 3.0 连接端口 [蓝色]

（下页继续）

MAXIMUS VII IMPACT 规格列表

后侧面板设备连接端口	1 x PS/2 键盘/鼠标复合式连接端口 1 x Anti-surge（RJ-45）网络连接端口 3 x 音频接口* *音频接口位于 SupermeFX Impact II 卡
ROG 独家超频功能	Impact CoolHub SupremeFX Impact II Impact Power II - 全数字 8+2 相式 CPU/内存电源 - NexFET™ Power Block MOSFET - 60A BlackWing Chokes - 10K 黑色金属固态电容 mPCIe Combo IV（mPCIe/M.2 复合卡） KeyBot - CPU Level Up - X.M.P. - DirectKey ROG Connect* - RC Diagram - RC Remote - RC Poster UEFI BIOS 功能 - Extreme Tweaker - Tweaker’s Paradise - ROG SSD Secure Erase - GPU.DIMM Post - O.C. Profile - 显卡信息预览（Graphics Card information Preview） ROG RAMDisk ProbeIt *ROG Connect 专用线材请另行选购
其他特殊功能	华硕第五代智能双处理器（ASUS Dual Intelligent Processor 5） - 全方位优化调校，集成 TPU、EPU、DIGI+ 电源控制、Fan Xpert 2 与 Turbo App 华硕独家功能 - AI Suite 3 智能管家三代 - USB 3.0 Boost - USB Charger+ 华硕充电专家 - Ai Charger 充得快 - 推播信息（Push Notice） - Disk Unlocker 华硕 EZ DIY - USB BIOS Flashback - 华硕 CrashFree BIOS 3 应用程序 - 华硕 EZ Flash 2 应用程序 - 华硕 C.P.R.（CPU 参数自动恢复）

（下页继续）

MAXIMUS VII IMPACT 规格列表

其他特殊功能	华硕 Q-Design - 华硕 Q-Code - 华硕 Q-Shield - 华硕 Q-LED（CPU、内存、显卡、启动设备指示灯） - 华硕 Q-DIMM
内部连接端口	1 x USB 3.0 连接端口（可扩展 2 个 USB 3.0 连接端口） 1 x USB 2.0 连接端口（可扩展 2 个 USB 2.0 连接端口，1 端口与 ROG_EXT 接口共用） 4 x SATA 6Gb/s 插座 1 x ROG（ROG_EXT）扩展接口 1 x 4-pin 处理器风扇插座 3 x 4-pin 机箱风扇插座（2 x 4-pin 机箱风扇位于 Impact CoolHub 卡） 1 x 24-pin EATX 电源插座 1 x 8-pin EATX 12V 电源插座 10 x Probelt 测量点 1 x LN2 Mode 接口位于 Impact CoolHub 卡 1 x 电源按钮 1 x 重置按钮 1 x 前置面板音频插座（AAFP）* 1 x TPM 插座 1 x 系统面板插座 1 x SupermeFX Impact II 插座 1 x mPCIe Combo IV 插座 1 x Impact CoolHub 插座 *前置面板音频插座（AAFP）内置于 SupremeFX Impact II 卡
BIOS 功能	64 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.8、ACPI 5.0、多国语言 BIOS 程序
管理功能	WfM 2.0、DMI 2.7 、网络唤醒功能（WOL by PME）、PXE
软件程序	驱动程序 ROG GameFirst III ROG RAMDisk ROG CPU-Z 程序 ROG Mem TweakIt Kaspersky® 防毒软件 DAEMON Tools Pro 标准版 华硕 WebStorage 云端保存空间 ASUS HomeCloud 华硕应用程序
操作系统	Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
机箱尺寸	Mini ITX 型式：6.7 英寸 x 6.7 英寸（17 厘米 x 17 厘米）

规格若有任何更改，恕不另行通知。

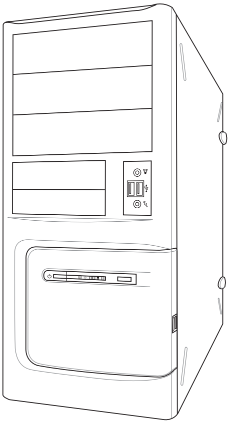
产品包装

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

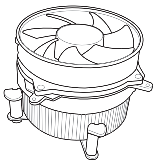
主板	ROG MAXIMUS VII IMPACT 主板
排线	4 x SATA 6Gb/s 排线
配件	1 x I/O 挡板 1 x 12 合 1 ROG 排线贴纸 1 x Q-Cable 1 x 选用 4 合 1 CPU 散热器背板用垫圈 1 x SupremeFX Impact II 声卡 1 x mPCIe Combo IV 扩展卡，具备双频 Wi-Fi a/b/g/n/ac + 蓝牙 v4.0/3.0+HS 模块 1 x 2T2R 双频 Wi-Fi 移动天线 1 x Impact CoolHub 卡
应用程序光盘	ROG 主板驱动及应用程序 DVD 光盘
相关文件	用户手册

若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽速与您的经销商联络。

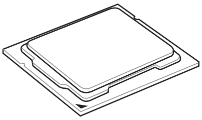
创建 PC 系统所需的其他工具与元件



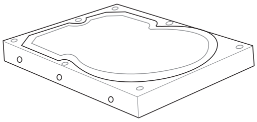
PC 机箱



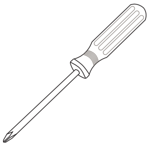
Intel LGA1150 兼容处理器风扇



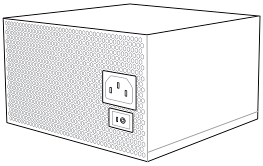
Intel LGA1150 处理器



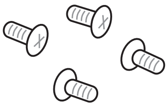
SATA 硬盘



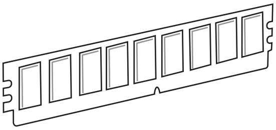
Philips（十字）螺丝起子



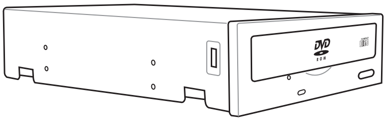
电源供应设备



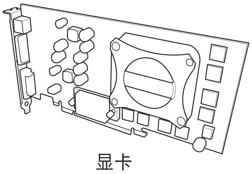
一袋螺丝



内存条



SATA 光驱（选购）



显卡

上述所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。

＊ 显卡为选购配备

第一章

1.1 特殊功能

1.1.1 产品特写

玩家共和国（Republic of Gamers）

玩家共和国只提供最优质的产品。我们提供最佳的硬件设计、最高速的性能与最创新的设计，欢迎对硬件规格有高度要求的玩家一同加入！

在玩家共和国的国度中，仁慈怜悯是弱者的行为，勇于挺身而出才是唯一王道。我们敢说我们擅长竞争，如果您的个性符合我们的特性，请加入我们的菁英俱乐部，在玩家共和国中让大家感受您的存在。

支持 LGA1150 规格的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器

本主板支持最新 LGA1150 封装的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器，并通过 GPU、双通道 DDR3 内存插槽与 PCI Express 2.0/3.0 扩展插槽，能提供最佳的绘图显示与系统运算性能。

采用 Intel® Z97 Express 芯片组

Intel® Z97 Express 芯片组采用最新的单芯片设计，是专为支持最新的 LGA1150 插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器所设计，通过连续的点对点链接增加带宽与稳定性，并增强系统性能。原生支持高达六组 USB 3.0 连接端口、六组 SATA 6 Gb/s 连接端口与 M.2 规格，提供更快速的数据存取速度。

PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express® 3.0（PCIe 3.0）总线标准提供比当前 PCIe 2.0 快二倍的性能，x16 的总带宽可达 32Gb/s，双倍于 PCIe 2.0（x16 模式）的 16Gb/s。PCIe 3.0 提供用户前所未有的数据传输速度，提供与 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 设备完全向下兼容的便利与无缝传输。

1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能

SupremeFX Impact II

ROG 了解音频无瑕的重要性 - 让游戏达到纯净的效果与全方位的配乐。我们将最好的音频提供在所有 ROG 主板上。SupremeFX Impact II 为针对 ROG 主板所采用的专用硬件音频，采用高级日本制 ELNA 电容与先进的数字以及模拟信号隔离技术，通过此顶尖的隔离技术能减少电磁波干扰（EMI）与提供一流音频，让进行游戏和多媒体播放时有真实清晰的音频表现！

Sonic Rader II

Sonic Rader II 采用独家的音频增强技术，可以增强在游戏中的音频有更好的听位辨识。可以在游戏画面上堆栈显示，帮助您实时得知对手和队友所在的具体位置，屏幕上的雷达可精确显示枪声、脚步声等来源，在玩第一人称射击（FPS）游戏时以提供更精确的方位，不给对手任何攻击偷袭的机会。

Sonic Studio

Sonic Studio 是一个音频调整软件，能模拟 7.1 声道，甚至通过立体声（2.0 双声道）耳机也能模拟出环绕音频的效果。此软件提供了包含六项音频设置：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（语音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）与 Virtual Surround（虚拟环绕）功能。

Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 为内置的音频解决方案，以提升您在连接前面板耳机时的音频体验，并可作用于所有的操作系统与游戏，您可以从四个默认值做选择，也可以手动方式微调想要的专属设置，并应用在您的游戏中。

Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 独家功能，可以自动检测您所连接的耳机阻抗，并且能配合调整内置扩大机以符合使用。只需将耳机连接，便可以让您通过 Sonic SenseAmp 轻松调整您的高保真耳机。

KeyBot

KeyBot 是一个内置的微型处理器，可以瞬间将键盘升级。这项功能可以提供您设置和指派巨集至键盘上指定的按键，便能同时运行特定或多项任务，并且还可以设置电脑的在 CPU Level Up、XMP 的唤醒功能，或直接唤醒 BIOS 模式。

> 这项功能仅支持 USB 键盘。

GameFirst III

华硕 GameFirst III 是一个网络管理软件，提供四种默认封包优先处理设置文件（最佳化、游戏、串流媒体与文件共享）以符合用户的需求。用户也可以手动分配带宽，并调整设置每个应用程序的优先顺序，让运行速度更快、更流畅。

Intel® 以太网

由 Intel 所提供的网络解决方案，拥有久负盛名提供更好的处理能力、使用较低的 CPU 资源以及更好的稳定性。

1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能

支持 M.2 规格

本主板配备有 M.2 插槽，与 PCI Express 3.0 x4 插槽共享带宽以提升数据传输速度，可以用来增强指定给操作系统使用的 SSD 的性能。

- 仅支持 PCIe 接口。
- 支持 2242/2260/2280/22110 SSD 卡，长度最大可支持至 110mm。

ROG Connect

利用 ROG Connect 接口通过您的笔记本电脑来监控台式机状态并实时调整主系统参数。ROG Connect 通过 USB 数据线连接您的主系统至笔记本电脑，读取并输出至您的笔记本电脑上显示，以提供您查看 POST 码与实时显示的硬件状态，并能在硬件支持上实时直接地调整参数。

Impact Power II

特别为专业玩家打造了拥有垂直架构设计的 Impact Power II，提供您如同其他 ROG 主板一样的超电压与超频灵活性 - 将超频与精密度结合于一张 mini-ITX 规格板型上。对于精确的 CPU/内存数字电源控制，Impact Power II 采用了最好的元件，如 NexFET™ Power Block MOSFETs 不仅提供了强大的耐用度，于一般使用情境下更是拥有高达 90% 的性能转换率。全新搭载的 BlackWing 电感所能输出的额定电流值高达 60A，是为一般标准电感的 2 倍；其特殊的鳍片设计有效增加散热面积，使电感温度低于 l 般常规的 3-5 度，更通过特殊镀金处理的高导电涂层，达到最低的能耗损失。搭配顶级日本制 10K 黑金固态电容，提供 5 倍更长的使用寿命和加强 20% 的低温耐用度。ROG 独家创新的 Impact Power II 供电设计绝对可以为玩家发挥 CPU 的极限性能，带来更高的效率、稳定性与整体系统的性能。

iROG

iROG 为一个特殊的芯片，提供数个 ROG 重要功能，让您可以在任何阶段完全控制主板。这项设计提供给高级的玩家操控与管理，以达到一个硬件的水准。iROG 可以大大地增加喜爱超频玩家们在超频时的乐趣，并且可以提供系统维护与更多的管理控制和效率。

LANGuard

ROG 通过先进的信号耦合技术与改善流量的高级表面安装元件改革网络连接端口，而电涌全保护与静电防护元件（静电放电防护，ESD Guard）保护主板免于受到雷击与静电的危害。

CPU Level Up 功能

使用玩家共和国的 CPU Level Up 功能就能升级您的 CPU，只要选择您欲超频的处理器，剩下的就交给主板代劳。您只要看看新 CPU 的速度并立即享受它所带来的优异性能，超频真是再简单不过了。

GPU.DIMM Post

让您在 BIOS 程序中就能轻松查看显卡状态与内存，甚至在您进入操作系统之前就能发现潜在问题！超频玩家也能省下在极端的超频状态中检测零件故障的宝贵时间。有了 GPU.DIMM Post 功能，就能在 BIOS 程序中快速且简易检查显卡与内存状态，继续维持破纪录超频表现。

ProbeIt 功能

ProbeIt（探针）功能提供检测来自主板的测量点，可清楚地确认来自上面提供的这 10 个设置点的检测状态，让您通过三用电表可以精确地得知从何处快速取得在精确的读数。

Extreme Tweaker 技术

Extreme Tweaker 能够一次找到所有最佳化的性能设置之处，不论您找寻的是频率调整设备、电压调整设备、或内存频率设备，都能在 Extreme Tweaker 找到！

Loadline Calibration

Loadline calibration 可以在系统负载量大的时候，确保处理器电压维持稳定与最佳性能的状态。提供喜爱超频的玩家们享受主板的极限超频能耐与测试成绩。

1.1.4 华硕独家功能

AI Suite 3

通过友善的用户界面，华硕 AI Suite 3 将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以用来监督超频、电源管理、风扇速度控制、电压与感应器读数，甚至可以通过蓝牙与移动设备互动。这个集所有功能于一身的软件提供多样化与容易使用的功能，并且不需要在不同的应用程序间来回切换。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以来最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后无须再烦恼超频，并拥有无与伦比的便利性。

USB 3.0 Boost

全新华硕 USB 3.0 加速技术支持 UASP（USB Attached SCSI Protocol）传输协定，是最新的 USB 3.0 标准。拥有 USB 3.0 加速技术，USB 设备传输速度可显着的提升约 170%，给人印象深刻的 USB 3.0 传输速度。USB 3.0 加速技术提供友善的图形接口，通过华硕独家设备自动检测设置，可以立即加速 USB 3.0 接口的传输速度。

1.1.5 ROG 搭配软件

Kaspersky® 防毒软件

Kaspersky® 个人防毒软件提供个人玩家与家庭办公用户优秀的病毒防护。此软件是基于高级的防毒技术，程序包含 Kaspersky® 防毒程序引擎，随时随地针对常见的恶意程序进行检测与提供高性能的防护。

DAEMON Tools Pro 标准版程序

DAEMON Tools Pro 为提供 CD、DVD 与蓝光光盘备份使用的程序，可以将光学媒体转成虚拟光盘与模拟设备来以虚拟复制方式运行。DAEMON Tools Pro 工具程序可以组合数据、音乐、图像与相片在电脑、笔记本电脑上面。

ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 为 CPUID 针对 ROG 所量身订做的版本。具备与原来版本相同的功能与可信度，并拥有独特的设计。使用全新外观的 ROG CPU-Z 来确实地回报 CPU 相关信息与展现您的独特性。

Mem TweakIt

Mem TweakIt 是一个内存参数实时监控软件，您可以查询内存参数并且在 ROG 官方网站与其他 ROG 主板玩家比赛内存性能分数排名。

RAMDisk

RAMDisk 可以使用部分系统内存将它变成一个高速的物理保存，提供您在此保存缓保存文件案与游戏程序而能达到立即读取。此外，延长 SSD 的生命周期，并保持您的主要保存最佳化，则是相当重要的任务，并且可以获得自动备份与恢复文件。

SSD Secure Erase

ROG 主板拥有固态硬盘安全删除（SSD Secure Erase）功能，可以完全删除 SSD 硬盘中所有的数据，借以恢复 SDD 性能与恢复至出厂时的速度。SSD Secure Erase 包含在 UEFI BIOS 提供更佳的兼容性与更简易的使用性。

DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 与 DTS Neo:PC™ 技术，DTS Neo:PC™ 可以将各种立体声信号，如：CD、MP3、WMA、网络收音机等转换成 7.1 声道，彻底发挥多声道喇叭的威力，随时享受环绕音频。用户可以将电脑与家庭剧院连接，DTS Interactive 会将原本的音频重新编码成为 DTS 音频信号，通过数字音频接口如 S/PDIF 或 HDMI，从电脑传送至任何能兼容 DTS 的系统，提供您最佳的环绕音频。

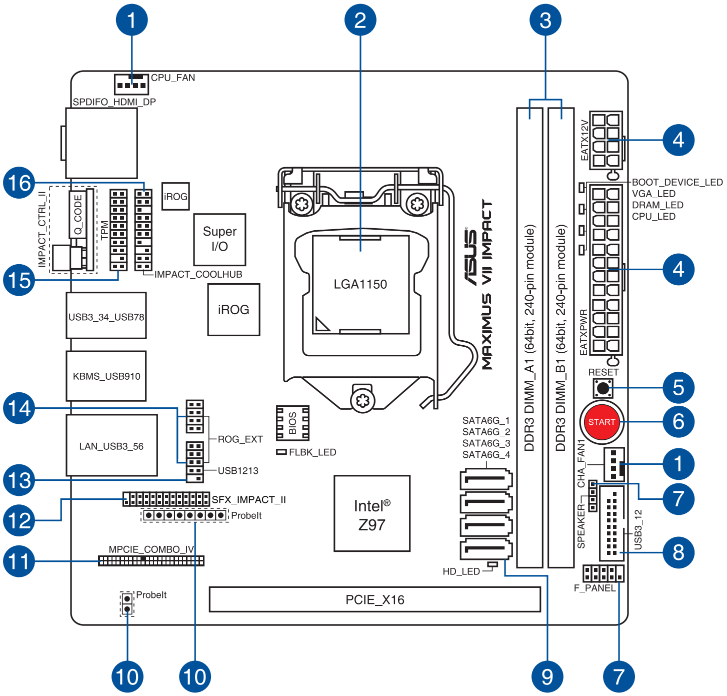
1.2 主板概述

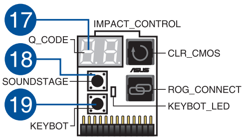
1.2.1 主板安装前

主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏，因此，在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。

- 在处理主板上的内部功能设置时，您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您删除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或删除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

1.2.2 主板结构图





关于面板连接插座与内部连接插座的相关信息，请参考 1.2.8 内部连接端口 与 2.3.1 后侧面板连接端口 一节中的说明。

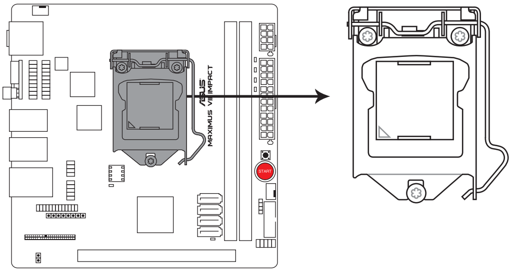
第一章

主板元件说明

连接插槽/跳线选择区/开关与按钮/插槽	页数
1. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CHA_FAN1)	1-38
2. LGA1150 CPU Socket	1-9
3. DDR3 DIMM slots	1-10
4. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	1-39
5. RESET button	1-25
6. START (Power-on) button	1-25
7. Front panel and speaker connectors (10-1 pin F_PANEL; 4 pin SPEAKER)	1-40
8. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)	1-36
9. Intel® Z97 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4 [red])	1-35
10. ProbeIt measurement points	1-44
11. mPCIe Combo IV connector (50-1 MPCIE_COMBO_IV)	1-42
12. SupremeFX Impact II connector (26-1 pin SFX_IMPACT_II)	1-42
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1213)	1-37
14. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)	1-41
15. TPM connector (20-1 pin TPM)	1-41
16. Impact_CoolHub connector (20-3 pin IMPACT_COOLHUB)	1-43
17. Q_Code LEDs	1-29
18. SoundStage button	1-26
19. KeyBot button	1-26

1.2.3 中央处理器（CPU）

本主板具备一个 LGA1150 处理器插槽，本插槽是专为第四代/全新第四代与第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器所设计。



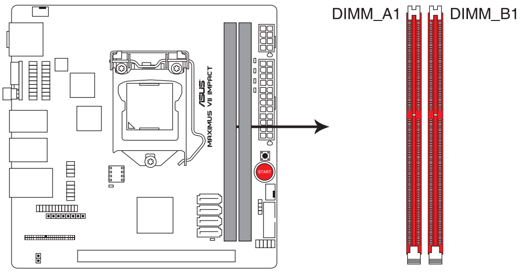
MAXIMUS VII IMPACT CPU LGA1150

- 当您安装 CPU 时，请确认所有的电源接口都已拔除。
- 本插槽仅支持 LGA1150 处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。
- 在您购买本主板之后，请确认在 LGA1150 插座上附有一个即插即用的保护盖，并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经丢失或是没有保护盖，或者是插座接点已经弯曲，请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板后，请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA1150 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization（RMA）的要求，华硕电脑才能为您处理产品的维修与保修。
- 本产品之保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的卸除即插即用保护盖所造成的丢失。

1.2.4 系统内存

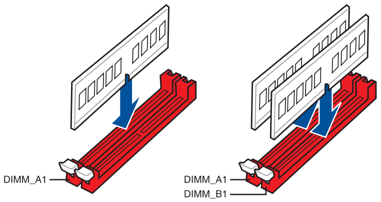
本主板配置有 2 组 DDR3（Double Data Rate 3）内存条插槽。

DDR3 内存条拥有与 DDR2 或 DDR 内存条相同的外观，但是 DDR3 内存插槽的缺口与 DDR2 或 DDR 内存插槽不同，以防止插入错误的内存条。



MAXIMUS VII IMPACT 240-pin DDR3 DIMM sockets

内存建议设置



内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB、4GB 与 8GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 内存条至本主板的内存插槽上。

- 当内存条频率高于 2133MHz，并且相应时钟或载入的 XMP 文件不是 JEDEC 标准时，内存条的稳定性与兼容性会依照处理器性能与其他已安装设备而有不同。
- 您可以在 Channel A 与 Channel B 安装不同容量的内存条，在双通道设置中，系统会检测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存容量，会被检测为单通道模式运行。
- 根据 Intel 处理器规格，建议内存电压低于 1.65V 以保护处理器。
- 在本主板请使用相同 CL（CAS-Latency 行地址控制器延迟时间）内存条。为求最佳兼容性，建议您使用同一厂商的相同容量型号之内存。
- 由于 32-bit Windows 操作系统内存地址空间的限制，当您安装 4GB 或更多的内存条时，系统实际可用的总内存只有 3GB 或更少。为充分利用内存，您可以运行以下任一动作：

  - 若您使用 32-bit Windows 操作系统，建议系统内存最高安装 3GB 即可。
  - 当主板安装 4GB 或更多的内存时，建议您安装 64-bit Windows 操作系统。
  - 若需要更详细的数据，请访问 Microsoft 网站 http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-cn。
- 本主板不支持 512 Mb（64MB）芯片的内存条（内存容量以 Megabit 计算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB）。

- 默认的内存运行频率是根据其 SPD（Serial Presence Detect）。在默认状态下，某些内存在超频时的运行频率可能会较供应商所标示的数值为低。若要让内存条以供应商的数值或更高的频率运行，请参考 3.4 Extreme Tweaker 菜单 一节中，手动调整内存频率的说明。
- 在全负载（2 DIMM）或超频设置下，内存条可能需要更佳的冷却系统以维持运行的稳定。

MAXIMUS VII IMPACT 主板合格供应商列表（QVL）

DDR3 3300MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
G.SKILL	FE-3300C13D-8GTXDG (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	13-15-15-35	1.65	

DDR3 3200MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
AVEXIR	"AVD3UH32001304G-4CI(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	13-15-15-35	1.65	•
G.SKILL	"F3-3200C12Q-16GTXDG(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-15-15-35	1.65	•

DDR3 3100MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
AVEXIR	"AVD3UH31001204G-4CI(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
A-DATA	"AX3U3100W4G12-DMV(XMP)"	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 3000MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
AVEXIR	"AVD3UH30001204G-4BZ1(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	"G.SKILL F3-3000C12Q-16GTXDG(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	"F3-3000C12D-8GTXDG(XMP)"	8GB (2 x 4B)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	"CMY8GX3M2A-3000C12R(XMP)"	8GB (2 x 4B)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 2933MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）
								2
G.SKILL	F3-2933C12D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12D-16GTXDG(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A2933C12R(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 2800MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）
								2
AVEXIR	AVD3UH28001208G-4BZ1(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
A_DATA	AX3U2800W4G12(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
A_DATA	AX3U2800W8G12(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C10D-8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	10-12-12-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-16GTXDG(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-16GTXD(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12D-16GTXD(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
APACER	78.BAGH5.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C11(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C12(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A2800C12R(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
KINGSTON	KHX28C12T2K2/8X	8GB (2x4GB)	SS	-	-	12-14-14-32	1.65	•

DDR3 2666MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2666C11 (Ver5.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
GeIL	GOC332GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65	•
Kingston	KHX26C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	2666-11-13-13-32	1.65	•

DDR3 2400MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
ADATA	AX3U2400W4G11-DMV(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
ADATA	AX3U2400W8G11-DMV(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	•
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10(Ver 4.21)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10A (Ver4.21)(XMP)	16GB (8x2GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10R (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q2-64GBZHD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q-32GBZHD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9Q-16GBZMD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
G.SKILL	F3-2400C11Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-31	1.65	•
GeIL	GOC316GB2400C10QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
GeIL	GOC316GB2400C11QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•
Kingston	KHX2400C11D3K4/8GX(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•

（表格续下页）

DDR3 2400MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
Kingston	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•
Kingston	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•
Kingston	KHX24C11T3K4(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	2400-11-13-13-30	1.65	•
Kingston	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
mushkin	997122R(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	2400-10-12-12-28	1.65	•
Silicon Power	SP004GXLYU240NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2400-11-13-13-32	-	•
Team	TLD38G2400HC11CBK(XMP)	8GB	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
Transcend	TX2400KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2400-11-12-11-29	1.6	•

DDR3 2133MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
ADATA	AX3U2133W4G10-DR(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
ADATA	AX3U2133W8G10-DR(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2B2133C9 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-27	1.5	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•
G.SKILL	F3-2133C10Q-32GSR(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.5	•
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•
Kingston	KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	•
Kingston	KHX21C11T3FK8/64X(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
Silicon Power	SP004GXLYU213NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2133-11-12-11-30	-	•
Silicon Power	SP008GXLYU213NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	2133-11-12-11-30	-	•
Team	TLD38G2133HC11ABK(XMP)	8GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•
Transcend	TX2133KLH-16GK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	2133-10-11-10-27	1.6	•
Transcend	TX2133KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2133-10-11-10-27	1.6	•

DDR3 2000MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）
								2
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	•
ASint	SLA302G08-ML2HB(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G8 3BFRH9C	9-9-9-27	-	•
GeIL	GUP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•

DDR3 1866MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）
								2
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866 9-9-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A1866C9 (Ver3.24)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A1866C9 (Ver 4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A1866C9 (Ver3.24)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C10 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866 C9(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C1 0(Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	•
crucial	BLE4G3D1869DE1TX0. 16FKR(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLE4G3D1869DE1XT0 .16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLE8G3D1869DE1TX0. 16FED(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLS8G3D18ADS3.16FED	8GB	DS	-	-	10-10-10-30	1.5	•
crucial	BLT8G3D1869DT1TX0. 16FED(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•

（表格续下页）

第一章

DDR3 1866MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
G.SKILL	F3-14900CL10Q-32GBZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
GeIL	GEEL316GB1866C9DC(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-28	1.65	•
Kingston	HX318C10FWK2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
Kingston	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•
Silicon Power	SP004GXLYU186NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	1866-9-11-9-27	-	•
Silicon Power	SP008GXLYU186NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1866-9-11-9-27	-	•
Team	TED38GM1866C13BK	8GB	DS	Hynix	H5TQ4G83AFR	13-13-13-32	1.5	•
V-color	TD4G16C13-RD	4GB	DS	-	-	1866-13-13-13-32	1.5	•

DDR3 1600MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
ADATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•
ADATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•
ADATA	ADDU1600W4G11-B	4GB	SS	A-DATA	DWND-1211A	9-9-9-24	-	•
ADATA	ADDU1600W8G11-B	8GB	DS	ELPIDA	J4208EBBG-GN-F	9-9-9-24	-	•
ADATA	AX3U1600W4G9-DB (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
ADATA	AX3U1600W8G9-DB (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•
AMD	AP38G1608U2K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-28	-	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-31	-	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R (XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-28	-	•
Apacer	AHU08GFA60CBT3R (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•

（表格续下页）

第一章

DDR3 1600MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
ASint	SLA302G08-EGG1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•
ASint	SLA302G08-EGJ1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•
ASint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•
ASint	SLA304G08-EGN6A	4GB	SS	ASint	304G08-GN6A	1600-11-11-11-28	1.5	•
ASint	SLA304G08-EGN6B	4GB	SS	ASint	304G08-GN6B	1600-11-11-11-28	1.5	•
ASint	SLA304G08-ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11-11-28	-	•
ASint	SLB304G08-EGJ1B(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	-	•
ASint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-	•
ASint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•
AVEXIR	AVD3U16000904G-2CW(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-28	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-8-8-24	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CML16GX3M2A1600C10 (Ver2.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CML8GX3M2A1600C9 (Ver7.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9- 24	1.5	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1600C11	8GB	DS	-	-	11-11-11-30	-	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19) (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A160 0C9(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ4GX3M1A1600C9 (Ver8.16) (XMP)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver8.21)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•
crucial	BLS4G3D1609DS1S00 .16FMR(XMP)	4GB	DS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
crucial	BLT4G3D1608DT1TX0. 16FM(XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•
crucial	CT102464BA160B .C16FED	8GB	DS	crucial	CT512X8-160B	11-11-11-28	-	•
elixir	M2X2G64CB88G7N -DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•
elixir	M2X4G64CB8HG5 N-DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•

（表格续下页）

DDR3 1600MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）2
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSR2(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-1600C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
GeIL	GUP34GB1600C7DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A(XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A(XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•
Kingston	HX316C10FRK2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-30	1.5	•
Kingston	KHX16009CD3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3B1/4G(XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•
Kingston	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•
Kingston	KHX16C10B1K2/16X(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
Kingston	KHX16C9K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1333-9-9-9-24	1.5	•
Kingston	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
Kingston	KVR16LN11/4	4GB	SS	Kingston	D5128EC4BPGGBU	11-11-11-28	1.35	•
Kingston	KVR16LN11/8	8GB	DS	Kingston	D5128EETBPGGBU	11-11-11-28	1.35	•
Kingston	KVR16N11/4	4GB	DS	KINGSTON	D2568JPUCPGGBU	11-11-11-28-1	-	•
Kingston	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRPBC	-	1.5	•
Micron	MT16JTF1G64AZ-1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-	•
Micron	MT8JTF51264AZ-1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ	-	-	•
Micron	MT8KTF25664AZ-1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•

（表格续下页）

第一章

DDR3 1600MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
MIRA	PLAF8L93B-GN2	8GB	DS	-	BJE159C 3G-M	11-11-11-28	1.5	•
PATRIOT	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x4GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
PATRIOT	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x8GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
SanMax	SMD-4G28N1P-16KM	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBB G-GN-F	1600	-	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83 BFRPBC	-	1.5	•
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108B DBG-GN-F	-	-	•
SanMax	SMD-8G28NP-16KM	8GB	DS	ELPIDA	J4208B BBG-GN-F	1600	-	•
Silicon Power	SP002GBLTU160V02(XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02 (XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•
Silicon Power	SP004GXLYU160NSA (XMP)	4GB	SS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•
Silicon Power	SP008GXLYU160NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•
SK Hynix	HMT41GU6AFR8A-PB	8GB	DS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
SK Hynix	HMT451U6AFR8A-PB	4GB	SS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
SK Hynix	HMT451U6AFR8A-PB	4GB	SS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
Team	TED34GM1600C11BK	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFR	11-11-11-28	1.5	•
Team	TLD38G1600HC9BK(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G08460	1600-11-11-11-28-2	-	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-1	-	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G08460	1600-11-11-11-28-1	-	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-2	-	•
UMAX	84E44G93UM-16BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11-11-11-28	-	•
UMAX	84E48G93UM-16BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11-11-11-28	-	•
V-color	TD4G8C11-H11	4GB	SS	Hynix	H5TQ4G83AFR	11-11-11-28	-	•

DDR3 1333MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB 3H	-	1.5	•
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB 3H	-	1.5	•
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908C EHSBG	9	-	•
ASint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•
ASint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	Asint	304G08-DJ1B	9-10-10-26	-	•
ASint	SLA304G08-EDJ6A	4GB	SS	ASint	304G08-DJ6A	1333-9-9-9-24	1.5	•
ASint	SLA304G08-EDJ6B	4GB	SS	ASint	304G08-DJ6B	1333-9-9-9-24	1.5	•
ASint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	Asint	304G08-DJ1B	9-9-9-24	-	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-	-	•
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F		-	•
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M 8BN-CG		-	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1333C9	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•
CORSAIR	CMV8GX3M2A1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver2.12)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver5.11)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A13 3C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
GeIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88 BA15B	9-9-9-24	1.3	•
GeIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
GeIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
innodisk	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•
innodisk	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX-12A	-	-	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	•
Kingston	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5	•
Kingston	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	1.5	•
Kingston	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	-	1.5	•

（表格续下页）

DDR3 1333MHz（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购） 2
MACH XTREME	MXD3U133316GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	•
MACH XTREME	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	•
Micron	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•
RiDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB1A G22Fe	9	-	•
RiDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RiDATA	E304459CB1A G32Cf	9	-	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•
Silicon Power	SP004GBLTU133V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•
UMAX	84E44G93UM-13BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9-9-24	-	•
UMAX	84E48G93UM-13BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9-9-24	-	•

SS - 单面内存　DS - 双面内存

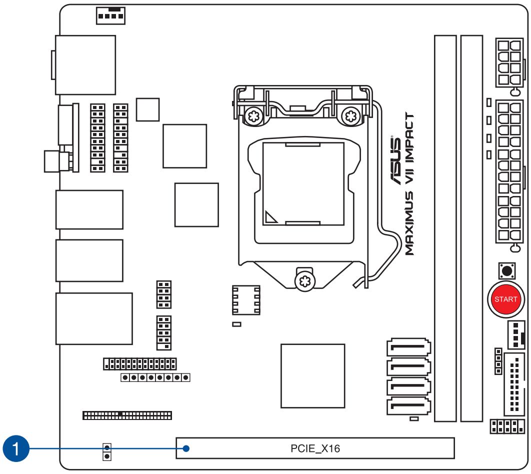
内存插槽支持：

- 1 - 在单通道内存设置中，支持安装一组内存条在任一插槽，建议您安装在 A1 插槽。
- 2 - 支持安装二组内存条在红色插槽，作为一对双通道设置。

- 华硕独家提供支持高速内存功能。
- 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响。载入 BIOS 程序中的 X.M.P. 设置来支持高速内存。
- 请访问华硕网站查询最新内存供应商列表（QVL）。

1.2.5 扩展插槽

安装或卸除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。



插槽编号	插槽说明
1	PCIe 3.0/2.0 x16 插槽

若有设备安装在 mPCIe Combo IV 卡的 M.2 插槽时，PCIe 3.0 x16 插槽会以 x8 速度运行。

本主板使用的中断要求一览表

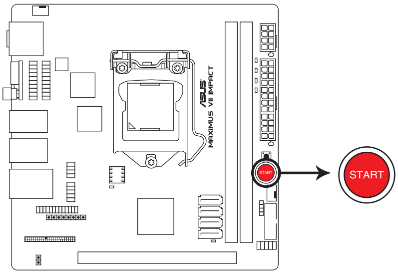
	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIE_x16	共享	-	-	-	-	-	-	-
I.G.F.X.	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel LAN 网络控制器	-	-	-	-	共享	-	-	-
SATA #0	-	共享	-	-	-	-	-	-
SATA #1	-	共享	-	-	-	-	-	-
高保真音频	-	-	-	-	-	-	共享	-
EHCI# 0 (USB 2.0)	-		-	-	-	-	-	共享
EHCI# 1 (USB 2.0)	-	-	-	-	共享	-	-	-
XHCI (USB 3.0)	-	-	-	-	-	共享	-	-
Wi-Fi	-	-	-	共享	-	-	-	-

1.2.6 主板上的内置按钮与开关

当您想要针对未安装在机箱的裸板或是开放机箱的系统作性能调校时，主板上内置的开关按钮与重置按钮可以方便您迅速地开关机或是重置系统。这个专为超频者及专业玩家的设计，可以方便且不间断地进行调教，并让性能有效的提升。

1. 启动按钮（START）

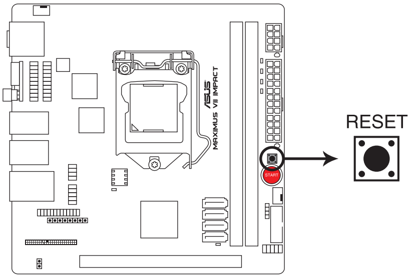
   本主板拥有启动开关，让您可以唤醒系统或启动，并以亮灯显示系统已接上电源为启动状态，并提醒您在主板卸除或插入任何元件之前要先关机。下图显示开关在主板上的位置。



MAXIMUS VII IMPACT Power on button

2. 重置按钮（RESET）

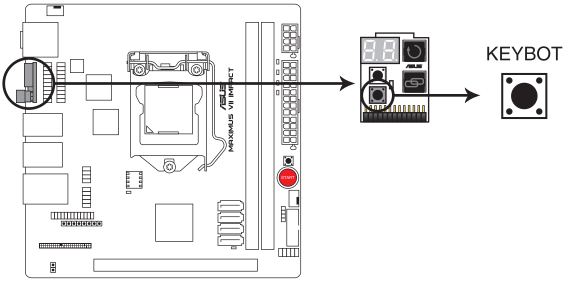
   按下重置开关以重新启动系统。



MAXIMUS VII IMPACT Reset button

3. KeyBot 按钮（KeyBot）

本按钮可以提供您设置和指派聚集至键盘上指定的按键，按下按钮可以启用 KeyBot 功能。

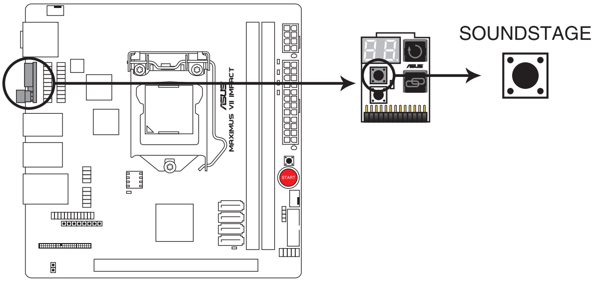


MAXIMUS VII IMPACT KEYBOT button

- KeyBot 功能仅支持安装在指定的 USB 连接端口之 USB 键盘，请参考 2.3.1 后侧面板连接端口 一节的说明来找到 KeyBot USB 连接端口的位置。
- 当 KeyBot 功能启用时，KeyBot 按钮旁的 KEYBOT_LED 会亮起。
- 如欲了解更多有关 KeyBot 功能介绍，请参考本手册 4.10 KeyBot 一节的说明。

4. Sonic SoundStage 按钮（SOUNDSTAGE）

本按钮用来设置游戏的音频，按下按钮可以启用 Sonic SoundStage 功能。



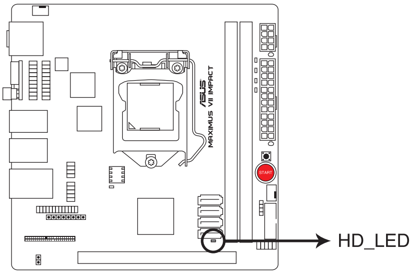
MAXIMUS VII IMPACT SOUNDSTAGE button

- 当按下 Sonic SoundStage 后，Q-Code 指示灯上会显示当前 Sonic SoundStage 的设置文件。Sonic SoundStage 当前有四个设置文件，Q-Code 指示灯 (01)代表 FPS 模式、(02)赛车模式、(03)竞技模式、(04)运动模式。默认指示灯为(dE)。
- 如欲了解更多有关 Sonic SoundStage 功能介绍，请参考 4.7.3 Sonic SoundStage 一节的说明。
- Q-Code 可以在 BIOS 设置显示 CPU 温度，请参考第三章的说明。

1.2.7 内置 LED 指示灯

1. 硬盘指示灯

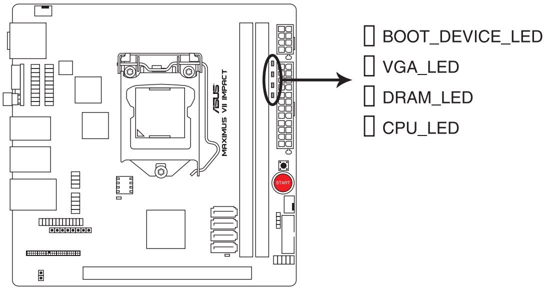
　　这个指示灯设计用来显示硬盘运行的状态。当指示灯闪烁时表示正在读取硬盘的数据或数据正在写入硬盘中，若是指示灯一直没有亮起，则表示本主板没有连接硬盘或是硬盘没有作用。



MAXIMUS VII IMPACT Hard Disk LED

2．Q 指示灯

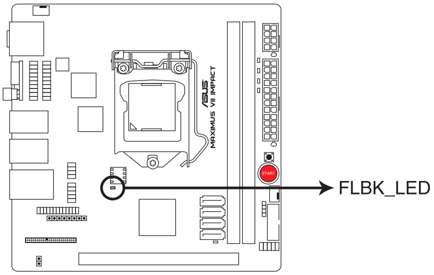
　　Q 指示灯在启动后会检查主板的主要元件，包括：CPU、内存、显卡与启动设备状态。当发现错误时，在该项目旁的指示灯则会亮灯直到问题解决。通过友善的设计，以直觉的方式能在几秒内找到问题点。



MAXIMUS VII IMPACT CPU/ DRAM/ VGA/ BOOT_DEVICE LED

3. USB BIOS Flashback 指示灯（FLBK_LED）

这个指示灯会在 BIOS 更新时闪烁，且在更新完毕后熄灭。

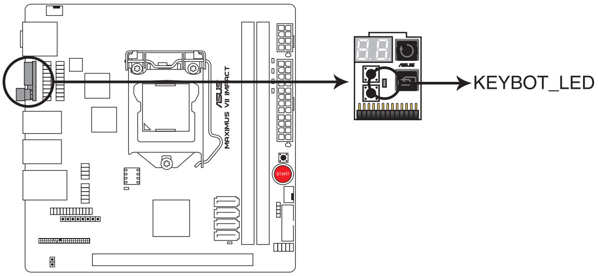


MAXIMUS VII IMPACT FLBK_LED

> 若要获得更多关于如何更新 BIOS 的信息，请参考第二章的说明。

4. KeyBot 指示灯（KEYBOT_LED）

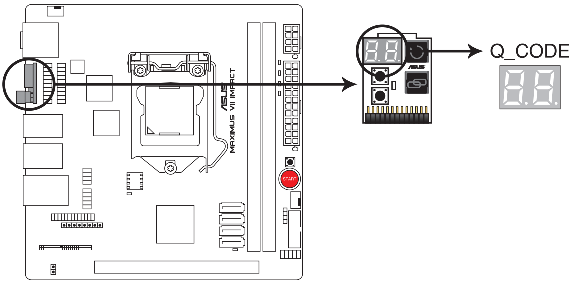
这个指示灯会在按下 KeyBot 按钮或是通过 KeyBot 软件启动 KeyBot 功能后亮灯显示。



MAXIMUS VII IMPACT KEYBOT_LED

5. Q-Code 指示灯

Q-Code 指示灯设计为 2 位显示，用来得知系统状态。请参考下方 Q-Code 列表来获得更详细的信息。



MAXIMUS VII IMPACT Q-Code LED

- Q-Code 指示灯会在启动时自动显示启动自我检测（POST）代码。
- 按下 Sonic SoundStage 按钮后，Q-Code 指示灯也会显示 Sonic SoundStage 设置文件。
- Q-Code 也可以显示系统温度，请至 BIOS 设置的 ROG Effects 类别内启用。
- 若要获得更多信息，请参考 1.2.6 主板上的内置按钮与开关 一节的详细说明。

Q-Code 列表

Code	说明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C – 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 – 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 – 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 – 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B – 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 – 36	CPU post-memory initialization
37 – 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B – 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started

（表格续下页）

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AMI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available

（表格续下页）

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset

（表格续下页）

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error

（表格续下页）

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 检查表

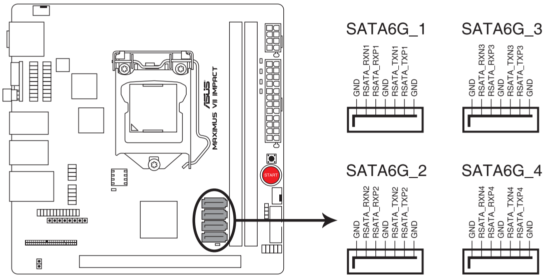
Code	说明
0x01	System is entering S1 sleep state
0x02	System is entering S2 sleep state
0x03	System is entering S3 sleep state
0x04	System is entering S4 sleep state
0x05	System is entering S5 sleep state
0x10	System is waking up from the S1 sleep state
0x20	System is waking up from the S2 sleep state
0x30	System is waking up from the S3 sleep state
0x40	System is waking up from the S4 sleep state
0xAC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
0xAA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

1.2.9 内部连接端口

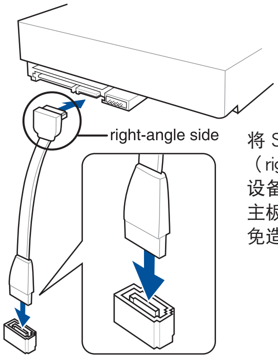
1. Intel® Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s 设备连接插槽（7-pin SATA6G_1-4 [红色]）

   这些插槽可以支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。

   若您安装了 Serial ATA 硬盘，您可以通过 Intel® Rapid Storage 技术，与内置的 Intel® Z97 芯片组来创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁盘阵列。



MAXIMUS VII IMPACT Intel® SATA 6 Gb/s connectors

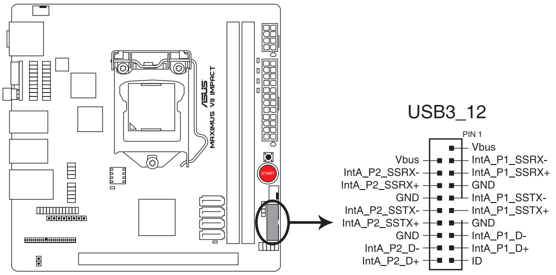


将 SATA 数据线上的直角接口端（right angle side）连接在 SATA 设备上，或是将直角接口端安装至主板内置的 SATA 连接端口，以避免造成与较大显卡的冲突

- 这些插槽的默认值为 [AHCI Mode]，若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置为 [RAID Mode]。请参考 3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration）一节的详细说明。
- 当您使用支持 NCQ 技术的硬盘时，请先将 BIOS 程序中的 SATA Mode 设置为 [AHCI Mode]。请参考 3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration）一节的说明。

2. USB 3.0 连接插槽（20-1 pin USB3_12）

这个插槽用来连接 USB 3.0 模块，可在前面板或后侧连接端口扩展 USB 3.0 模块。当您安装 USB 3.0 模块，您可以享受 USB 3.0 的益处，包括有更快的数据传输率最高达 5Gbps、对可充电的 USB 设备更快的充电速度、最佳化能源效率，以及与 USB 2.0 向下兼容。



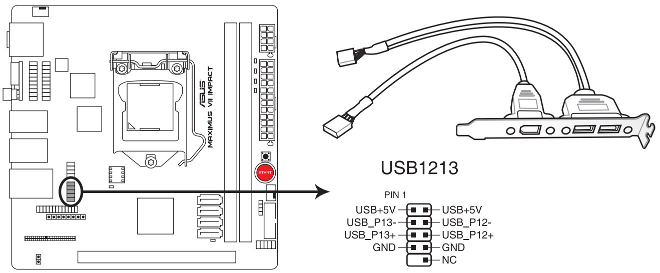
MAXIMUS VII IMPACT USB3.0 connector

USB 3.0 模块为选购配备，请另行购买。

- 这些插槽是以 xHCI 规格为基础，建议您在 Windows 7、Windows 8 与 Windows 8.1 操作系统中安装相关的驱动程序来充分使用 USB 3.0 插槽。
- 安装的 USB 3.0 设备视操作系统设置而运行在 xHCI 或 EHCI 状态。

3. USB 2.0 连接插槽（10-1 pin USB1213）

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，将 USB 模块排线连接至任何一个插槽，然后将模块安装到机箱后侧面板中开放的插槽。这些 USB 插槽与 USB 2.0 规格兼容，并支持传输速率最高达 480 Mbps。



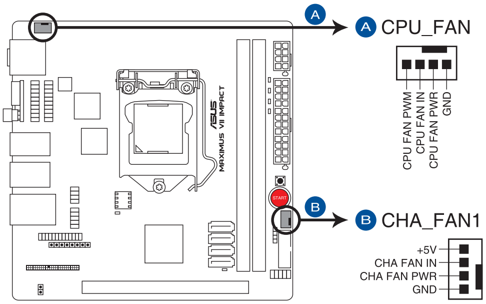
MAXIMUS VII IMPACT USB2.0 connector

请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。

位在主板中央的 USB 2.0 连接端口（USB1213）与 ROG extension（ROG_EXT）连接端口共享。

4. 中央处理器与机箱风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN；4-pin CHA_FAN1）

将风扇排线连接至风扇插槽，并确认每条连接排线的黑线是接到风扇电源插槽上的接地端（GND）。



MAXIMUS VII IMPACT Fan connectors

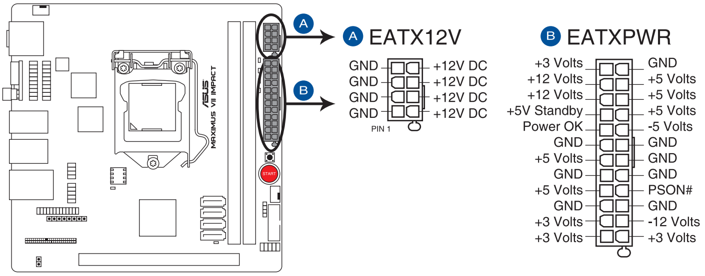
- 千万要记得连接风扇的电源，若系统中缺乏足够的风量来散热，那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机，甚至更严重者会烧毁主板上的电子元件。注意：这些插槽并不是单纯的排针！不要将跳线帽套在它们的针脚上。
- 请确实将 4-pin CPU 风扇排线连接至 CPU 风扇插座上。

CPU_FAN 插槽支持处理器风扇最大达 1 安培（12 瓦）的风扇电源。

Impact CoolHub 配件卡上面附有二个 4-pin 机箱风扇。

5. 主板电源插槽（24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V）

这些电源插槽用来连接一个 ATX 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，仅需稳稳地将之套进插槽中即可。

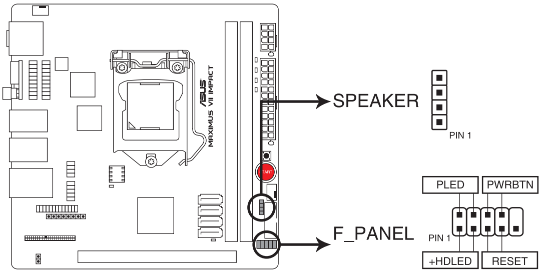


MAXIMUS VII IMPACT ATX power connectors

- 建议您使用与 2.0 规格的 24-pin ATX 12V 兼容的电源（PSU），才能提供至少 350W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。
- 请务必连接 4-pin/8-pin EATX12V 电源插头，否则系统可能无法顺利启动。
- 如果您想要安装其他的硬件设备，请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求，则系统将会变得不稳定或无法开启。

6. 系统前置面板连接排针（10-1 pin PANEL, 4-pin SPEAKER）

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



MAXIMUS VII IMPACT SPEAKER & F_PANEL connectors

- 系统电源指示灯连接排针（2-pin PLED）

  这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁亮着时，即表示电脑正处于睡眠模式中。

- 硬盘动作指示灯号接针（2-pin HDD_LED）

  您可以连接此组 HDD_LED 接针到主板上的硬盘动作指示灯号，如此一旦硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起或闪烁。

- 机箱喇叭连接排针（4-pin SPEAKER）

  这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常启动便可听到哔哔声，若启动时发生问题，则会以不同长短的音调来警示。

- ATX 电源/软关机开关连接排针（2-pin PWRSW）

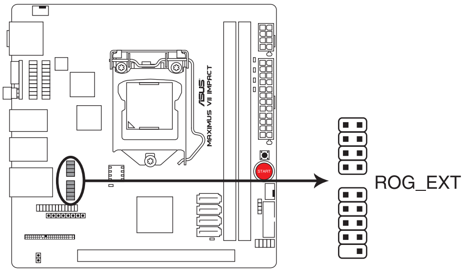
  这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置，来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换，或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机，请持续按住电源开关超过四秒的时间。

- 重置开关连接排针（2-pin RESET）

  这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。

7. ROG Extension - ROG_EXT 插槽（18-1 pin ROG_EXT）

这组插槽可供 OC Panel、Front Base 与其他 ROG 设备连接使用。



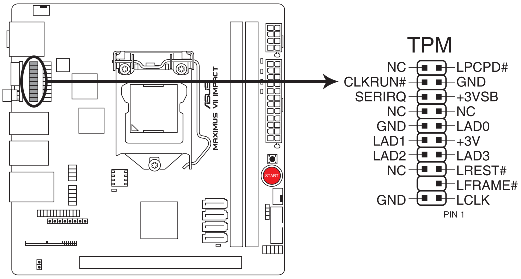
MAXIMUS VII IMPACT ROG_EXT connectors

位在主板中央的 USB 2.0 端口（USB1213）与 ROG extension（ROG_EXT）端口共享。

- OC Panel 与 Front Base 为选购配备，请另行购买。
- 请访问 www.asus.com.cn 网站查询有关 OC Panel 与 Front Base 的相关信息。

8. TPM 插座（20-1 pin TPM）

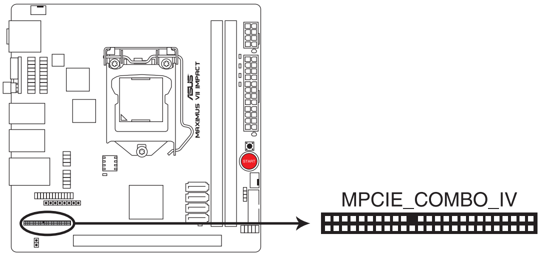
这个插座支持可信任安全平台模块（TPM）系统，用来安全地保存金钥、数字认证、密码和数据。可信任安全平台模块（TPM）系统也用来协助加强网络安全，保护数字身分，以及确保平台的安全性。



MAXIMUS VII IMPACT TPM connector

9. mPCIe Combo IV 连接插槽（50-1 pin MPCIE_COMBO_IV）

这个插槽用来连接本产品内附的 mPCIe Combo IV 卡，提供扩展性与连接性借以获得最佳的系统性能。

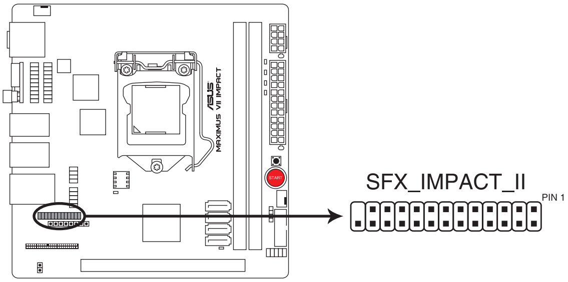


MAXIMUS VII IMPACT MPCIE_COMBO_IV

> 请参考 2.1.11 安装 mPCIe Combo IV 扩展卡 一节的说明。

10. SupremeFX Impact II 连接插槽（26-1 pin SFX_IMPACT_II）

这个插槽用来提供本产品内附的 SupremeFX Impact II 声卡的安装，以提供您连接音频设备，如喇叭、麦克风或耳机等。并提供前端音频面板音频插座，以供机箱上的前端音频输出/输入模块连接。请将产品内附的 SupremeFX Impact II 声卡连接至此插槽。



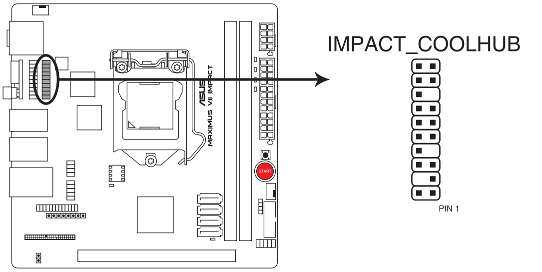
MAXIMUS VII IMPACT SFX_IMPACT_II

> 请使用包装盒随附的 SupremeFX II 声卡来安装在主板的 SupremeFX II 连接端口，其他厂牌的 SupremeFX 声卡可能可以安装但无法完全兼容于 SupremeFX II 插槽。请参考 2.1.3 安装 SupremeFX Imapct II 声卡 一节的说明。

> 本插槽与 MAXIMUS VI Impact 主板所内附的 SupremeFX 声卡为不兼容。请参考 1.2.10 SupremeFX Impact II 声卡 一节的说明。

11. Impact_CoolHub 连接插槽（20-3 pin IMPACT_COOLHUB）

这个插槽用来连接本产品内附的 Impact CoolHub 卡，然后将机箱风扇 3 与 4 安装至 Impact CoolHub 卡。

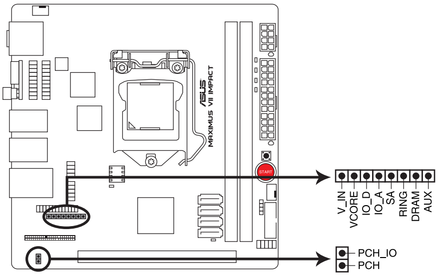


MAXIMUS VII IMPACT IMPACT_COOLHUB connector

请参考 2.1.10 安装 Impact CoolHub 扩展卡 一节的说明。

1.2.9 ProbeIt（探针）功能

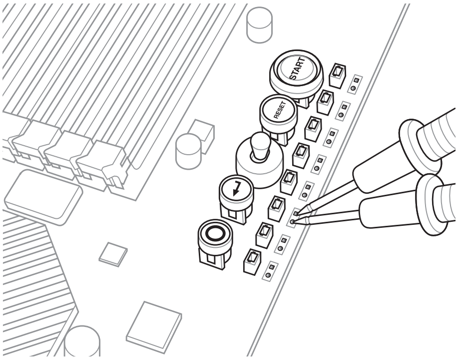
玩家共和国（ROG）的 ProbeIt 功能可帮助您检测电压与超频（OC）设置。建议您在进行超频时，使用万用电表上的探针量测，便可以轻松地取得测量点的数值。



MAXIMUS VII IMPACT ProbeIt

使用 ProbeIt（探针）

将探针接触到如下图中的主板上的测量点，便可以进行检测。



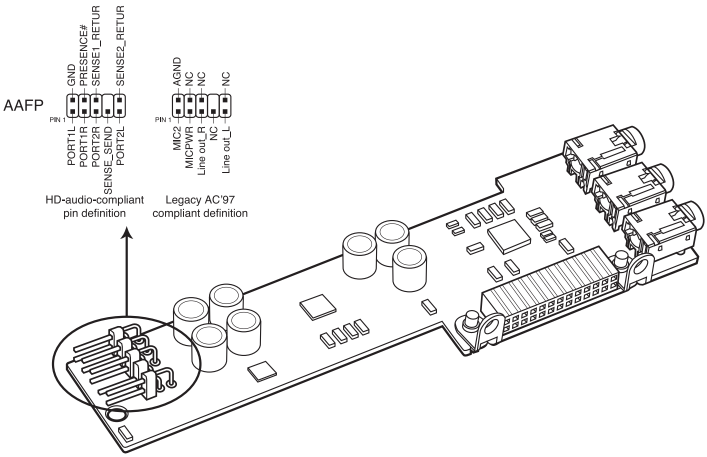
上面的图片仅供参考，主板结构与测量点可能会因不同的型号而有所差异，请依您实际所见的为主。

1.2.10 SupremeFX Impact II 声卡

本产品内附的 SupremeFX Impact II 声卡集成了本主板上所有的音频功能，其包含 3 个音频连接端口，以供您连接至您的音频设备，并且提供 3 组音频端口可供连接至您的音频设备，以及 1 组前面板音频连接排针（AAFP），以得到前置面板更完美的音频解决方案。

1. 前面板音频连接排针（10-1 pin AAFP）

   这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线，除了让您可以轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能，并且支持 AC’97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。

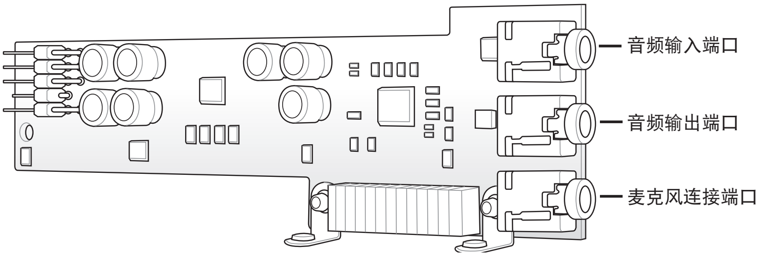


SupremeFX Impact II Analog front panel connector

- 建议您将支持高保真（high definition）音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频或 AC’97 前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD] 或 [AC97]。请参考 3.6.4 系统代理设置 一节的说明。

2. 音频连接端口

这些高保真音频连接端口提供您连接音频设备，如高保真喇叭、麦克风或耳机，以带来超凡的听觉体验。



如欲了解更多关于声道设置与连接的音频设备，请参考 2.3 主板后侧与音频连接端口 一节的说明。

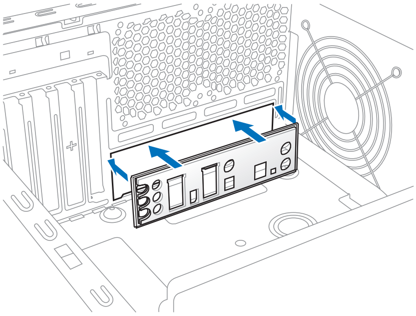
第二章

2.1 创建您的电脑系统

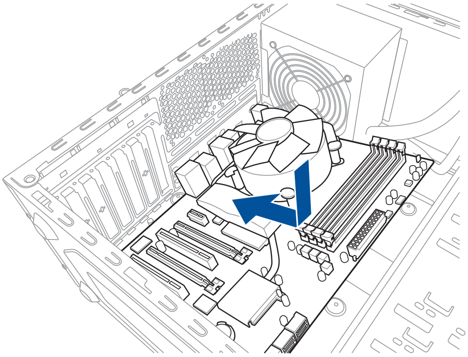
2.1.1 安装主板

本章节的图标仅供参考，主板的结构可能会随着型号而有所不同，但是安装的步骤仍然是相同的。

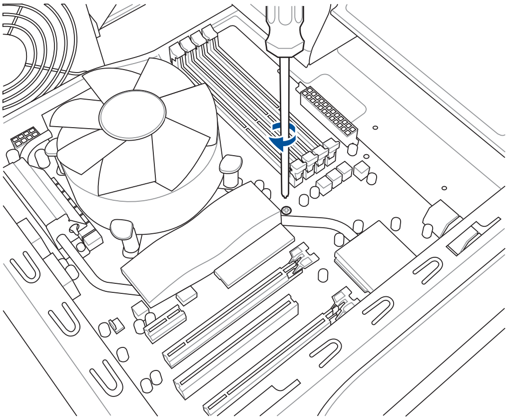
1. 安装华硕 Q-Shield 挡板至机箱的后侧 I/O 面板。

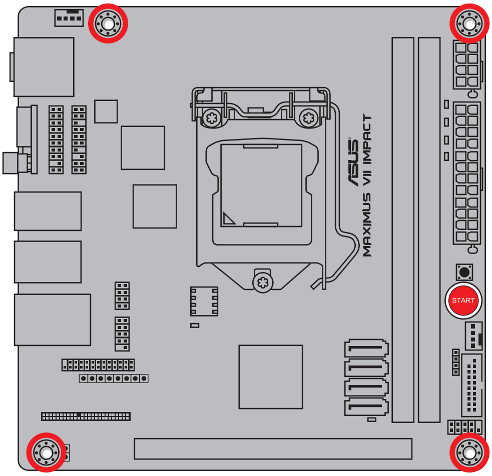


2. 将主板放入机箱，并确认后侧 I/O 连接端口对齐机箱的后侧 I/O 面板。



3. 将四个螺丝放入主板上的螺丝孔并旋转锁紧，以确保将主板锁至机箱。



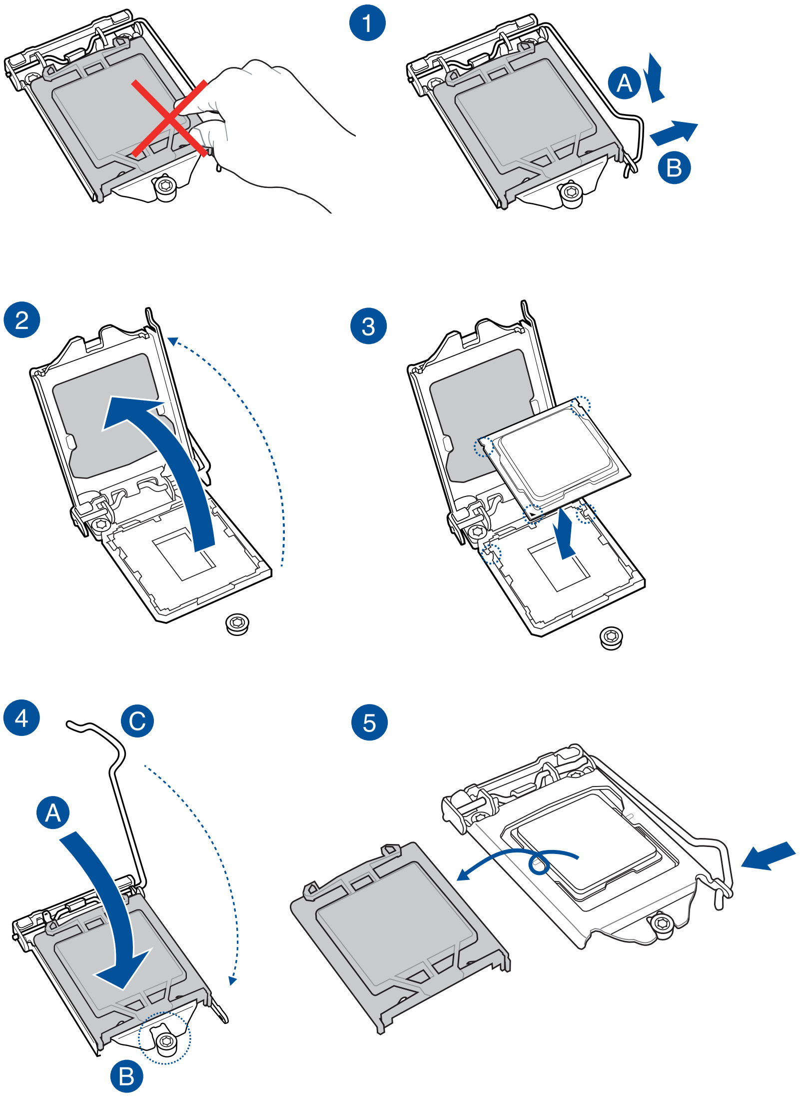


请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

第二章

2.1.2 安装中央处理器

本插槽仅支持 LGA1150 处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。

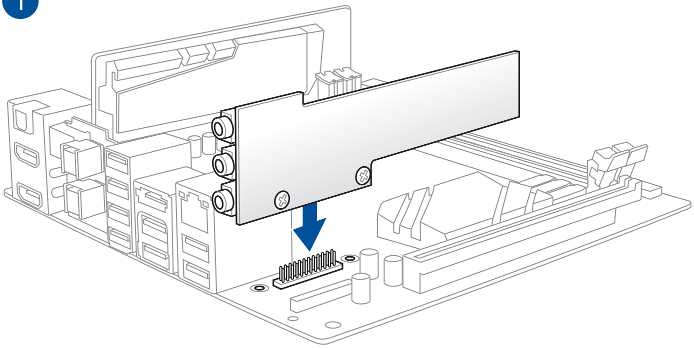


第二章

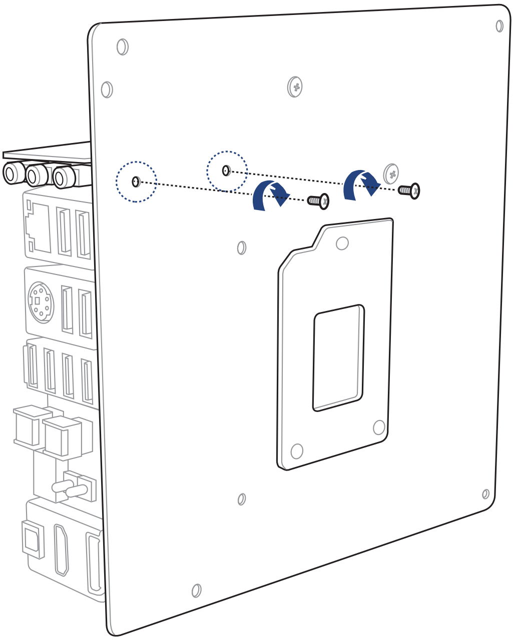
2.1.3 安装 SupremeFX Impact II 声卡

以下图标仅供参考，主板外观会随着您所购买的型号而有不同。

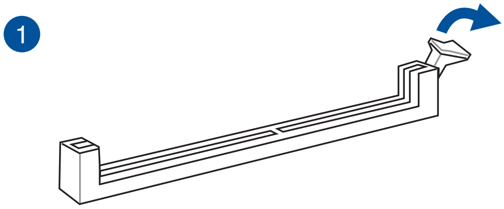
1

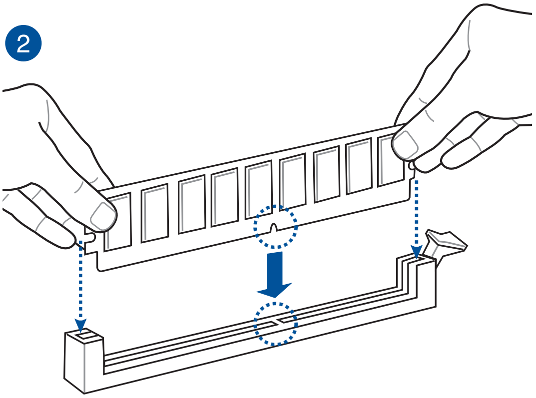


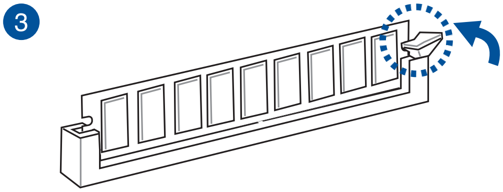
2



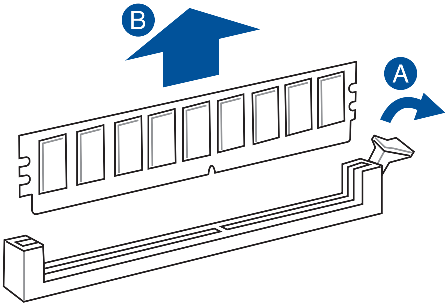
2.1.4 安装内存条



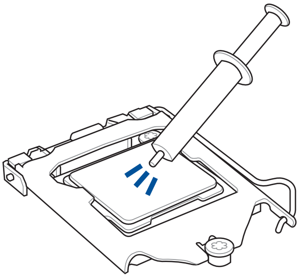




取出内存条



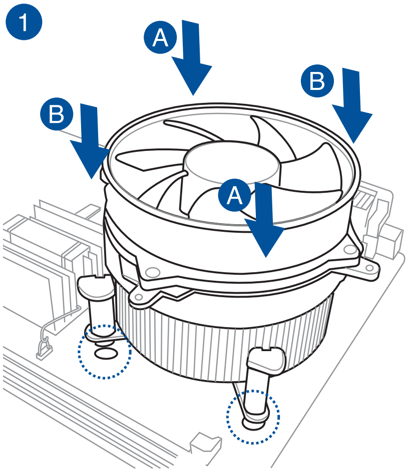
2.1.5 处理器散热片与风扇安装

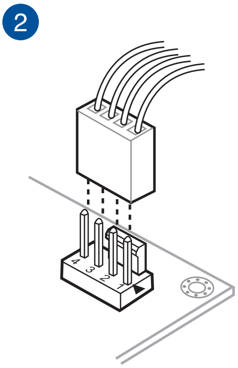


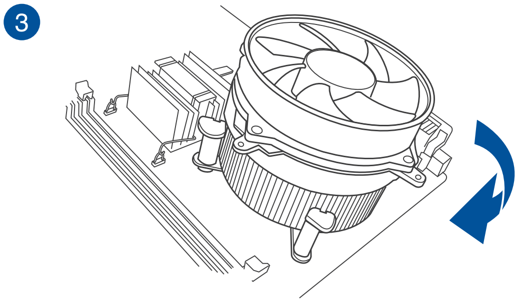
在安装散热片与风扇之前，请先将处理器与散热片涂上散热膏。

第二章

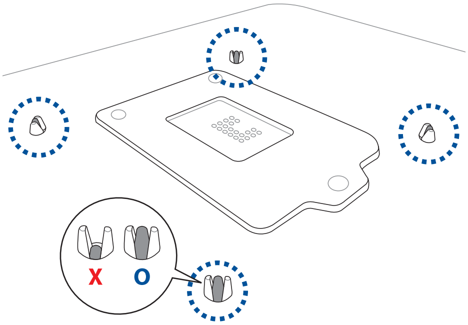
安装 CPU 散热片与风扇



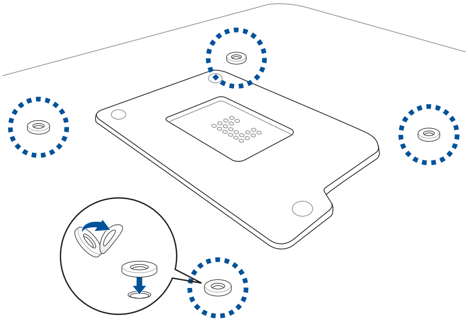




4



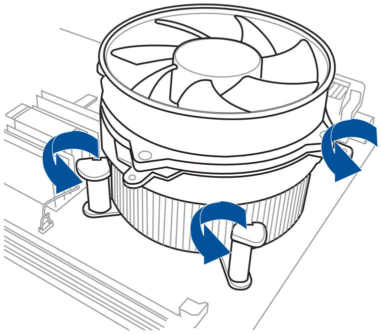
或



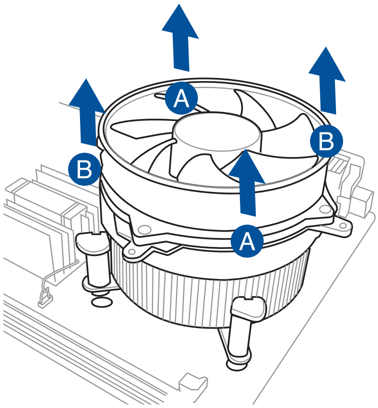
若您安装的 CPU 散热器为不同的的冷却背板设计，建议您使用产品内附的垫圈以提供主板和背板之间更多的空间。撕除垫圈上的黏胶面，并将其黏贴在主板背面的螺丝孔，如上图所示。

取出散热片与风扇

1

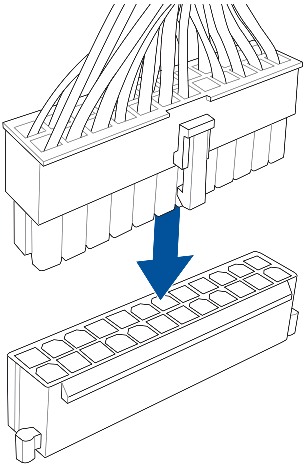


2

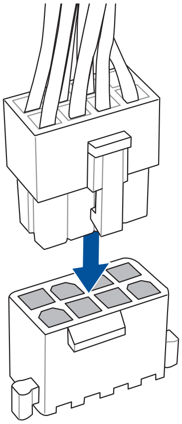


2.1.6 安装 ATX 电源

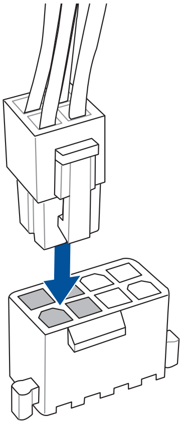
1



2

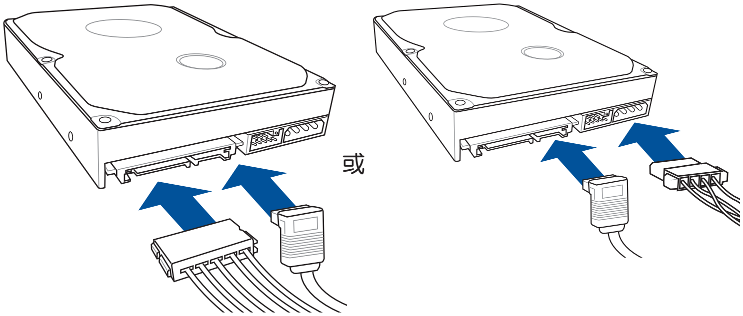


或

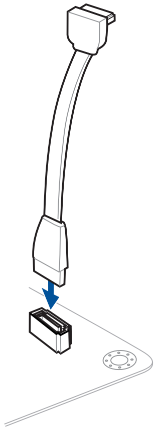


2.1.7 安装 SATA 设备

1

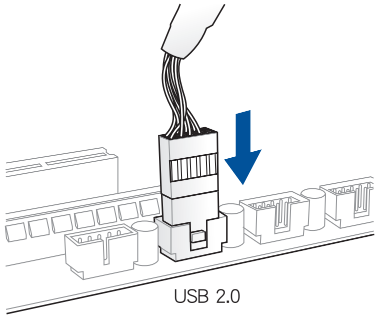


2

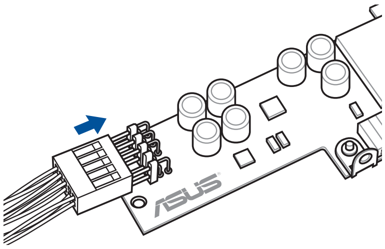


2.1.8 安装前面板输出/输入连接端口

安装 USB 2.0 连接插槽

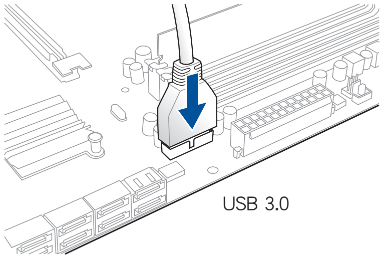


安装前面板音频连接插槽



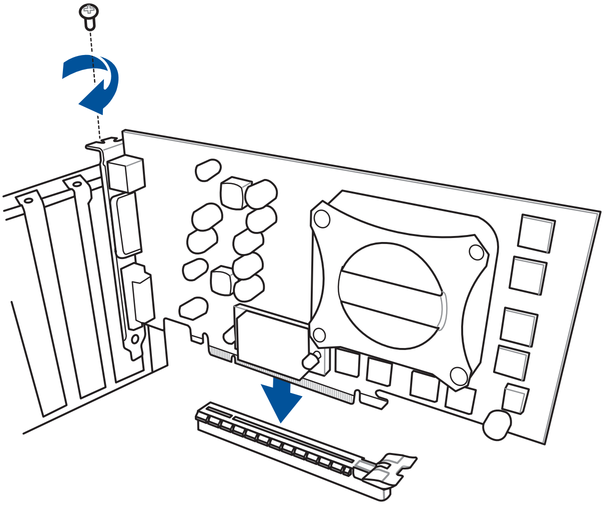
AAFP_PANEL

安装 USB 3.0 连接插槽



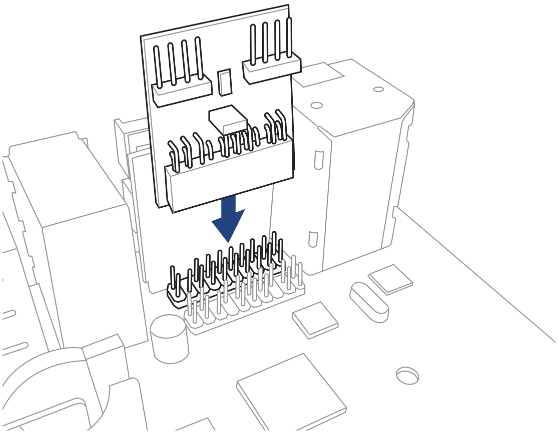
2.1.9 安装扩展卡

安装 PCIe x16 显卡



2.1.10 安装 Impact CoolHub 扩展卡

安装 Impact CoolHub 卡



2.1.11 安装 mPCIe Combo IV 扩展卡

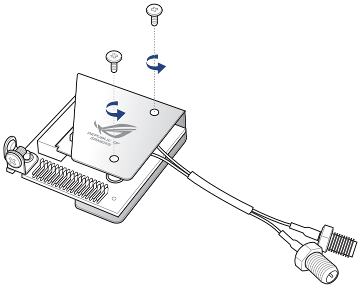
ROG mPCIe Combo IV 扩展卡通过拥有最新连接标准的内置专用连接端口，提供扩展的解决方案。该扩展卡提供具有 mini PCI Express 2.0 及 USB 2.0 规格的 Wi-Fi 与蓝牙模块，并拥有 M.2 (NGFF) 插槽可用来安装 SSD 卡。

- mPCIe Combo IV 扩展卡的一边为支持 26.8mm x 30mm 半尺寸之 mPCIe 模块；另一边为支持 M.2 (NGFF) 类型 2242 (22mm x 42mm)、2260 (22mm x 60mm)、2280 (22mm x 80mm) 或 22110 (22mm x110mm) SSD 卡。
- M.2 (NGFF) SDD 卡为选购配备，请另行购买。
- mPCIe Combo IV 扩展卡仅支持 PCIe 接口。

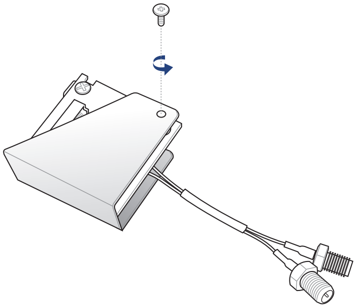
安装 M.2 (NGFF) SSD 模块

请依照以下步骤安装 M.2 (NGFF) SSD 模块：

1. 松开并取出位在 mPCIe Combo IV 扩展卡金属壳背面的二个短螺丝。

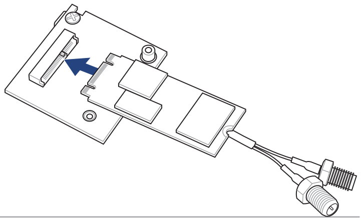


2. 取出前面的长螺丝然后卸除金属壳。



第二章

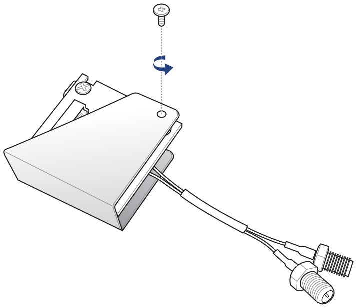
3. 将 M.2（NGFF）SSD 模块对齐并插入 M.2 插槽。



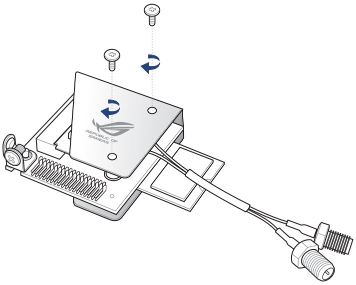
M.2（NGFF）SSD 模块只能以一个方向插入，若无法正确插入时，请翻面再进行安装。

第二章

4. 将金属壳置回，使用步骤 2 中取出的长螺丝将金属壳锁紧。



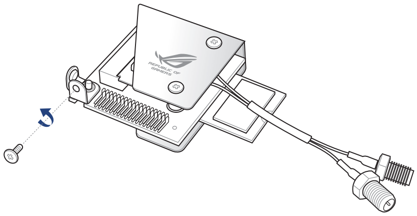
5. 使用步骤 1 中取出的二个短螺丝从金属壳背面锁紧。



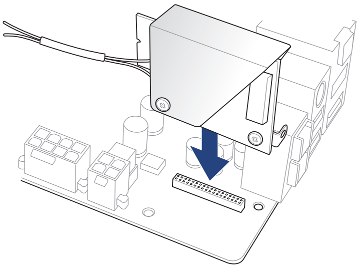
安装 mPCIe Combo IV 扩展卡

请依照以下步骤安装 mPCIe Combo IV 扩展卡至主板：

1. 取出靠近 50-1 pin 接口旁的黑色螺丝。



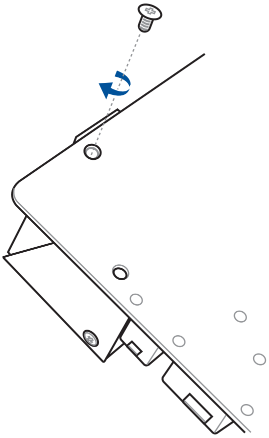
2. 找到主板上 MPCIE_COMBO_IV 连接端口的位置，将 mPCIe Combo IV 扩展卡对齐并插入至 MPCIE_COMBO_IV 连接端口。



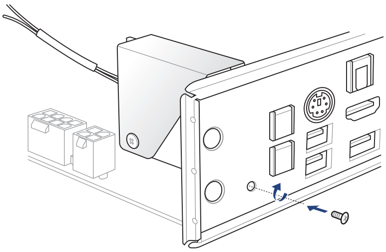
- mPCIe Combo IV 扩展卡只能以一个方向插入。
- 主板的外观会依您所购买之型号而异。

请小心安装 mPCIe Combo IV 扩展卡，以避免造成扩展卡、扩展卡上的连接端口针脚，或是主板的损坏。

3. 使用步骤 1 中取出的黑色螺丝将 mPCIe Combo IV 扩展卡锁至主板或后侧 I/O 文件板。



或



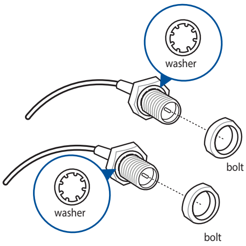
主板的外观会依您所购买之型号而异

第二章

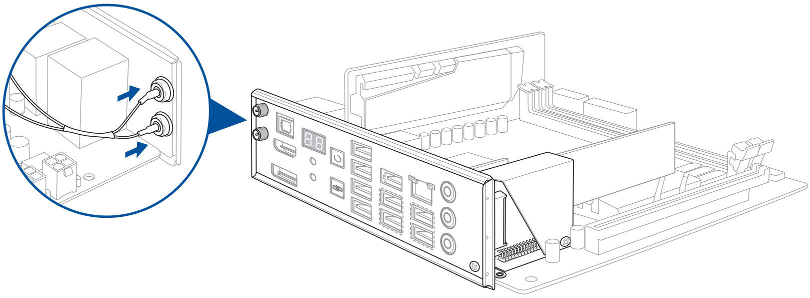
安装 Wi-Fi 天线连接口

请依照以下步骤安装 Wi-Fi 天线连接口：

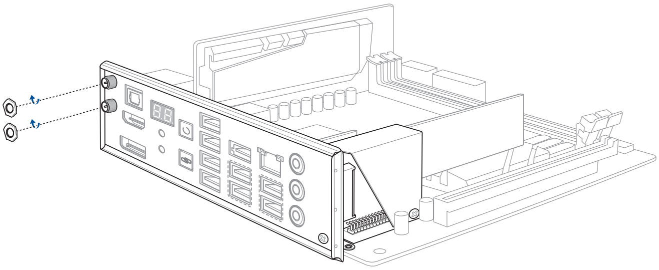
1. 取下 Wi-Fi 天线连接口的螺栓，但请将垫圈留在连接口上。



2. 将连接口插入后侧 I/O 文件板的 Wi-Fi 连接端口安装孔。



3. 再将螺栓锁回天线连接口，并确保天线连接口与后侧 I/O 文件板在正确的位置。



主板的外观会依您所购买之型号而异

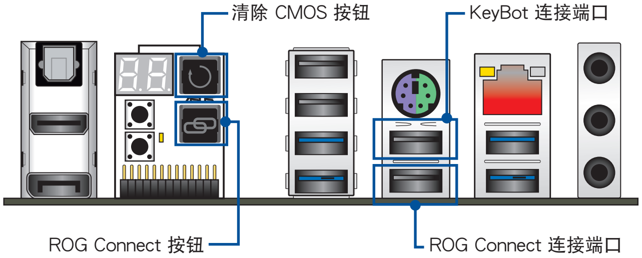
2.2 BIOS 更新应用程序

2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后超频无须再烦恼，并拥有无与伦比的便利性。

使用 USB BIOS Flashback：

1. 从华硕网站下载最新的 BIOS 文件。
2. 将取得的 BIOS 文件更名为 M7I.CAP。
3. 将 M7I.CAP 文件复制到 USB 便携存储设备的根目录底下。
4. 将系统关机并将 USB 存储设备插入 USB BIOS Flashback 连接端口。
5. 按下 ROG Connect 按钮并且当指示灯闪烁亮灯时放掉按钮，此时则表示 BIOS Flashback 功能已经启动。
6. 当指示灯停止闪烁时，即表示更新已经完成。

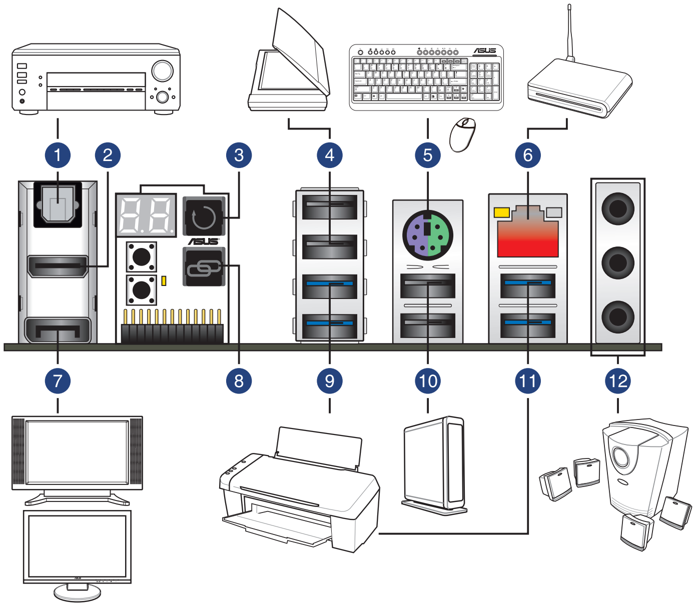


- 若要了解更多有关 BIOS 程序的设置方式，请参考第三章 更新 BIOS 程序 的说明。
- 若您要使用 KeyBot 功能，请将 USB 键盘连接至 KeyBot 连接端口。

更新 BIOS 可能会有风险，若是在更新过程中发生 BIOS 程序丢失导致系统无法重新启动时，请与当地的客服中心联络寻求协助。

2.3 主板后侧与音频连接端口

2.3.1 后侧面板连接端口



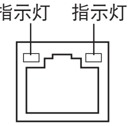
后侧面板连接端口
1. 光纤 S/PDIF 输出端口
2. HDMI 连接端口
3. 清除 CMOS 按钮
4. USB 2.0 连接端口 7-8
5. PS/2 键盘/鼠标复合式连接端口
6. RJ-45 网络连接端口*
7. DisplayPort 连接端口
8. ROG Connect 按钮
9. USB 3.0 连接端口 3-4
10. USB 2.0 连接端口 9-10（上方的连接端口为 KeyBot 专用连接端口，下方的连接端口则支持 USB BIOS Flasback 与 ROG Connect）
11. USB 3.0 连接端口 5-6
12. 音频输出/输入端口**

* 与 **：请参考下页表格中网络连接端口指示灯与音频连接端口的定义。

- 由于 USB 3.0 的限制，USB 3.0 设备只能在 Windows® 操作系统环境下，以及安装过 USB 3.0 驱动程序后才能使用。
- USB 3.0 设备只能用来作为数据磁盘。
- 强烈建议您将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 连接端口，才能让 USB 3.0 设备获得更快更好的性能表现。
- 由于 Intel® 9 系列芯片组的设计，所有连接至 USB 2.0 与 USB 3.0 连接端口的 USB 设备都是由 xHCI 控制器所控制。有些常规的 USB 设备必须更新固件后才能拥有更好的兼容性。

* 网络指示灯之灯号说明

Activity 连线指示灯		Speed 指示灯	
状态	说明	状态	说明
关闭	没有连线	关闭	连线速度 10 Mbps
橘色灯号	已连线	橘色灯号	连线速度 100 Mbps
闪烁	数据传输中	绿色灯号	连线速度 1 Gbps



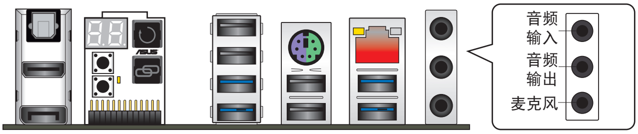
** 2.1、4.1、5.1 或 7.1 声道音频设置

接口	耳机/ 2.1 声道	4.1 声道	5.1 声道	7.1 声道
音频输入	声音输入端	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
音频输出	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
麦克风	麦克风输入	麦克风输入	重低音/中央声道	重低音/中央声道
耳机（前面板）	-	-	-	侧边喇叭输出

- 音频接口检测（Jack-retasking）功能支持 4.1、5.1 与 7.1 声道音频输出，请开启 Realtek HD Audio Manager 程序以进行音频接口检测（Jack-retasking）功能设置。
- 如欲使用 7.1 声道音频输出，请确认您的机箱前置面板有提供 HD 音频模块。

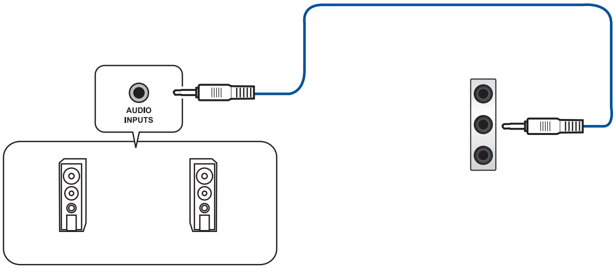
2.3.2 音频输出/输入连接图标说明

音频输出/输入连接端口

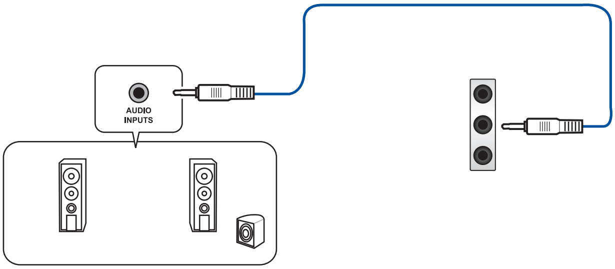


连接耳机与麦克风

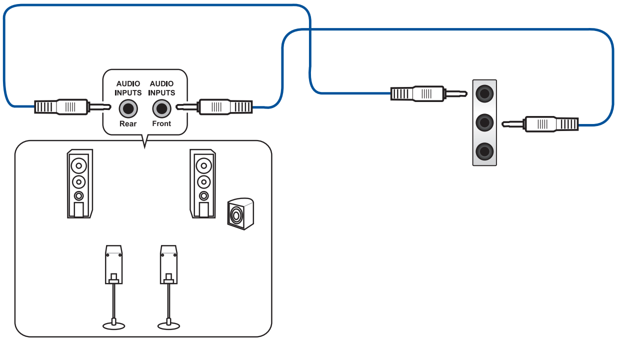
连接立体声喇叭



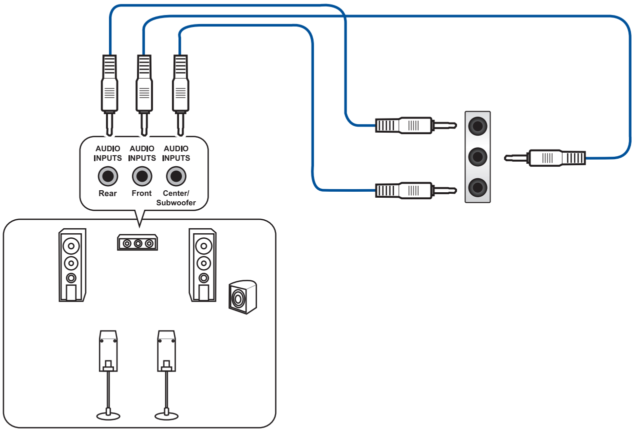
连接 2.1 声道喇叭



连接 4.1 声道喇叭

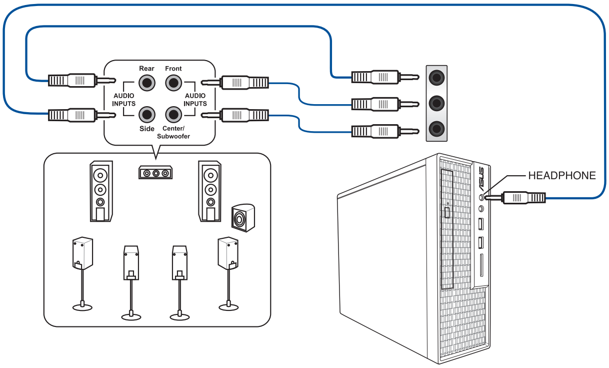


连接 5.1 声道喇叭



第二章

连接 7.1 声道喇叭


Rear
Front
AUDIO INPUTS
AUDIO INPUTS
Side
Center/ Subwoofer
HEADPHONE

2.4 第一次启动电脑

1. 确认所有排线与接脚都接妥，然后盖上机箱的外盖。
2. 确定所有的开关都已关闭
3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
4. 情况许可的话，最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
5. 您可以先开启以下周边的电源：
    a. 显示屏
    b. 外接式 SCSI 接口外围设备（从串连的最后端开始）
    c. 系统电源
6. 送电之后，机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的话，必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源，电源指示灯此时才会亮起。如果您的电脑符合绿色省电标准，已随时准备可以进入省电模式的话，显示屏指示灯也会亮起。如果启动过程一切顺利的话，不久就可以在显示屏上看到画面了，如果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话，表示电脑的设置尚有问题存在，请再进一步地的检查各项动作，如果还是不行，就需要向厂商求助了！

BIOS 哔声所代表的意义

哔声	代表意义
一短哔声	检测到 VGA 显卡 快速启动设置为关闭 没有键盘被检测到
一连续哔声后跟随两短哔声，暂停一下然后重复	没有内存被检测到
一连续哔声后跟随三短哔声	没有 VGA 显卡被检测到
一连续哔声后跟随四短哔声	硬件组件失效

7. 在电源开启之后可按下 <Del> 键以进入 BIOS 的设置模式，详细设置方法请看本用户手册的第三章内容。

2.5 关闭电源

当系统在启动状态，压着电源开关少于四秒钟，系统会根据 BIOS 的设置，进入睡眠或软启动模式；若是压着电源开关多于四秒，不论 BIOS 的设置为何，系统则会直接进入软启动模式。

第三章

3.1 认识 BIOS 程序

华硕全新的 UEFI BIOS 是可延伸固件界面，符合最新的 UEFI 架构，这个友善的使用界面，跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式，提供更有弹性与更便利的鼠标控制操作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的操作系统般顺畅。在本用户手册中的「BIOS」一词除非特别说明，所指皆为「UEFI BIOS」。

BIOS（Basic Input and Output System；基本输出入系统）用来保存系统启动时所需要的硬件设置，例如存储设备设置、超频设置、高级电源管理与启动设置等，这些设置会保存在主板的 CMOS 中，在正常情况下，默认的 BIOS 程序设置提供大多数使用情况下可以获得最佳的运行性能，建议您不要更改默认的 BIOS 设置，除了以下几种状况：

- 在系统启动期间，屏幕上出现错误信息，并要求您运行 BIOS 程序设置。
- 安装新的系统元件，需要进一步的 BIOS 设置或更新。

不适当的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或启动失败，强烈建议您只有在受过训练专业人士的协助下，才可以运行 BIOS 程序设置的更改。

下载或更新 BIOS 文件时，请将文件名称更改为 M7I.CAP 给本主板使用。

3.2 BIOS 程序设置

使用 BIOS Setup（BIOS 设置）功能可以更新 BIOS 或设置其参数。BIOS 设置画面包含导览键与简要的画面辅助说明，以指示您使用 BIOS 设置程序。

当启动时进入 BIOS 设置程序：

- 当进入启动自我测试（POST）过程时，按下 <Delete> 键可以进入 BIOS 设置画面。若您未按下 <Delete> 键，则启动自我测试（POST）功能会继续进行。

当 POST 结束后才进入 BIOS 设置程序：

- 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 键。
- 或是按下机箱上的 RESET（重置）键重新启动。
- 或是将按下机箱上的电源按钮，将电脑关闭后再重新启动。如果前两种方式无效，再选用最后一种方式。
- 然后再于启动自我测试（POST）过程时按下 <Delete> 键进入 BIOS 设置画面。

- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考，将可能与您所见到的画面有所差异。
- 若要在 BIOS 设置程序中使用鼠标操控，请先确认已将 USB 鼠标连接至主板。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能，但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定，请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请选择 Exit 菜单中的 Load Optimized Defaults 项目或按下 <F5> 键，请参阅 3.10 退出 BIOS 程序 一节中的详细说明。
- 若是更改 BIOS 设置后启动失败，请试着使用清除 CMOS，然后将主板的设置值恢复为默认值。请参考 1.2.6 主板上的内置按钮与开关一节关于 CMOS 配置数据清除按钮（CLR_CMOS）的说明。
- BIOS 设置程序不支持蓝牙设备。

BIOS 菜单画面

本主板的 BIOS 设置程序提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 两种模式。您可以由 Exit 菜单中切换，或是选择 EZ Mode/Advanced Mode 菜单中的 Exit/Advanced Mode。

3.2.1 EZ Mode

本主板的 BIOS 设置程序的默认值为 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中查看系统基本数据，并可以选择显示语言、喜好设置及启动设备顺序。若要进入 Advanced Mode，请点击 Exit/Advanced Mode 然后选择 Advanced Mode，或是按下 <F7> 快捷键。

> 进入 BIOS 设置程序的画面可以做个人化设置，请参考 3.8 启动菜单（Boot menu）中关于 Setup Mode 项目的说明。

> 启动设备的选项将依您所安装的设备而异。

第三章

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更高级的 BIOS 设置选项。以下为 Advanced Mode 画面之范例，各个设置选项的详细说明请参考之后的章节。

> 若要从 EZ Mode 切换至 Advanced Mode，请点击 Advanced Mode(F7)，或是按下 <F7> 快捷键。

第三章

功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

My Favorites	本项目将记录时常使用的系统设置及设置值。
Extreme Tweaker	本项目提供超频设置。
Main	本项目提供系统基本设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Monitor	本项目提供温度、电源及风扇功能设置。
Boot	本项目提供启动磁盘设置。
Tool	本项目提供特殊功能设置。
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

菜单项目

于功能表列选定选项时，被选择的功能将会反白，即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目（例如：My Favories、Extreme Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。

子菜单

在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

语言

这个按钮位在功能表列的上方，用来选择 BIOS 程序接口显示的语言。点击这个按钮来选择您想要的 BIOS 画面显示语言。

我的最爱（F3）

这个按钮位在功能表列的上方，以树状图显示所有的 BIOS 项目。选择常用的 BIOS 设置项目并保存至我的最爱菜单。

> 请参考 3.3 我的最爱（My Favorites） 一节以获得更多信息。

Q-Fan Control（F6）

这个按钮位在功能表列的上方，用来显示风扇现在的设置。使用这个按钮来手动调整风扇至您想要的设置值。

> 请参考 3.2.3 Q-Fan Control 一节以获得更多信息。

EZ Tuning 向导（F11）

这个按钮位在功能表列的上方，用来查看和调整系统的超频设置，也可以让您将主板的 SATA 模式从 AHCI 更改为 RAID 模式。

> 请参考 3.2.4 EZ Tuning Wizard 一节以获得更多信息。

快速笔记（F9）

按下此按钮可让您针对已在 BIOS 中进行的设置输入笔记。

- 快速笔记不支持以下键盘功能：删除、剪下、复制与贴上。
- 您只能使用英文字母与数字来输入笔记。

快捷键

这个按钮位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程序设置的导引方向键，使用箭头按键来选择菜单中的项目并更改设置。

滚动条

在菜单画面的右方若出现滚动条，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

在线操作说明

在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动更改。使用 <F12> 按键来抓取 BIOS 屏幕画面，并保存至携带式存储设备。

设置值

此区域显示菜单项目的设置值。这些项目中，有的功能选项仅为告知用户当前运行状态，并无法更改，此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目，当您使用方向键移动项目时，被选择的项目以反白显示。

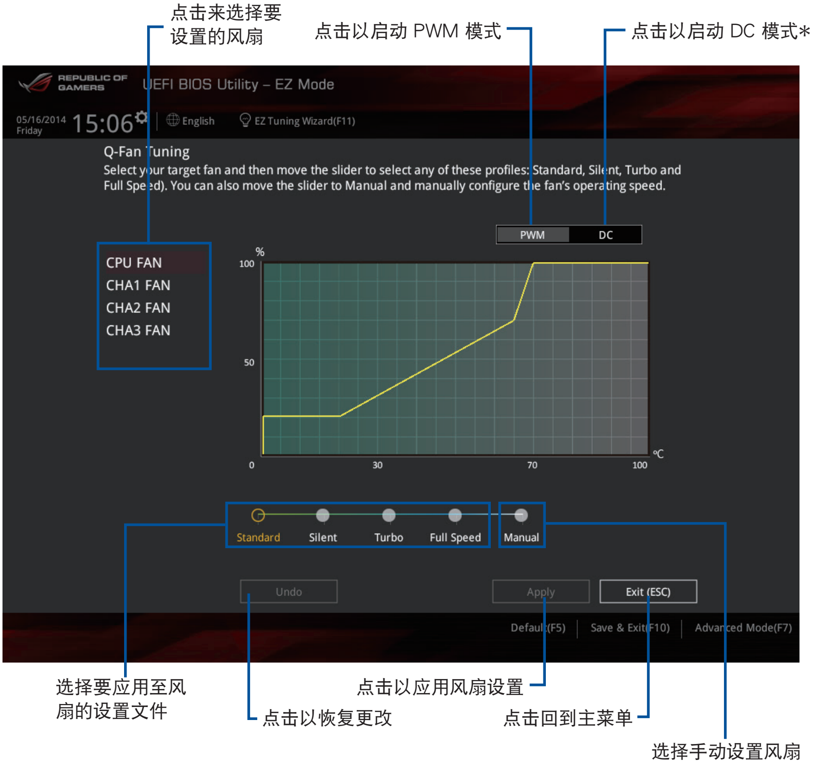
设置值被选择后以反白显示。要改变设置值请选择此项目，并按下 <Enter> 键以显示设置值列表。

上次修改的设置按钮

按下此按钮可查看您在 BIOS 设置中上一次所做的修改项目。

3.2.3 Q-Fan Control

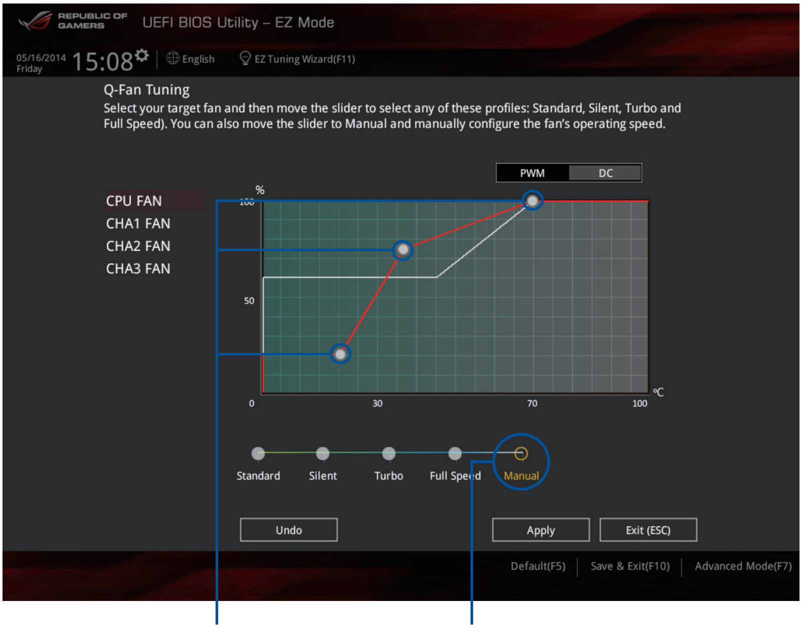
Q-Fan Control 用来设置风扇设置文件，或手动设置处理器与机箱风扇的运行速度。



* 只有 CPU 风扇可以切换为 DC 模式或 PWM 模式。

手动设置风扇

从设置文件清单中选择 Manual 来手动设置风扇运行的速度。



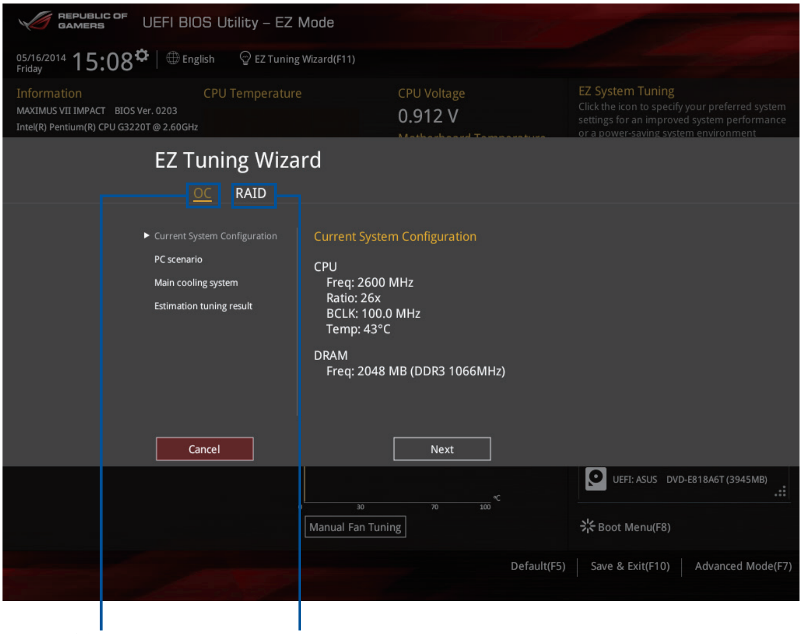
请依照以下步骤设置风扇：

1. 选择想要设置的风扇并查看该风扇现在的状况。
2. 点击并拖曳速度点来调整风扇的运行速度。
3. 点击 应用（Apply） 以保存更改然后点击 Exit (ESC)。

第三章

3.2.4 EZ Tuning 向导

EZ Tuning 向导用来超频处理器和内存条、电脑使用与处理器风扇至最佳设置。通过这个功能您也可以轻松设置系统的 RAID 功能。



调整系统设置

请依照以下步骤调整设置：

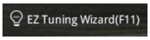
1. 在键盘按下 <F11> 键或在 BIOS 程序画面中点击 EZ Tuning Wizard(F11) 来启动 EZ Tuning 向导窗口，然后点击 下一步（Next）。
2. 选择电脑状态为 Daily Computing 或 Gaming/Media Editing，然后点击 下一步（Next）。
3. 选择安装的处理器风扇类型（Box cooler、Tower cooler 或 Water cooler）然后点击 下一步（Next）。

若是无法确定处理器风扇类型，点击 我不确定（I’m not sure），系统将会自动检测处理器风扇类型。

4. 点击 下一步（Next） 然后点击 确定（Yes） 来确认自动调整。

创建 RAID

请依照以下步骤创建 RAID：

1. 在键盘按下 <F11> 键或在 BIOS 程序画面中点击  来启动 EZ Tuning 向导窗口，然后点击 下一步（Next）。

2. 点击 RAID 然后点击 下一步（Next）。

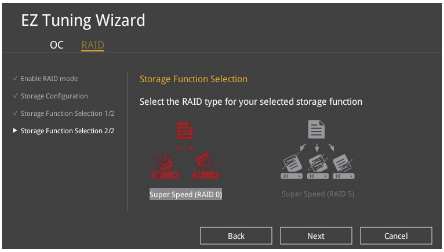
- 请确认硬盘中没有已存在的 RAID 磁盘。
- 请确认硬盘已经连接至 Intel® SATA 连接端口。

3. 选择 RAID 的保存类型为 Easy Backup 或 Super Speed，然后点击 下一步（Next）。

   a. 若为 Easy Backup，点击 下一步（Next） 然后选择从 Easy Backup（RAID1） 或 Easy Backup (RAID10)。

   若您安装了四个硬盘，可以只选择 Easy Backup (RAID 10)。

   b. 若为 Super Speed，点击 下一步（Next） 然后选择从 Super Speed（RAID0） 或 Super Speed (RAID5)。

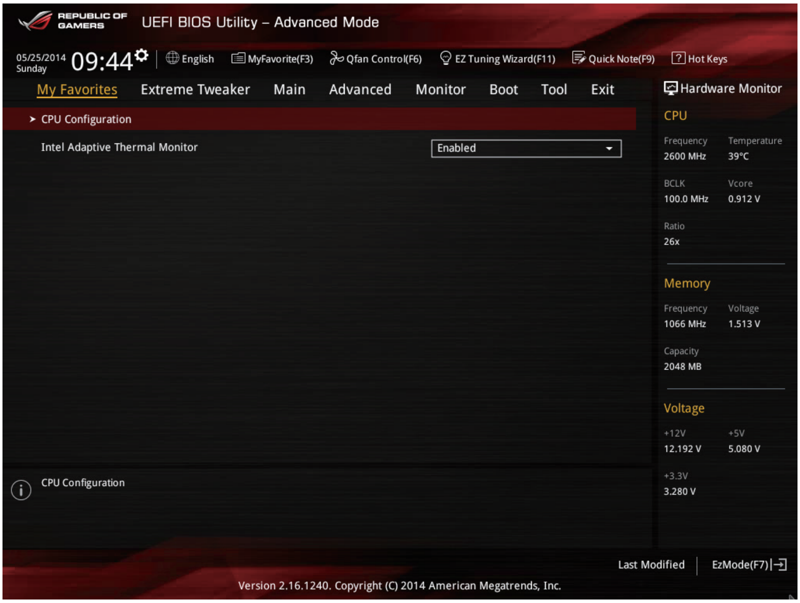


4. 选择好 RAID 类型后，点击 下一步（Next） 然后再点击 确定（Yes） 来继续 RAID 设置。

5. 完成 RAID 设置后，点击 Yes 离开 RAID 设置，然后再点击 OK 来重新启动系统。

3.3 我的最爱（My Favorites）菜单

本菜单是专属您个人空间，让您在此轻易存入和读取您所喜爱的 BIOS 项目。

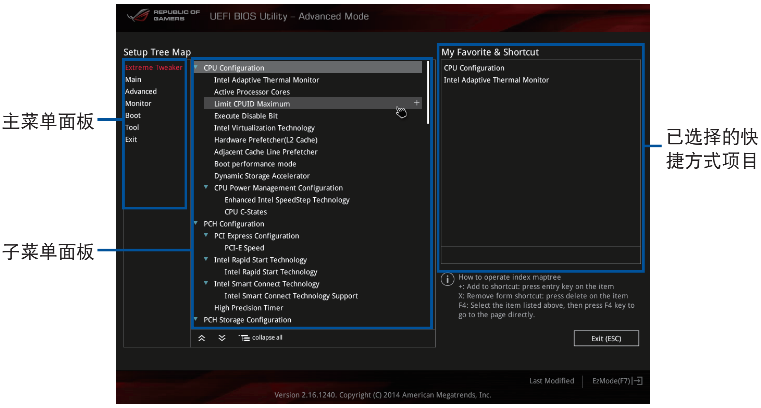


第三章

新增项目至我的最爱

请依照以下步骤新增项目至我的最爱：

1. 在键盘按下 <F3> 键或在 BIOS 程序画面中点击 (F3)MyFavorite 来启动设置树状图画面。
2. 在设置树状图画面中选择想要保存至我的最爱的 BIOS 项目。



3. 从主菜单面板选择项目，然后点击子菜单中想要保存至我的最爱的选项，再点击或轻触 + 或是按下 <Enter> 按键。

以下项目无法加入至我的最爱：

- 有子菜单的项目。
- 用户自订项目，例如：语言、启动设备顺序。
- 设置项目，例如：内存 SPD 信息、系统时间与日期。

4. 点击 Exit (ESC) 或按下 <esc> 键来关闭树状图窗口。
5. 到我的最爱菜单查看已保存的 BIOS 项目。

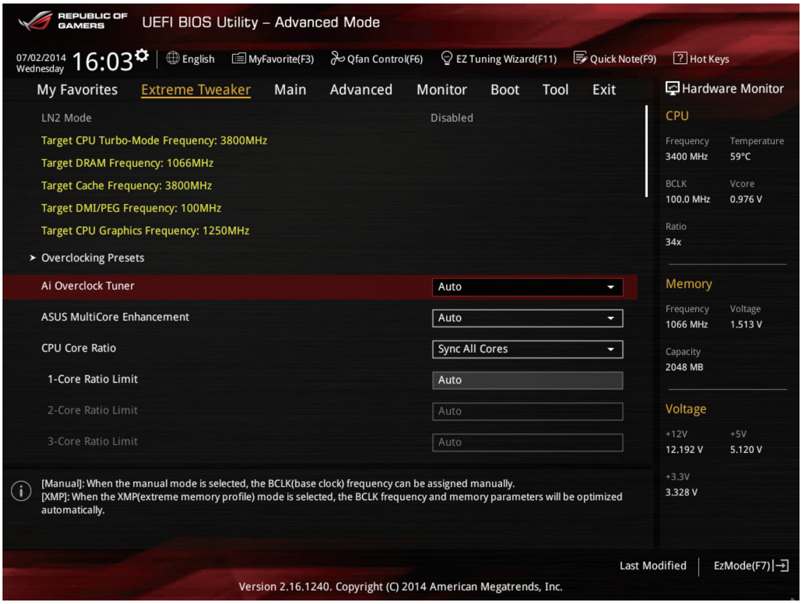
3.4 Extreme Tweaker 菜单

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。

注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。

以下项目中所默认的数值，可能会随您所安装在主板上的 CPU 型式与内存条而有所不同。

将滚动条往下滚动来显示以下项目。



Overclocking Presets [Auto]

本项目用来载入各种默认的超频设置，您可以从以下这些项目选择超频的默认值。

Load Gamer’s OC Profile

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 82 BCLK Profile

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 190 BCLK Profile

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 195 BCLK Profile

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 200 BLCK Profile

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 3700 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 3800 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 3842 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 3900 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

设置值有：[OK] [Cancel]。

Load 3930 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

设置值有：[OK] [Cancel]。

Ai Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 内频。请选择以下任一种默认的超频选项：

[Auto]	自动载入系统最佳化设置值。
[Manual]	可让您独立设置超频参数。
[X.M.P.]	若您安装的内存有支持 eXtreme Memory Profile（X.M.P.）技术，请选择本项目来设置内存参数有效运行。

- 当您安装支持 eXtreme Memory Profile [X.M.P.] 技术的内存条时，才会显示 [X.M.P.] 设置选项。
- 以下项目只有在 Ai Overclocking Tuner 设置为 [Manual] 或 [X.M.P.] 时才会显示。

CPU Strap [Auto]

本项目提供您选择一个接近目标 BCLK（基本时钟）的 strap，或按照原本设置为 [Auto] 来让 BIOS 自动决定。设置值有：[Auto] [100MHz] [125MHz] [167MHz] [250MHz]。

PLL Selection [Auto]

本项目设置 LC PLL 为默认值以获得更好的稳定度。当 BCLK（基本时钟）已经超过 100MHz 很多时请选择 SB PLL。这项设置可能会影响其他需要精确时钟频率的设备。设置值有：[Auto] [LC PLL] [SB PLL]。

Filter PLL [Auto]

在当运行高或低 BCLK 时，提供您选择 BCLK（基本时钟）模式。设置值有：[Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]。

BCLK Frequency [100.0]

提供您设置 BCLK 频率以增强系统性能。使用 <+> 或 <-> 键以调整数值。数值的范围为从 80.0MHz 至 300.0MHz。

建议您依照处理器规格设置数值，设置过高的数值可能造成处理器永久性的损害。

当 Ai Overclocking Tuner 设为 [X.M.P.] 且安装支持 XMP 模式的内存条时才会显示。

ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

[Auto]　　通过华硕核心比率的设置，可以获得最佳超频性能的最大值。

[Disabled]　　本项目用来设置默认的核心比率。

CPU Core Ratio [Sync All Cores]

本项目用来设置 CPU 比值与自动同步、每个核心或所有核心。设置值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]

当 CPU Core Ratio 设置为 [Sync All Cores] 时会出现以下项目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。

当 CPU Core Ratio 设置为 [Per Core] 时会出现以下项目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 2-Core Ratio Limit 数值高于或等于 3-Core Ratio Limit。

若要指派一个数值给 2-Core Ratio Limit，请勿将 1-Core Ratio Limit 设置为 [Auto]。

3-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 3-Core Ratio Limit 数值高于或等于 4-Core Ratio Limit。

若要指派一个数值给 3-Core Ratio Limit，请勿将 1-Core Ratio Limit 与 2-Core Ratio Limit 设置为 [Auto]。

4-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 4-Core Ratio Limit 数值高于或等于 3-Core Ratio Limit。

> 若要指派一个数值给 4-Core Ratio Limit，请勿将 1-Core Ratio Limit、2-Core Ratio Limit 与 3-Core Ratio Limit 设置为 [Auto]。

Min CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的非核心比值至可能的最小值。使用 <+> 与 <-> 按键来调整数值。更改的范围会依安装的处理器而异。

Max CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的非核心比值至可能的最大值。使用 <+> 与 <-> 按键来调整数值。更改的范围会依安装的处理器而异。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

本项目用来设置 Internal PLL 电压，让 K 型号的处理器能获得最大的超频性能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

BCLK Frequency：DRAM Frequency Ratio [Auto]

本项目用来设置 BCLK 频率至 DRAM 频率倍频。

[Auto]	BCLK 频率至 DRAM 频率设为最佳化设置值。
[100:100]	BCLK 频率至 DRAM 频率倍频设置为 100:100。
[100:133]	BCLK 频率至 DRAM 频率倍频设置为 100:133。

DRAM Frequency [Auto]

本项目可以让您设置内存的运行频率。设置选项会随着 BCLK（基础时钟）Frequency 设置值变动。

Xtreme Tweaking [Disabled]

本项目会增强部分测试性能。设置值有：Enabled] [Disabled]。

CPU Level Up [Auto]

提供您选择 CPU 层级，且这个可选择的参数会依照所选择的 CPU level 而有自动调整。

> CPU Level 数值会因您实际安装的处理器而有所不同。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

华硕 EPU 可以将处理器设置为最小能耗，启动本功能来设置较低的 CPU VCCIN 与 Vcore 电压，以达到最佳能源节省状态。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

DRAM Timing Control

本项目提供设置 DRAM 时钟控制功能，可以使用 <+> 和 <-> 键来调整数值。若要恢复至默认值，请使用键盘输入 [auto]，然后按下 <Enter> 键。

Memory Presets

本项目提供选择与载入内存默认值或时钟参数配置文件。此为由 ROG OC 专家团队提供内存默认配置，让用户可以在进行超频或调整 DRAM 之前载入配置文件。

Load 2x2GB Elpida Hyper 1.8V 2133

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB PSC 1.65V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB 1T PSC 1.85V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB PSC 1.85V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB LN2 PSC 1.85V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB BBSE 1.65V 2200

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB BBSE 1.85V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB LN2 BBSE 2.0V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.65V 2666

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2666

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2666

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2800

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.65V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2750

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB LN2 Hynix 2.0V 2800

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.65V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.85V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB New Single-sided 1.85V 3000

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Samsung 1.65V 2400

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Samsung 1.80V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Hynix 1.85V 2600

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB New Hynix 1.85V 2933

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix MRF 1.75V 2933

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix MRF 1.75V 3100

设置值有：[Yes] [No]。

Load 2GB RAW MHz

设置值有：[Yes] [No]。

Load 4GB/8GB RAW MHz

设置值有：[Yes] [No]。′

Maximus Tweak [Auto]

[Auto]	提供系统设置内存兼容性、超频与系统性能。
[Mode 1]	协助系统内的内存兼容。
[Mode 2]	协助超频与稳定系统性能。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [63]。

DRAM COMMAND Rate [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [2]。

Latency Boundary A [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [28]。

Latency Boundary B [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [14]。

第三章

Latency Compensator [Auto]

本项目若启用后可增强超频性能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [15]。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [511]。

DRAM Refresh Interval [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [65535]。

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [16]。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [15]。

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [255]。

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [15]。

DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [15]。

DRAM CAS# Write Latency [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R0D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R0D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R1D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R1D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R0D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R0D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R1D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R1D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM IO-L (CHA_R0D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R0D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R1D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R1D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R0D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R0D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R1D0) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R1D1) [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]。

Third Timings

tRDRD [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [7]。

tRDRD_dr [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

tRDRD_dd [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

tWRRD [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [63]。

tWRRD_dr [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

tWRRD_dd [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

tWRWR [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [7]。

tWRWR_dr [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

tWRWR_dd [Auto]

设置值有：[Auto] [1] － [15]。

Dec_WRD

设置值有：[Auto] [0] – [1]。

tRDWR [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

tRDWR_dr [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

tRDWR_dd [Auto]

设置值有：[Auto] [1] – [31]。

MISC

Eventual DRAM Voltage

本项目可以设置在进入操作系统前重新指派 DRAM 电压。使用 <+> 与 <-> 按键来调整数值。数值会依照安装的处理器而异。

MRC Fast Boot [Auto]

本项目提供启用、关闭或自动设置 MRC 快速启动功能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DRAM CLK Period [Auto]

本项目用来选择内存时钟周期。设置值有：[Auto] [1] – [14]。

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]

提供您启用或关闭 Channel A 内存插槽采用以下的设置值。设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control [Enable Bot...]

提供您启用或关闭 Channel B 内存插槽采用以下的设置值。设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Scramble Setting [Optimized (ASUS)]

将本项目设置为 [Optimized (ASUS)] 以增强系统稳定性。设置值有：[Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]。

MCH Full Check [Auto]

设置本项目为 [Enabled]，可以增强系统稳定性。设置为 [Disabled]，则可以增强 DRAM 超频的兼容性：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DQ Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] – [-29]。

DQS Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] – [-29]。

第三章

CMD Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] – [-29]。

DRAM Swizzling Bit 0-4 [Auto]

将本项目设置为 [Enabled] 以增强超频能力。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

RAW MHz Aid [Auto]

将本项目设置为 [Enabled] 以增强超频能力但会妥协于系统性能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

IC Optimizer [Auto]

使用独特的 IC 内存条时，将本项目设置为 [Enabled] 以增强超频能力。设置值有：[Auto] [4GB Samsung] [4GB New Hynix] [4GB Old Hynix] 。

DRAM Additional Training [Auto]

将本项目设置为 [Enabled] 以增强内存超频能力。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Skew Control

以下的子项目可让您获得更佳的内存超频能力与稳定性。

Transmitter Rising Slope [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

Transmitter Falling Slope [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

Transmitter Control Time [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Rising Slope [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Falling Slope [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Control Time [Auto]

设置值有：[Auto] [0] - [31]。

ODT RTT WR (CHA) [Auto]

设置值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT NOM (CHA) [Auto]

设置值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [20 DRAM Clock] [30 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT WR (CHB) [Auto]

设置值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT NOM (CHB) [Auto]

设置值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [20 DRAM Clock] [30 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

GPU.DIMM Post

本项目自动检测和显示安装的 PCIe 设备与内存状态。若该字段显示为 N/A，则表示该插槽并未安装此设备。

External DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根据 Intel® 所订立之 VRM 规格，其设置值将影响 CPU 电压。CPU 运行电压将依 CPU 的负载呈比例性递减，当您将此项目的设置值设置越高时，将可提高电压值与超频能力，但会增加 CPU 及 VRM 的温度。请从 Level 1 至 9 来调整处理器电源电压从 0% 至 125%。设置值有：[Auto] [Level 1] - [Level 9]。

> 实际提升的性能将视 CPU 型号而异。

> 请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本项目会影响 VRM 暂态响应速度与元件温度的生成。选择 [Manual] 设置较高的频率可以获得较快的暂态响应速度。设置值有：[Auto] [Manual]。

> 请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

> 以下项目只有在 CPU VRM Switching Frequency 设置为 [Manual] 时才会出现。

Fixed CPU VRM Frequency (KHz) [300]

本项目可让您设置固定的 VRM 频率。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。数值以 50KHz 为间隔，更改的范围由 300KHz 至 1000KHz。

> 当已选择手动模式时，请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

> 以下项目只当 CPU VRM Switching Frequency 设为 [Auto] 时才会出现。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

本项目可让您增加系统稳定性。设置值有：[DIsabled] [Enabled]。

CPU Power Phase Control [Auto]

本项目为依照 CPU 的需求控制电源相数。设置值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]。

[Auto]	设置相数控制为采默认值。
[Standard]	根据 CPU 自身的参数设置以决定电源相数。
[Optimized]	使用华硕最佳化参数设置。
[Extreme]	全相数电源模式。
[Manual Adjustment]	提供手动方式调整较高的相式响应以增加系统性能，或是较慢的相式响应以增加内存效率。

当本项目设置为 [Extreme] 与 [Manual Adjustment] 时，请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

- 当 CPU Power Phase Control 设置为 [Extreme] 时，VRM Spread Spectrum 项目不会出现。
- 以下项目只有在 CPU Power Phase Control 设置为 [Manual Adjustment] 时才会出现。

Power Phase Response [Fast]

本项目用来设置 CPU 电力相式响应，当选择一般模式时回应的时间会较长。设置值有：[Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用来调整每个 VRM 相数的电流与散热环境。

[T.Probe]	维持各相散热平衡。
[Extreme]	维持各相电流平衡。

请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

CPU Current Capability [Auto]

本项目用来设置总电力范围，同时扩展超频频率的范围。设置值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。

当系统超频或是较高负载的 CPU 要获得额外的电力支持时，请选择较高的数值。

CPU Power Thermal Control [130]

较高的温度带给 CPU 电力更大的散热范围，并扩展超频容忍度来增加超频的潜力。使用 <+> 与 <-> 键调整数值，更改的范围从 130 至 151。

请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

CPU Input Boot Voltage [Auto]

启动时设置 VCCIN 为 CPU 启动权。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.80V 到 2.440V。

DRAM Current Capability [100%]

本项目用来调整内存超频的总电力，较高的数值提供更大的总电力范围，同时扩展超频频率的范围。设置值有：[100%] [110%] [120%] [130%]。

DRAM Switching Frequency [Auto]

本项目用来调整内存切换频率。指派固定的高内存频率来增加超频的范围，或低内存频率以获得较佳的系统稳定度。设置值有：[Auto] [Manual]。

请勿将散热系统卸除，散热环境需受到监控。

Tweakers' Paradise

子菜单里的项目用来设置处理器的倍频与功能。

BCLK Tuning

VCCIN Shadow Voltage [Auto]

提供您设置 VCCIN 虚拟电压。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 到 2.440V。

Termination Anti-Aliasing [Auto]

本项目启用后，可以让 PLL Termination Voltage 的变化更为顺畅，以协助您生成一个较好的超频结果。设设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Initial PLL Termination Voltage [Auto]

初始电压为 CPU BCLKs 终止。维持一个接近 CPU 输入电压等级将可以协助 BCLK 超频。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.00V 到 3.00V。

PLL Termination Reset Voltage [Auto]

设置 PLL Termination Reset 电压。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.00V 到 3.00V。

Eventual PLL Termination Voltage [Auto]

设置最终的 PLL 终端电压。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.00V 到 3.00V。

PCH ICC Voltage [Auto]

集成式时钟控制器的电源，较低的数值会比较好。

Clock Crossing VBoot [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.1V 到 1.9V。

Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.1V 到 1.9V。设置值有：[Auto] [0.1000] [1.9000]。

Clock Crossing Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值为以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.1V 到 1.9V。

Internal CPU Power Management

这个子菜单用来设置处理器倍频与频率。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

提供操作系统动态调整处理器电压与核心频率以降低耗电量与帮助散热。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Turbo Mode [Enabled]

本项目提供您让处理器核心在特定情况下采用比标示频率更快的速度运行。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

以下项目只有在 Turbo Mode 设置为 [Enabled] 时才会显示。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Package Power Limit [Auto]

提供您限制 Turbo Ratio 的持续时间超过 TDP（Thermal Design Power）以获得最大性能。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 到 4096W。

Package Power Time Window [Auto]

亦称为 Power Limit 1，并且提供您维持在 Turbo Ratio 上的 TDP（Thermal Design Power）时间窗口。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1 秒至 127 秒。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

亦称为 Power Limit 2，当封包电源超过 Power Limit 1 时，提供您快速的防护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 至 4096W。

> CPU Integrated VR Current Limit 项目只有在 Turbo Mode 设置为 [Enabled] 或 [Disabled] 时才会显示。

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]*

本项目用来设置较高的电流限值，以防止在超频时的频率和功率的限制。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值为以 0.125 为间隔，更改的范围从 0.125 至 1023.875。

CPU Internal Power Switching Frequency

Frequency Tuning Mode [Auto]

提供您增加或降低内部稳压器的开关频率。降低的话有助于消耗较少的功率，或增加则会有助于电压稳定。当本项目设为 [+] 或 [-] 时，会显示 Frequency Tuning Offset 项目，且提供您可设置其数值范围从 0% 至 6%。

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

当外部稳压器的散热条件超出门槛值时，允许处理器采取预防措施。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

当发生过电压时，提供您预防 Fully Integrated Voltage Regulator 的跳脱。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

> 进行超频时，建议将本项目设置为 [Disabled]。

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

当处理器处于低功率状态时，允许您提高电源省电。在 Fully Integrated Voltage Regulator 所有高性能运行下则禁用此项目。设置值有：[Auto] [High Performance] [Balanced]。

Power Decay Mode [Auto]

提供您启用这个项目以改善 Fully Integrated Voltage Regulator 如处理器进入低电流状态。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Idle Power-in Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同进入手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]。

Idle Power-out Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同退出手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]。

Power Current Slope [Auto]

提供您调整高速启动相位电流平衡在负载瞬变期间时的渐变，以消除电流的不平衡。此会导致从靠近开关频率的负载电流震荡。设置值有：[Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]。

Power Current Offset [Auto]

提供您增加或降低由处理器所检测到的输出电流。找到之间的平衡点，同时从以下选择保持最佳调节的电流门槛。设置值有：[Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

提供您增加以加强在瞬间负载的电压调节器的响应。设置值有：[Auto] [0.00] - [1.50]。

CPU Internal Power Saving Control

Power Saving Level 1 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 80A。

Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 50A。

Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 30A。

Fully Manual Mode [Enabled]

启用或关闭支持通过 ROG Connect 或 OC Panel 的电压控制。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

以下项目只有在 Fully Manual Mode 设置为 [Enabled] 时才会显示。

CPU Graphics Voltage [Auto]

本项目用来设置集成式绘图处理器（iGPU）的电压数量。当 iGPU 频率增加时请提高电压数量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.01V 为间隔，更改的范围从 0.8V 至 1.920V。

CPU System Agent Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器系统代理的电压源总量，包括 PCIE 控制器和电源控制元件。当 DRAM 频率增加时请增加电压总量。使用 <+> 或 <-> 键来调整数值，设置值以 0.003125V 为间隔，更改的范围从 0.85V 至 2.20V。

CPU Analog I/O Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 模拟部分的电压源总量。当 DRAM 频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值以 0.003125V 为间隔，更改的范围从 1.0V 至 2.20V。

CPU Digital I/O Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 连接端口数字部分的电压馈电数量。设值为依照安装的处理器所得的标准数值。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.003125V 为间隔，更改的范围从 1.0V 至 2.20V。

以下项目只有在 Fully Manual Mode 设置为 [Disabled] 时才会显示。

CPU Core Voltage [Auto]

本项用来设置处理器核心的电压源总量。当核心频率增加时请增加电压总量。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

CPU Core Voltage Override [Auto]

本项目用来设置处理器核心电压复写。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 1.920V。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

Offset Mode Sign [+]

[+]　　设置正数值偏移电压。

[-]　　设置负数值偏移电压。

CPU Core Voltage Offset [Auto]

本项目提供设置 CPU Core Voltage Offset 数值。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Adaptive Mode] 时才会出现。

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

本项目用来设置在 turbo 模式时处理器核心的电压总量，当设置高处理器核心频率时请增加电压总量，设置的电压会受到 offset 数值的影响。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 1.920V。

Total Adaptive Mode CPU Core Voltage [Auto]

本项目总和 CPU Core Voltage offset 与 Additional Turbo Mode CPU Core Voltage 选项的电压。

CPU Cache Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器非核心部份（包含缓存）的电压馈电数量。当环形控制器频率增加时请提高电压数量。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。

以下项目只有在 CPU Cache Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

CPU Cache Voltage Override [Auto]

本项目用来设置处理器缓存电压复写。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

Offset Mode Sign [+]

[+]　　设置正数值偏移电压。

[-]　　设置负数值偏移电压。

CPU Cache Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置 CPU Cache Voltage Offset。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Adaptive Mode] 时才会出现。

Additional Turbo Mode CPU Cache Voltage [Auto]

本项目用来设置在 turbo 模式时处理器缓存的电压总量，当设置高处理器缓存频率时请增加电压总量，设置的电压会受到 offset 数值的影响。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 1.920V。

Total Adaptive Mode CPU Cache Voltage [Auto]

本项目总和 CPU Cache Voltage offset 与 Additional Turbo Mode CPU Cache Voltage 选项的电压。

CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器系统代理的电压馈电数量，包括 PCIe 控制器和电源控制元件。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 连接端口模拟部份的电压馈电数量。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 连接端口数字部分的电压馈电数量。设值为依照安装的处理器所得的标准数值。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

SVID Support [Auto]

当系统超频时将本项目设置为 [Enabled]。关闭 SVID 支持以中断处理器与外接电压调节器的连线。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

> 以下项目只有在 SVID Support 设置为 [Auto] 或 [Disabled] 时才会出现。

Initial CPU Input Voltage [Auto]

此为提供在 POST（启动自我测试）时的 CPU 初始 VCCIN。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 2.440V。

Eventual CPU Input Voltage [Auto]

此为提供刚载入 CPU 前 CPU 的 VCCIN。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.80V 至 2.440V。

DRAM Voltage [Auto]

本项目用来设置内存电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 1.20V 至 2.40V。

> 根据 Intel 处理器规格，内存电压若是超过 1.65V 可能会对处理器造成永久损坏，建议您安装电压低于 1.65V 的内存以保护处理器。

PCH Core Voltage [Auto]

本项目用来设置 PCH（Platform Controller Hub）电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.0625V 为间隔，更改的范围从 0.70V 至 1.80V。

> - CPU PLL Voltage、CPU Manual Voltage、CPU Offset Voltage、iGPU Manual Voltage、iGPU Offset Voltage, DRAM Voltage、VCCSA Voltage、VCCIO Voltage 和 PCH Voltage 将以不同颜色标示，代表高电压设置下的危险程度。
> - 系统可能需要一个更佳的冷却系统（如水冷式散热系统）以在高电压设置下维持运行的稳定。

PCH VLX Voltage [Auto]

本项目用来设置 PCH 的 I/O 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.8000V 至 2.0000V。

VTTDDR Voltage [Auto]

本项目用来设置 VTTDDR 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.6000V 至 1.4000V。

DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

本项目用来设置内存控制参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00500x 为间隔，更改的范围从 0.39500x 至 0.63000x。

DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本项目用来设置在通道 A 与 B 的内存控制参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00500x 为间隔，更改的范围从 0.39500x 至 0.63000x。

CPU Spread Spectrum [Auto]

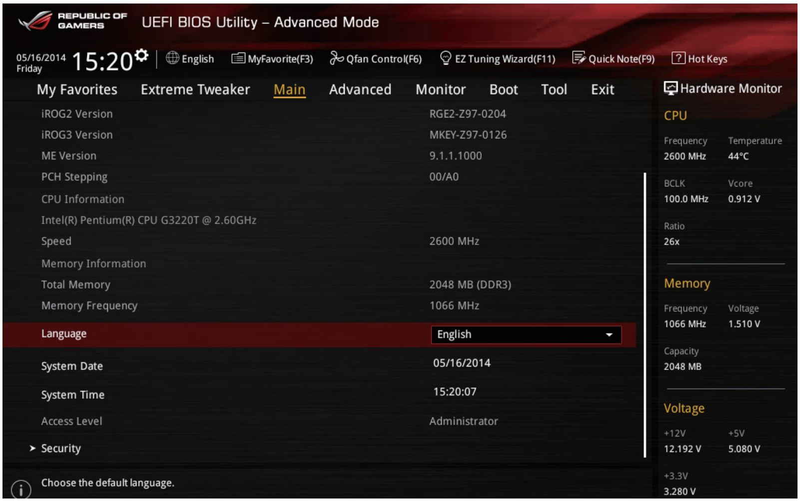
本项目用来增强 BCLK 超频能力或降低由 BCLK 生成的 EMI 电磁波干扰。设置为 [Enabled] 可以降低 EMI 干扰，设置为 [Disabled] 则可以增强 BCLK 超频能力。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

BCLK Recovery [Enabled]

本项目用来还原 BCLK（基本时钟）参数。设置值有：[Enabled] [Disabled] [Ignore]。

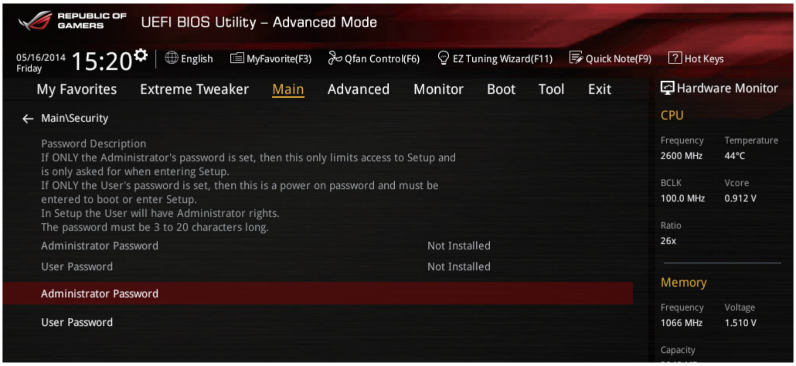
3.5 主菜单（Main Menu）

当您进入 BIOS 设置程序的高级模式（Advanced Mode）时，首先出现的第一个画面即为主菜单。主菜单显示系统信息概要，用来设置系统日期、时间、语言与安全设置。



安全性菜单（Security）

本菜单可以让您改变系统安全设置。



- 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟（RTC）内存。请参考 1.2.6 主板上的内置按钮与开关 一节的说明。
- Administrator 或 User Password 项目默认值为 Not Installed，当您设置密码之后将显示为 [Installed]。

Administrator Password（设置系统管理员密码）

当您设置系统管理员密码后，建议您先登入您的帐户，以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或更改设置。

请依照以下步骤设置系统管理员密码（Administrator Password）：

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤更改系统管理员密码（Administrator Password）：

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除系统管理员密码时，请依照更改系统管理员密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除系统管理员密码后，Administrator Password 项目将显示为 Not Installed。

User Password（设置用户密码）

当您设置用户密码后，你必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 Not Installed，当您设置密码后将显示 Installed。

请依照以下步骤设置用户密码（User Password）：

1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤更改用户密码（User Password）：

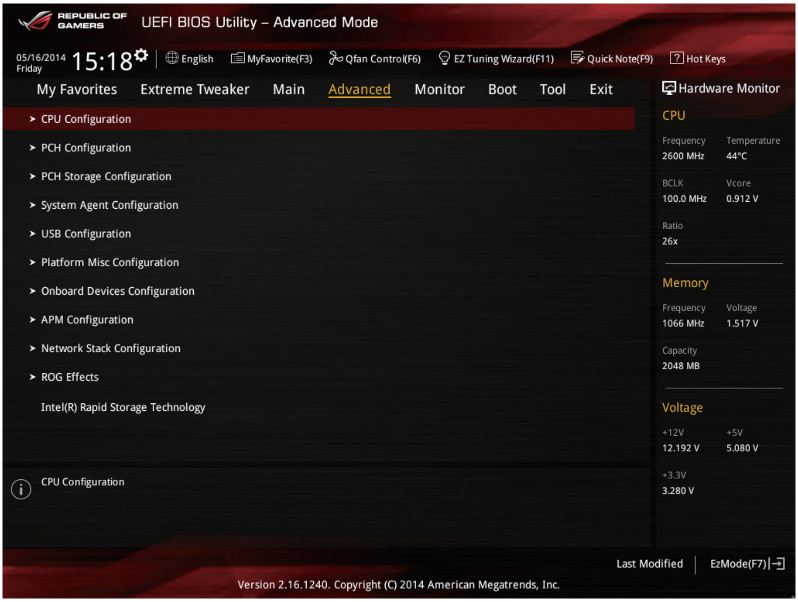
1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除用户密码时，请依照更改用户密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除用户密码后，User Password 项目将显示为 Not Installed。

3.6 高级菜单（Advanced menu）

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。

注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损毁。

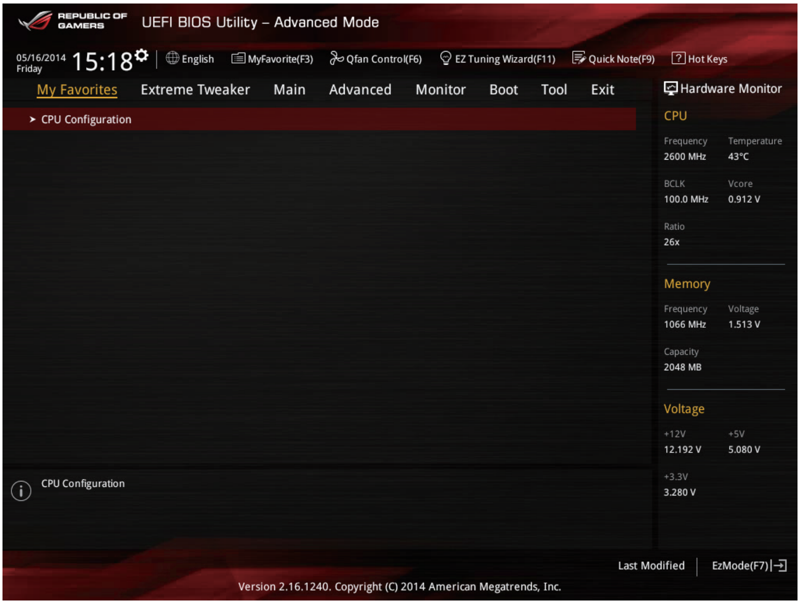


第三章

3.6.1 处理器设置（CPU Configuration）

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。

以下画面所显示项目可能会因您所安装处理器不同而有所差异。



Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] 启动 CPU 散热监控功能帮助散热。

[Disabled] 关闭 CPU 散热监控功能。

Active Processor Cores [All]

本项可以让您设置在每个处理封包中启用的处理器核心数量。设置值有：[All] [1]。

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 本项目可以让系统无处理器 CPUID 功能支持时亦可正常启动。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled]　　启动 No-Excution Page Protection 技术。

[Disabled]　　强迫 XD 功能总是降低至 0。

Intel® Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled]　　启动 Intel 虚拟技术（Virtualization Technology）让硬件平台可以同时运行多个操作系统，将一个系统平台虚拟为多个系统。

[Disabled]　　关闭此功能。

Hardware Prefetcher(L2 Cache) [Enabled]

[Enabled]　　本项目可以让硬件平台独立和同步运行多重操作系统。

[Disabled]　　关闭此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled]　　本项目可以让硬件平台运行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled]　　关闭此功能。

Boot Performance Mode [Max Non-Turbo Performance]

本项目用来让您在操作系统切换前选择 BIOS 设置的性能状态。设置值有：[Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]。

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

本项目提供通过加速固态硬盘（SSD）性能的多重动态保存电源调整功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

本项目用来管理与设置 CPU 电力。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本项为启动或关闭 Intel EIST 技术（Enhanced Intel® SpeedStep Technology）。

[Disabled]　　处理器会以默认速度运行。

[Enabled]　　处理器的速度则由操作系统控制。

Turbo Mode [Enabled]

本项目用来设置处理器在特定情况下以比标示频率更快的速度运行。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C States [Auto]

本项可让您启动或关闭 CPU C states。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

> 以下项目只有在 CPU C States 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Enhanced C1 state [Enabled]

本项目可以让处理器在闲置时降低电力消耗。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C3 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C6 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

C6 Latency [Short]

本项目可以让您设置 C6 state 的 C6 延迟期间。设置值有：[Short] [Long]。

CFG lock

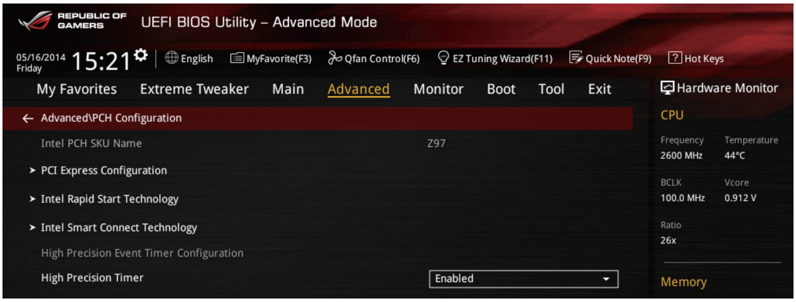
本项目用来启动或关闭 MSR 0xE2 [15] CFG lock bit 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Package C State Support [Auto]

本项目用来启动或关闭 CPU C State 支持功能。设置值有：[Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]。

第三章

3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration）



PCI Express Configuration

本项目用来管理与设置 PCI Express 插槽。

PCI-E Speed [Auto]

本项目用来让系统自动选择 PCI Express 连接端口速度。设置为 [Gen1] 时，PCI-E 连接端口会以 PCI-E 1.0 速度运行。设置为 [Gen2] 时，PCI-E 连接端口会以 PCI-E 2.0 速度运行。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel Rapid Start Technology [Disbled]

本项目用来启动或关闭 Intel® Rapid Start Technology 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

以下项目只有在 Intel Rapid Start Technology 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

系统自动唤醒并设置为 Rapid Start Technology S3 模式。设置值有：[Enabled] [Disable]

Entry After [0]

本项目用来设置系统的实时钟（RTC）唤醒功能为 S3 模式。设置值范围从 0 分钟（立即）至 120 分钟。

Active Page Threshold Support [Enabled]

当磁盘容量不敷 Intel® Rapid Start Technology 使用时，系统自动进入睡眠模式。设置值有：[Enabled] [Disabled]

请确认缓存磁区的容量大于总内存容量。

Active Memory Threshold [0]

当磁盘容量超过 Active Page Threshold 容量时，本项目支持 Intel Rapid Storage Technology。若设置为 0，会进入 Auto 模式并检查磁盘容量是否足够 S3 模式使用。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

本项目用来启动或关闭混合磁盘功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Intel Smart Connect Technology

ISCT Support [Disabled]

本项目用来让系统支持 Intel Smart Connect Technology，当系统进入睡眠模式时会定期更新选定的应用程序。设置值有：[Enabled] [Disabled]

High Precision Timer [Enabled]

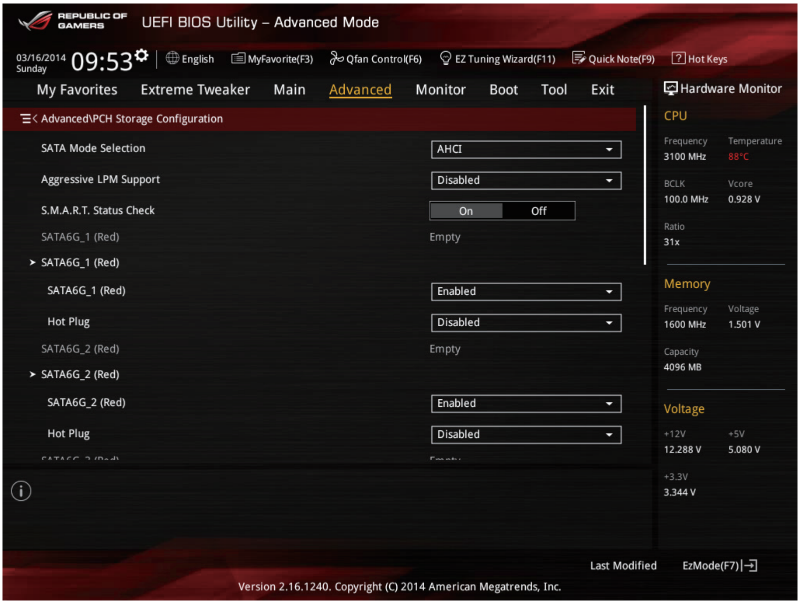
启用或关闭 High Precision Event Timer 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

第三章

3.6.3 PCH 存储设备设置（PCH Storage Configuration）

当您进入 BIOS 设置程序时，BIOS 设置程序将自动检测已安装的 SATA 设备。当未侦侧到 SATA 设备时将显示 Not Present。

将滚动条往下滚动来显示以下项目。



SATA Mode Selection [AHCI]

本项目可设置 Serial ATA 硬件设备的相关设置。

[Disabled]	关闭 SATA 功能。
[IDE]	若要将 Serial ATA 作为 Parallel ATA 物理保存接口，请将本项目设置为 [IDE]。
[AHCI]	若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存储设备启动高级的 Serial ATA 功能，通过原生命令排序技术来提升工作性能。
[RAID]	若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘阵列，请将本项目设置为 [RAID]。

以下的项目仅当 SATA Mode Selection 设置为 [RAID] 时才会显示。

Alternate ID [Disabled]

本项目为启用或关闭 alternate ID 回报功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Aggressive LPM Support [Auto]

本项为启动 PCH 强制进入链接电源状态。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

S.M.A.R.T. Status Check [On]

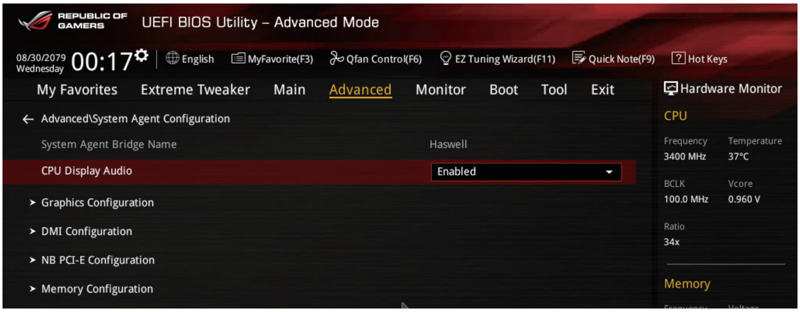
S.M.A.R.T.（自动检测、分析、报告技术，Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology）是一个监控软件，可以监控您的硬盘，并在发生错误时于启动自我检测（POST）时显示错误信息。设置值有：[On] [Off]。

Hot Plug [Disabled] (SATA6G_1 - SATA6G_4 [Red])

这些项目只有在 SATA Mode Section 设置为 [AHCI] 或 [RAID] 时才会显示，并且提供您启用或关闭支持 SATA Hot Plug（热插拔）功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

第三章

3.6.4 系统代理设置（System Agent Configuration）



CPU Display Audio [Enabled]

启用或关闭 CPU 显示音频支持功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Graphics Configuration

本项目用来选择以 iGPU 或 PCIe 显示设备作为优先使用的显示设备。

<u>*Primary Display [Auto]*</u>

[Auto] 当检测到 PCI-E 显卡，则设为主要显示。
[CPU Graphics] 强制以 CPU 内置显示为主要显示。
[PCIE] 强制以 PCI-E 显卡为主要显示。

<u>*CPU Graphics Memory [Auto]*</u>

允许您选择系统内存分配至 DVMT 5.0 的 CPU 图形显示使用量。设置值有：[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M]。

<u>*Render Standby [Auto]*</u>

本项目用来启动 Intel® Graphics Render Standby 功能来支持系统闲置时降低 iGPU 电力的消耗。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

<u>*CPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]*</u>

本项目用来启动 iGPU 多重显示功能。iGPU 共享系统内存固定为 64MB。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

DMI Configuration

本项目用来设置 DMI（Direct Media Interface）以 PCI-E 2.0 速度运行。

DMI Gen 2 [Auto]

设置为 [Enabled] 时，DMI 会以 PCI-E 2.0 速度运行。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

NB PCI-E Configuration

本项目用来设置 NB PCI Express 设置值。

PCIEx16 Link Speed [Auto]

本项目用来设置插槽 1 以 PCIEx16 速度运行。

[Auto]	系统会自动选择 PCI-E x16 端口的速度。
[Gen1]	PCI-EX16 端口会以 PCI-E 1.0 速度运行。
[Gen2]	PCI-EX16 端口会以 PCI-E 2.0 速度运行。
[Gen3]	PCI-EX16 端口会以 PCI-E 3.0 速度运行。

Memory Configuration

本项目用来设置内存设置参数。

Memory Scrambler [Enabled]

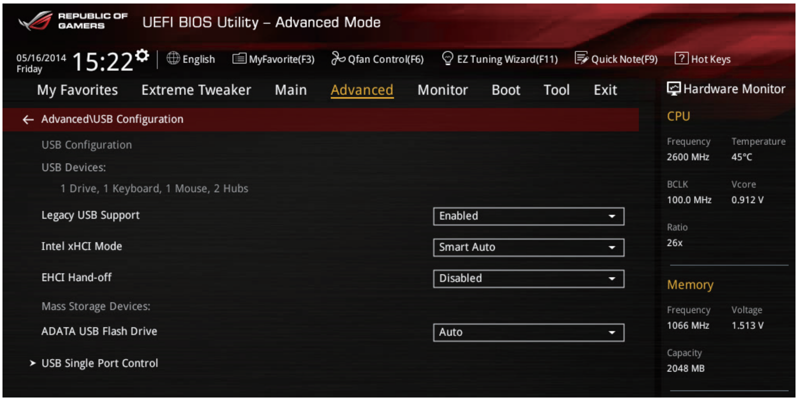
本项目用来启动或关闭 Memory Scrambler 支持。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Memory Remap [Enabled]

本项目用来启动指派内存大于 4GB。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

3.6.5 USB 设备设置（USB Configuration）

本菜单可以让您更改 USB 设备的各项相关设置。



在 USB Devices 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] 启动在常规操作系统中支持 USB 设备功能。

[Disabled] USB 设备只能在 BIOS 程序设置中使用，无法在启动设备列表中被检测到。

[Auto] 系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

[Auto] 当操作系统安装有 xHCI 驱动程序，xHCI 会自动启动并以 USB 3.0 模式运行。

[Smart Auto] xHCI 驱动程序在系统自我检测（POST）过程中与操作系统中都支持 USB 3.0 模式。

[Enabled] 启动 xHCI 控制器。

[Disabled] 关闭 xHCI 控制器。

EHCI Hand-off [Disabled]

本项目默认为 [Disabled] 以供 EHCI（Enhanced host controller interface）在操作系统底下的 EHCI 设备支持。

[Disabled] 支持在操作系统底下具备支持 EHCI 设备的 EHCI。

[Enabled] 在 BIOS 中启用支持没有 EHCI 功能的操作系统。

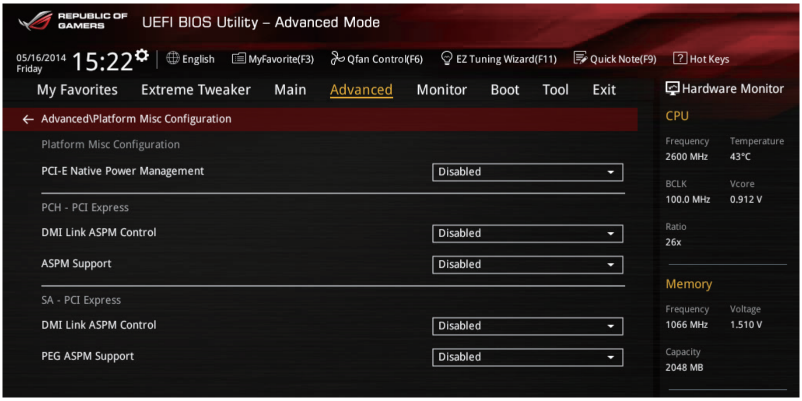
USB Single Port Control

本项目用来启动或关闭个别 USB 连接端口。

USB 连接端口的位置请参考 1.2.2 主板结构图 的说明。

3.6.6 平台各项设置（Platform Misc Configuration）

本菜单可让您更改平台相关的各项设置。



PCI Express Native Power Management [Disabled]

本项目用来设置 PCI-E 的省电功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

以下项目只有在 PCI Express Native Power Management 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Native ASPM [Disabled]

启用本项目在 Windows Vista 操作系统环境，可以控制设备的 ASPM（Active Stata Power Management）支持。

[Enabled] 由 Vista 控制设备的 ASPM 支持。

[Disabled] 由 BIOS 控制设备的 ASPM 支持。

第三章

PCH - PCI Express 选项

DMI Link ASPM Control [Disabled]

本项目为设置 DMI Link 上北桥与南桥的 ASPM（Active State Power Management）功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

ASPM Support [Disabled]

本项目用来选择 ASPM state 的节能状态。设置值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]。

SA - PCI Express 选项

DMI Link ASPM Control [Disabled]

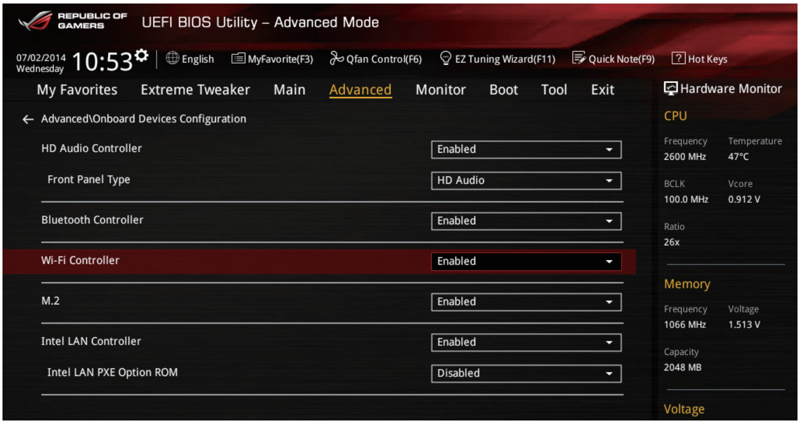
启用 PCH 端的 ASPM 以支持节能。设置值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]。

PEG ASPM Support [Disabled]

本项为选择 ASPM state 节能状态。设置值有：[Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]。

3.6.7 内置设备设置（OnBoard Devices Configuration）

往下滚动可以看到更多的 BIOS 项目。



HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled]　　启动高保真音频控制器。

[Disabled]　　关闭这个控制器。

以下选项只有在 HD Audio Controller 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Front Panel Type [HD Audio]

[HD Audio]　　将前面板音频连接端口（AAFP）模式设置为高保真音频。

[AC97]　　将前面板音频连接端口（AAFP）模式设置为 legacy AC’ 97。

Bluetooth Controller [Enabled]

[Enabled]　　启动内置的蓝牙控制器。

[Disabled]　　关闭内置的控制器。

Wi-Fi Controller [Enabled]

[Enabled]　　启动内置的 Wi-Fi 控制器。

[Disabled]　　关闭内置的控制器。

M.2 [Enabled]

本项目用来启动或关闭 M.2 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

第三章

Intel LAN Controller [Enabled]

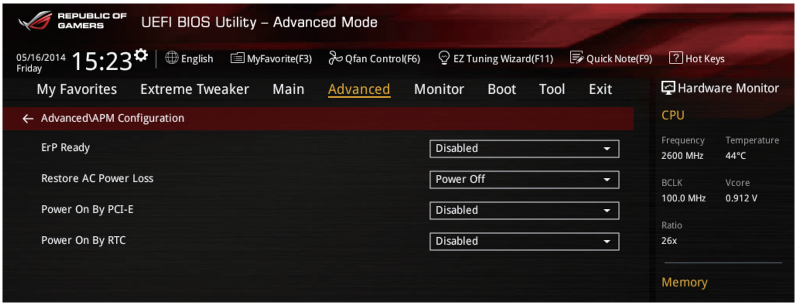
[Enabled]	启动 Intel LAN 网络控制器。
[Disabled]	关闭此控制器。

Intel LAN PXE OPROM [Disabled]

本项目仅当 Intel LAN Control 设置为 [Enabled] 时才会显示，可以让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE Option Rom（PXE 随选只读存储器）。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

第三章

3.6.8 高级电源管理设置（APM Configuration）



ErP Ready [Disabled]

在 S5 休眠模式下关闭某些电源，减少待机模式下电力的流失，以符合欧盟能源使用产品（Energy Related Product）的规范。网络唤醒功能（WOL）、USB 唤醒功能、音频，及主板上 LED 指示灯的电源将会关闭，您可能无法使用网络功能、USB 唤醒功能及音频提醒等。设置值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 系统在电源中断之后重新开启。

[Power Off] 系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。

[Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。

Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

[Disabled] 关闭通过 Intel/Realtek 网络设备或其他已安装的 PCIE 网卡进行 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。

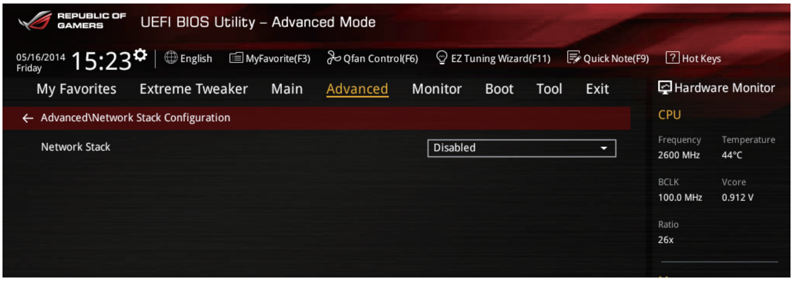
[Enabled] 启动通过 Intel/Realtek 网络设备或其他已安装的 PCIE 网卡进行 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 关闭实时时钟（RTC）唤醒功能。

[Enabled] 当您设为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目，您可自行设置时间让系统自动启动。

3.6.9 网络协定堆栈（Network Stack）



Network Stack [Disable Link]

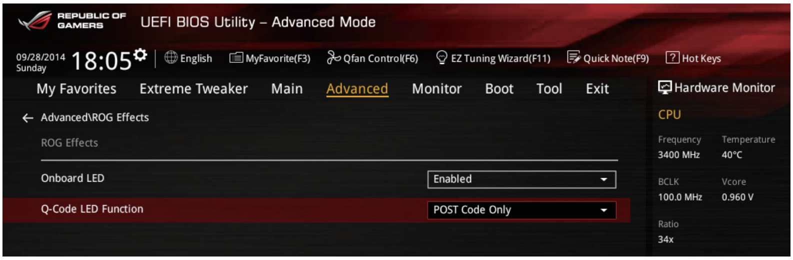
本项目用来启动或关闭 UEFI 网络协定堆栈（network stack）功能。设置值有：[Disable Link] [Enable]。

> 以下的项目只有在 Network Stack 设置为 [Enabled] 时才会显示。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enable]

本项目为启用或关闭 Ipv4/Ipv6 PXE 支持功能。设置值有：[Disable Link] [Enabled]。

3.6.10 ROG Effects



Onboard LED [Enabled]

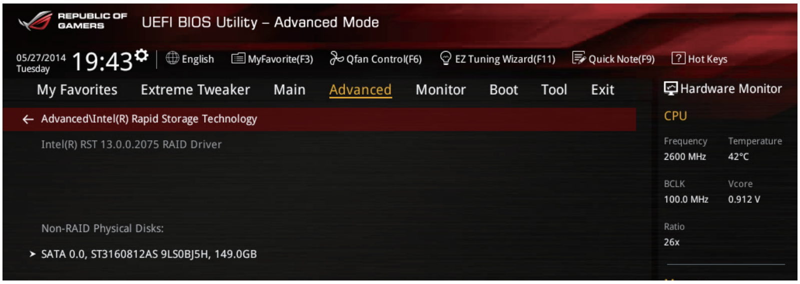
本项目提供您启用或关闭主板内置的指示灯。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

Q-Code LED Function [POST Code Only]

本项目设置 Q-Code 进入系统后显示 CPU 温度或是 Sonic SoundStage 设置文件。

[POST Code Only]	进入系统后显示 Sonic SoundStage 设置文件。
[Auto]	进入系统后显示 CPU 温度。

3.6.11 Intel(R) Rapid Storage Technology



Create RAID Volume

本项目用来创建 RAID 磁区。

只有在至少一个硬盘连接至 Intel® SATA 连接端口并且设置为 RAID 模式时本项目才会出现。

Name [Volume1]

本项目用来输入 RAID 设置中磁区名称。

RAID 磁区名称只能使用英文字母和数字，最多或少于 16 个字节。

RAID Level [RAID0(Stripe)]

本项目用来选择 RAID 层级。设置值有：[RAID0(Stripe] [RAID1(Mirror)] [RAID5(Parity)] [Recovery]。

Select Disks

本项目用来显示已经连接并且适合作为 RAID 设置的 SATA 设备。在下拉式列表中，选择 X 来设置 RAID。

Strip Size: [32KB]

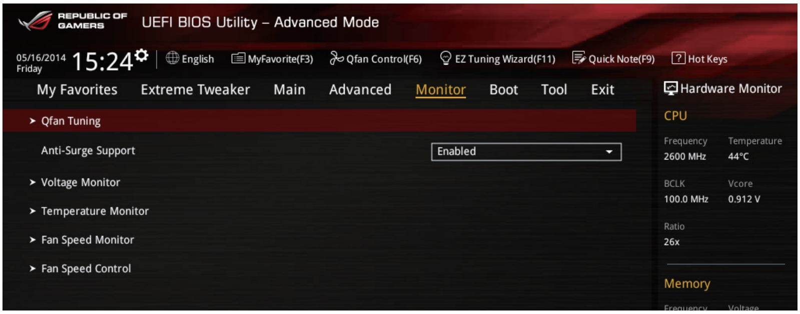
本项目用来选择 RAID 设置的分区容量。设置值有：[4KB] [8KB] [16KB] [32KB] [64KB] [128KB]。

Capacity (MB): [0]

本项目用来设置 RAID 容量。

3.7 监控菜单（Monitor menu）

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况，并且对风扇做高级设置。



Qfan Tuning

点击本项目会自动检测最低速度并设置每个风扇的最小工作周期。

Anti Surge Support [Enabled]

本项为启用过电压保护（OVP）与低电压保护（UVP）功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Voltage Monitor

CPU Core 0-1 Voltage; CPU Cache Voltage; CPU System Agent Voltage; CPU Analog I/O Voltage; CPU Digital I/O Voltage; CPU Input Voltage; DRAM Voltage; PCH Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage

这些内置的硬件监控功能，会自动检测通过内置电压调节所输出的电压值。如果风扇并未连接至主板，本项目会显示 N/A。若是您不想显示检测这个项目，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature; VRM Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主板具备了中央处理器、主板的温度探测器，可自动检测并显示当前的温度。若您不想要显示检测的温度，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignored]。

Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; Chassis FAN 1/2/3 Speed [XXXX RPM]

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有中央处理器风扇的转速 RPM（Rotations Per Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警讯，通知用户注意。若没有安装至主板，则会显示 [N/A]。若您不想显示该项检测的温度值，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

CPU Q-Fan Control [Auto]

本项目用来设置 CPU Q-Fan 运行模式。

[Auto]	检测安装的处理器风扇类型并自动切换控制模式。
[PWM Mode]	在 PWM 模式启动 CPU Q-Fan 控制来使用 4-pin 处理器风扇。
[DC Mode]	当安装 3-pin 的处理器风扇时，请选择本项目来使用 Q-Fan 控制的 DC 模式。
[Disabled]	关闭 CPU Q-Fan 控制功能。

以下的项目只有在 CPU Q-Fan Control 设为 [Auto]、[PWM Mode] 与 [DC Mode] 时才会出现。

CPU Fan Speed Low Limit [300 RPM]

本项目可以让您设置 CPU Q-Fan Control 的功能及处理器风扇速度。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

CPU Fan Profile [Standard]

本项目用来设置处理器风扇适当的性能。

[Standard]	设置为 [Standard] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。
[Silent]	设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。
[Turbo]	设置为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。
[Manual]	设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。

以下的项目只有在 CPU Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器温度的最大值。数值的更改范围由 20℃ 至 75℃。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最大工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

CPU Middle Temperature [25]

使用 <+> 与 <-> 键设置处理器的中间温度，数值范围依安装的处理器而异。

CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的中间工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

CPU Lower Temperature [20]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器温度的最小值。数值的更改范围由 20℃ 至 75℃。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最小工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

Chassis Fan 1-3 Q-Fan Control [Enabled]

这些项目用来设置主板机箱风扇的 Q-Fan control 为 DC 模式、PWM 模式或关闭 Q-Fan controls 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Chassis Fan 1-3 Speed Low Limit [300 RPM]

本项目用来关闭或设置机箱风扇警告转度。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Chassis Fan 1-3 Profile [Standard]

本项目用来设置机箱风扇适当的性能。

[Standard]	让机箱风扇根据处理器的温度自动调整。
[Silent]	将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。
[Turbo]	获得机箱风扇的最大转速。
[Manual]	指派详细的风扇转速控制参数。

> 以下项目只有在 Chassis Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

Chassis Fan 1-3 Upper Temperature [70]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的最大值。数值的更改范围由 40℃ 至 90℃。

Chassis Fan 1-3 Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最大工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

Chassis Fan 1-3 Middle Temperature [45]

使用 <+> 与 <-> 键设置机箱风扇的中间温度。

Chassis Fan 1-3 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的中间工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

Chassis Fan 1-3 Lower Temperature [40]

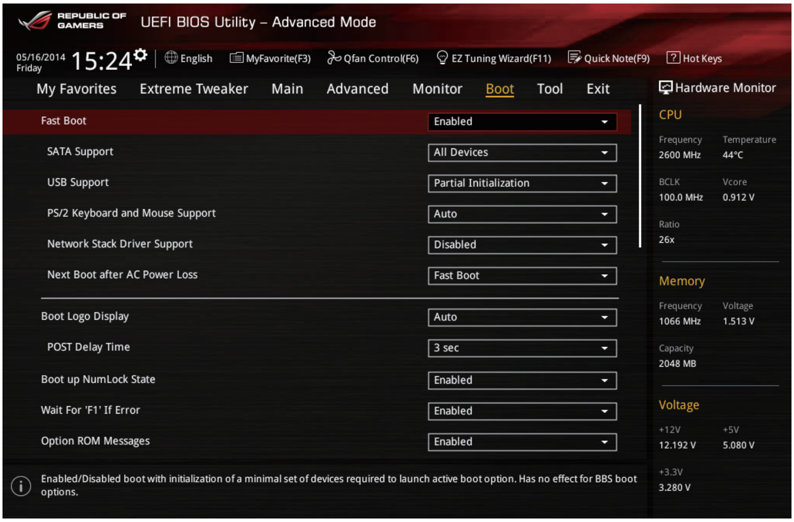
使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇温度的最小值。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

Chassis Fan 1-3 Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小工作周期。数值可能会随着 Qfan 调整而异。

3.8 启动菜单（Boot menu）

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



启动设置（Boot Configuration）

Fast Boot [Enabled]

[Disabled]　　系统返回正常启动速度。

[Enabled]　　加速系统启动速度。

以下的项目只有在 Fast Boot 设置为 [Enabled] 时才会出现。

SATA Support [All Devices]

[All Device]　　所有连接至 SATA 连接端口的设备在启动自我检测（POST）过程中可以使用。

[Hard Drive Only]　　只有连接至 SATA 连接端口的硬盘设备在启动自我检测（POST）过程中可以使用。

[Boot Drive Only]　　只有连接至 SATA 连接端口的启动设备在启动自我检测（POST）过程中可以使用。

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled]　　所有 USB 设备直到操作系统开启后才可使用。

[Full Initialization]　　所有 USB 设备在操作系统环境及 POST 时均可使用。

[Partial Initialization] 在操作系统开启前仅可使用 USB 键盘与鼠标。

PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

提供您关闭或在 POST（启动自我测试）过程中可以完整控制 PS/2 设备。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled] 在 POST 时略过载入网络协定堆栈驱动器。
[Enabled] 在 POST 时载入网络协定堆栈驱动器。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 在电源中断后恢复至正常启动速度。
[Fast Boot] 在电源中断后加快启动速度。

Boot Logo Display [Auto]

[Auto] 设置在启动自我检测（POST）过程中的启动画面。

[Full Screen] 设置在启动自我检测（POST）过程中的启动画面为全屏。

[Disabled] 关闭全屏个人化启动画面功能。

以下项目只有在 Boot Logo Display 设为 [Auto] 与 [Full Screen] 时才会出现。

Post Delay Time [3 sec]

本项目可以让您选择 POST 的等候时间，以更快进入 BIOS。您可以在正常启动下仅运行 POST 延后。数值的更改范围由 0 秒至 10 秒。

本功能仅支持正常启动时使用。

以下项目只有在 Boot Logo Display 设为 [Disabled] 时才会出现。

Post Report [5 sec]

本项目可以让您选择 POST 的等候时间。设置值有：[1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]。

Bootup NumLock State [Enabled]

本项目用来启动或关闭启动时 NumLock 键自动开启的功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Wait For ‘F1’ If Error [Enabled]

当本项目设置为 [Enabled]，系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下 <F1> 键确认才会继续进行启动程序。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Option ROM Messages [Enabled]

[Enabled]　选购设备固件信息会在启动自我检测时显示。

[Disabled]　在启动自我检测时关闭选购设备固件信息并只显示华硕启动图标。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

本项目用来使用随选内存（ROM）限制中断 19。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Above 4G Decoding [Disabled]

本项目用来让您在 4G 地址空间上解码 64 位设备。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Setup Mode [Advanced Mode]

[Advanced Mode]　将 Advanced Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

[EZ Mode]　将 EZ Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

CSM （兼容性支持模块）

本项目用来设置 CSM（兼容性支持模块）项目来完全支持各种 VGA、启动设备和附加设备，借以获得更佳的兼容性。

Launch CSM [Auto]

[Auto]　系统将自动检测启动设备和附加设备。

[Enabled]　为获得更好的兼容性，开启 CSM 以完全支持非 UEFI 驱动的附加设备或 Windows UEFI 模式。

[Disabled]　关闭此功能。

以下的项目只有在 Launch CSM 设为 [Enabled] 时才会出现。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本项目用来选择想要启动的设备类型。设置值有：[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]。

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择想要运行的网络设备。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择想要运行的存储设备类型。设置值有：[Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择想要运行的 PCIe/PCI 扩展设备类型。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first]。

Secure Boot

本项目用来设置 Windows® 安全启动的相关参数以及管理系统金钥，以提升系统在启动自我检测（POST）时的安全性，避免受到未授权的用户与恶意软件的危害。

OS Type [Windows UEFI mode]

[Windows UEFI Mode]	本项目用来选择安装的操作系统。运行 Microsoft® 安全启动检查。只有在 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® 安全启动兼容操作系统中启动时选择此项目。
[Other OS]	在 Windows® 非 UEFI 模式中启动时获得最佳功能。Microsoft® 安全启动功能仅可在 Windows® UEFI 模式下正确运行。

以下项目只有在 OS Type 设置为 [Windows UEFI mode] 时才会出现。

Key Management

本项目可以让您管理安全启动的金钥。

Install Default Secure Boot keys

本项目用来立即载入默认的安全启动金钥、平台金钥（PK）、金钥交换金钥金钥注册金钥（KEK）、认证签名数据库（db）和撤销签名数据库（dbx）。当载入默认的安全启动金钥后，PK 状态会变为载入模式。

Clear Secure Boot keys

本项目只有在载入默认的安全启动金钥时才会出现。用来让您清除所有默认的安全启动金钥。

Save Secure Boot Keys

本项目用来将平台金钥（PK）保存至 USB 存储设备。

PK Management

平台金钥（PK）锁定并保护固件遭到未授权的更改。在进入操作系统前需先验证平台金钥（PK）。

Delete PK

本项目用来删除系统中的平台金钥（PK），当平台金钥删除后即无法使用安全启动金钥。设置值有：[Yes] [No]。

Load PK from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载的平台金钥（PK）。

> PK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

KEK Management

KEK（金钥交换金钥 [Key-exchange Key] 或金钥注册金钥 [Key-Enrollment Key]）用来管理签名数据库（db）与撤销签名数据库（dbx）。

> Key-exchange Key（KEK）指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key（KEK）。

Delete the KEK

本项目用来删除系统中的 KEK。设置值有：[Yes] [No]。

Load KEK from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载 KEK。

Append Var to KEK

本项目用来由存储设备载入附加的 KEK，以管理附加的签名数据库（db）与撤销签名数据库（dbx）。

> KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

DB Management

db（认证签名数据库）列出可以在单一电脑载入之 UEFI 应用程序、操作系统载入器与 UEFI 驱动程序的签名者或图片图像。

Delete the db

本项目用来删除系统中的 db 文件。设置值有：[Yes] [No]。

Load db from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载的认证签名数据库（db）。

Append db from file

本项目用来由存储设备载入附加的认证签名数据库（db），以安全的载入更多的图片图像。

> db 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

第三章

DBX Management

dbx（撤销签名数据库）列出 db 项目中不再被信任且无法被载入之被禁止的图片图像。

Delete the dbx

本项目用来删除系统中的 dbx 文件。

Load dbx from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载的撤销签名数据库（dbx）。设置值有：[Yes] [No]。

Append dbx from File

本项目用来由存储设备载入附加的撤销签名数据库（dbx），以使更多的 db 图片图像无法被载入。

dbx 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

Boot Option Priorities

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序，而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。

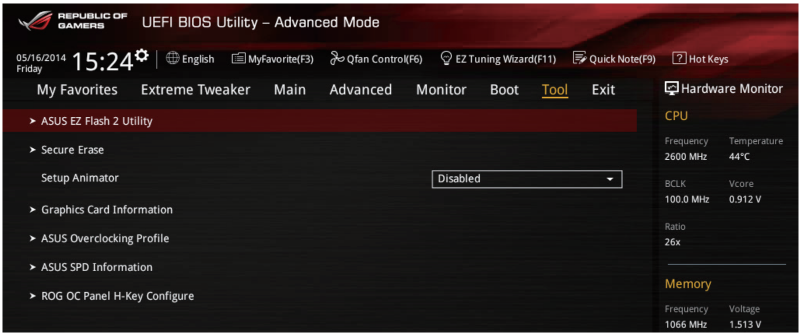
- 欲进入 Windows 安全模式时，请在启动自我检测（POST）时按下 <F8>（Windows 8 不支持这项功能）。
- 启动时您可以在 ASUS Logo 出现时按下 <F8> 选择启动设备。

Boot Override

本项目将显示可使用的设备，设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。点击任一设备可将该将置设置为启动设备。

3.9 工具菜单（Tool menu）

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



3.9.1 ASUS EZ Flash 2

本项目可以让您启动华硕 EZ Flash 2 程序，按下 <Enter> 会出现再次确认的窗口，请使用左右键选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <Enter> 确认。

请参考 3.11.2 华硕 EZ Flash 2 一节的说明。

3.9.2 Secure Erase

随着使用的时间，过多的文件数据可能会导致 SSD 速度变慢，Secure Erase 可完全并安全清除您的 SSD 以恢复到出厂时的性能水准。

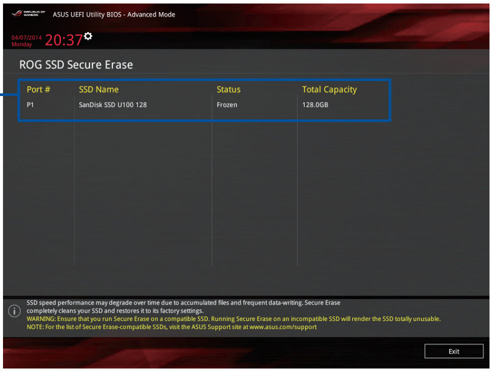
Secure Erase 功能仅在 AHCI 模式下使用，请先确认将 SATA 模式设置为 AHCI。点击 Advanced > SATA Configuration > AHCI 进行设置。

要启用 ROG SSD Secure Erase，请点击 Advanced 菜单下的 Tool > ROG SSD Secure Erase 以进行开启。

请上网至华硕支持网站以查看完整的 SSD 支持 Secure Erase 的测试列表。若您使用不兼容的 SSD 运行 Secure Erase 则可能会造成系统不稳定。

- 运行 Secure Erase 时视 SSD 的容量大小而需等候一段时间来进行清除，在进行的过程中请勿关闭系统。
- Secure Erase 功能仅支持 Intel SATA 连接端口，如欲了解更多关于 Intel SATA 连接端口的信息，请参考本手册 1.2.2 主板结构图 一节的说明。

显示可使用的 SSD



状态定义：

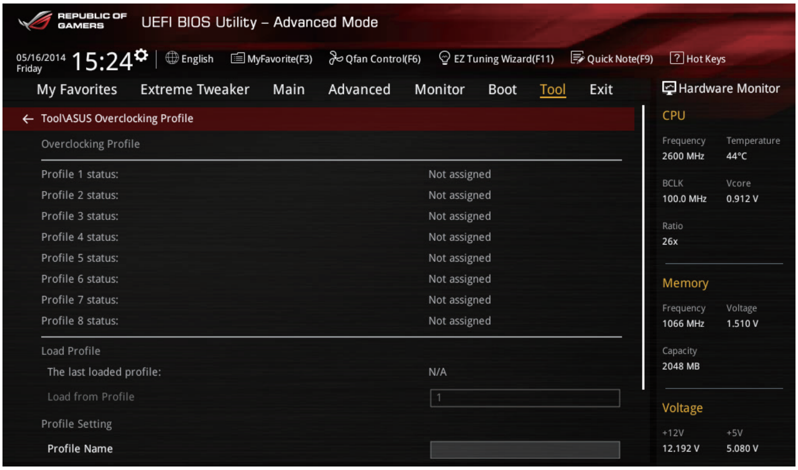
- Frozen（冻结）：这个状态为 BIOS 的保护措施， BIOS 守卫在启动前冻结没有密码保护的驱动程序。如果驱动程序被冻结，则必须关机或必须将电脑用 Secure Erase. 运行硬件重置。
- Locked（锁定）：若 Secure Erase 运行不完整或已经停止，SSD 可能被锁住。这可能需要使用由华硕定义的第三方不同密码。您必须在使用 Secure Erase 前，先使用软件将 SSD 解锁。

3.9.3 显卡信息（Graphics Card Information）

本菜单会显示已安装在系统内的显卡信息。

3.9.4 ASUS Overclocking Profile

本菜单可以让您保存或载入 BIOS 设置。



若是没有创建设置文件，则 O.C. Profile Configuration 项目会显示 [Not Installed]。

Profile Name

本项目用来输入设置文件名称。

Save to Profile

本项目可以让您保存当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中，并创建一个设置文件。从 1 至 8 选择一个设置文件编号并输入该编号，然后按下 <Enter> 键，接着选择 Yes。

Load from Profile

本项目可以让您载入先前保存在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。输入一个保存在 BIOS 设置中的设置文件编号，然后按下 <Enter> 键并 选择 Yes 来载入文件。

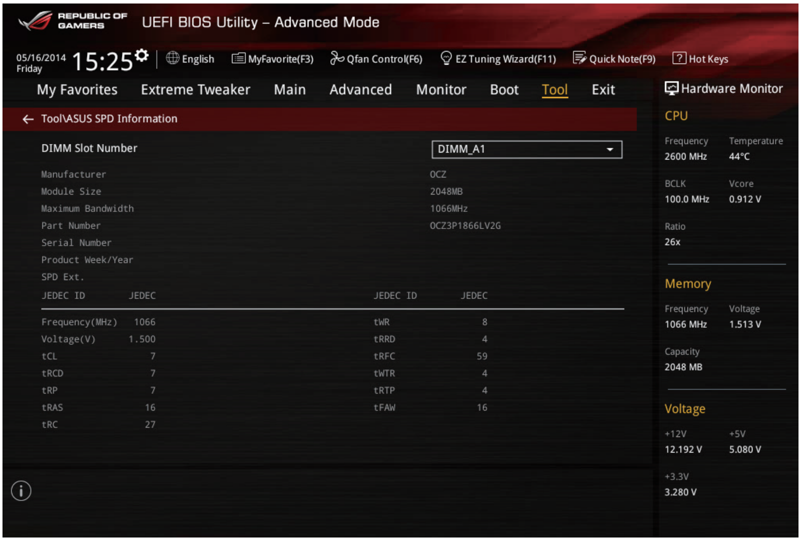
- 当进行 BIOS 升级时，请勿关闭或重新启动系统以免造成系统启动失败。
- 建议您只在相同的内存/处理器设置与相同的 BIOS 版本状态下，更新 BIOS 程序。

Load/Save Profile From/To USB drive

本项目可以由 USB 存储设备载入或保存设置文件，或是载入或保存设置文件至 USB 存储设备。

3.9.5 ASUS SPD Information

本菜单显存插槽的相关信息。



3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure

ROG OC Panel H-Key 提供您在 UEFI BIOS 之下输入并保存 CPU Core voltage、CPU input voltage、BCLK Frequency 与 CPU ratio 数值。这些已保存的数值可同步至 OC Panel 设备，提供用户在 OS 下进行调校，而无须进入 BIOS 菜单进行。另外，这些数值也可以通过 OC Panel 做更改。

CPU Core Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器核心的电压馈电数量。当核心频率增加时请提高电压数量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.003125V 为间隔，更改的范围从 1.050000V 至 2.200000V。

CPU Input Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器的输入电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 3.040V。

BCLK Frequency [Auto]

本项目提供您调整 BCLK 频率。更改的数值范围从 60 MHz 至 300 MHz。

CPU Ratio [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心时钟与前端总线频率的比值。设置值会随着所安装的处理器而有不同。

Load Default

本项目用来载入 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 默认值。重置 Load Default 所有数值请选 [Auto]。

Save Above Settings

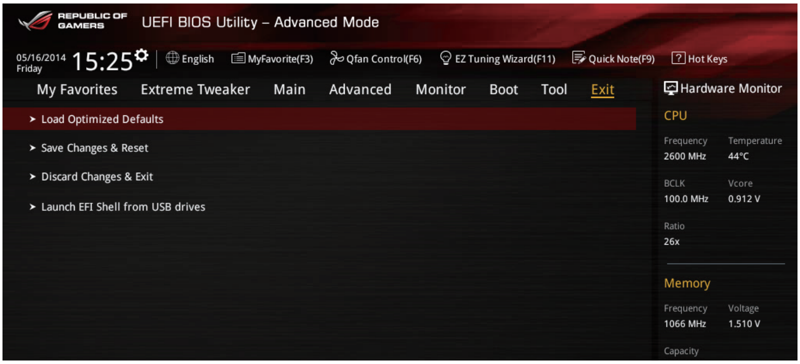
本项目提供您保存新设置好的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

Load from profile

本项提供您载入前一次的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

3.10 退出 BIOS 程序（Exit menu）

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本项目可让您载入 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下 <F5>，便会出现一个确认对话窗口，选择 Yes 以载入默认值。

Save Changes & Reset

当您完成对 BIOS 设置程序所做的更改后，请选择本项目或按下 <F10>，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以保存设置并退出 BIOS 设置程序。

Discard Changes & Exit

本项目可让您放弃所做的更改，并恢复原先保存的设置。在选择本项目或按下 <Esc>键后，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以放弃任何设置并载入原先保存的设置，同时退出 BIOS 设置程序。

ASUS EZ Mode

选择本项目可进入 EZ Mode 菜单。

Launch UEFI Shell from filesystem device

本项目可以让您由含有数据系统的设备中启动 UEFI Shell（shellx64.efi）。

3.11 更新 BIOS 程序

华硕网站上提供有最新的 BIOS 程序，可以强化系统的稳定度、兼容性或运行性能，但是运行 BIOS 程序更新是具有潜在性风险的，若是使用现有版本的 BIOS 程序都没有发生问题时，请勿手动运行更新 BIOS 程序。不适当的 BIOS 程序更新可能会导致系统启动失败。若有需要，请使用以下各节的方法来更新您的 BIOS 程序。

> 请访问华硕网站（http://www.asus.com.cn）下载本主板最新的 BIOS 程序。

1. EZ Update：在 Windows 操作系统中更新 BIOS 程序。
2. ASUS EZ Flash 2：使用 U 盘来更新 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 3：当 BIOS 文件遗失或损毁时，可以使用 U 盘或主板的驱动程序与应用程序光盘来更新 BIOS。
4. ASUS BIOS Updater：在 DOS 环境下，使用主板驱动程序与应用程序光盘与 U 盘来更新并备份 BIOS。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。

3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来更新主板 BIOS 文件的应用程序。

> - 在使用 EZ Update 之前，请先确认您已经通过内部网络对外连接，或者通过互联网服务供应商（ISP）所提供的连线方式连接到互联网。
> - 这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。
> - 请参考 4.4.6 EZ Update 一节的说明进行 BIOS 文件更新。

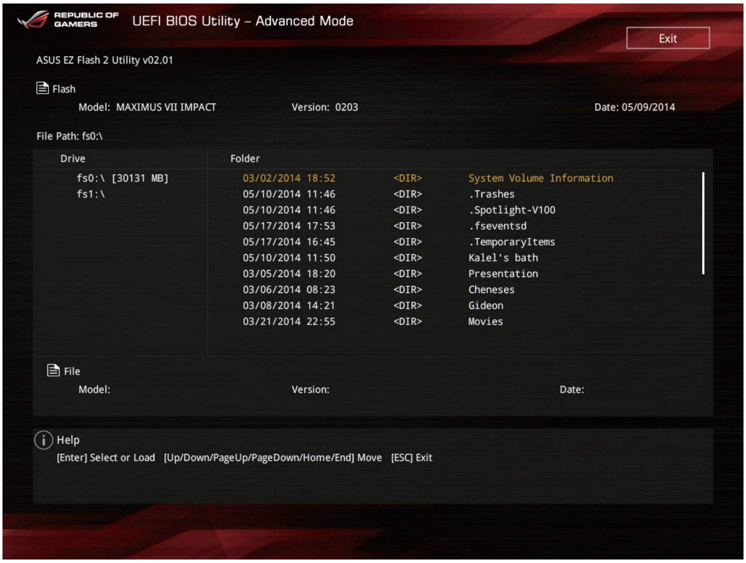
3.11.2 华硕 EZ Flash 2

华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松的更新 BIOS 程序，可以不必再通过启动盘的冗长程序或是到 DOS 模式下运行。

请至华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的 BIOS 程序文件。

请依照以下步骤通过 EZ Flash 2 更新 BIOS 程序：

1. 将保存有最新的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 连接端口。
2. 进入 BIOS 设置程序的 Advanced Mode，选择 Tool > ASUS EZ Flash Utility，接着请按下 <Enter> 键。



3. 请使用 <Tab> 键操控至 Drive 字段。
4. 请利用上/下方向键找到存放有最新 BIOS 文件的 U 盘，接着请按下 <Enter> 键。
5. 请使用 <Tab> 键操控 Folder Info 区域。
6. 请利用上/下方向键找到 U 盘中最新的 BIOS 文件，接着请按下 <Enter> 键开始 BIOS 更新操作。当 BIOS 更新操作完成后请重新启动电脑。

- 本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式的单一磁区 U 盘。
- 当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.10 退出 BIOS 程序 一节中 Load Optimized Defaults 项目的详细说明。

3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或丢失时，可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘中恢复 BIOS 程序的数据。

在驱动程序及应用程序光盘中的 BIOS 程序版本可能会比官方网站上的 BIOS 程序版本旧，若是想要使用更新的 BIOS 程序，请至 http://www.asus.com.cn/support 网站下载，并保存在便携存储设备中。

恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序：

1. 启动系统。
2. 将主板的应用程序光盘放入光驱，或是将含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 连接端口。
3. 接着，工具程序便会自动检查光盘或存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后，工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 ASUS EZ Flash 2 程序。
4. 系统需要您进入 BIOS 程序来恢复 BIOS 设置，为了确保系统的兼容性与稳定性，建议您按下 <F5> 按键来载入 BIOS 程序的默认值。

当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

3.11.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 让您可以在 DOS 环境下更新 BIOS 程序，还可以用来复制现有的 BIOS 文件，当您的 BIOS 程序在更新过程中失败或中断时，可以作为备份使用。

> 以下的程序画面仅供参考，您实际操作的画面可能会与手册所示的画面不尽相同。

更新 BIOS 之前

1. 准备本主板的驱动程序与应用程序光盘，以及 FAT32/16 格式且单一磁区的 U 盘。
2. 访问华硕网站 http://support.asus.com 下载最新的 BIOS 程序与 BIOS Updater，然后保存在 U 盘。

> • DOS 环境下不支持 NTFS 格式，请勿将 BIOS 文件与 BIOS Updater 保存在 NTFS 格式的 U 盘。
>
> • 请勿将 BIOS 程序保存在软盘，以免软盘的容量不够使用。

3. 将电脑关机。
4. 请确认电脑配备有光驱。

DOS 环境下启动系统

1. 将存有最新 BIOS 文件与 BIOS Updater 的 USB 存储设备插入 USB 连接端口。
2. 启动电脑，按下 <F8> 来显示 BIOS 启动设备选择菜单。
3. 当启动设备选择菜单出现时，将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后选择光驱作为启动磁盘。

```
Please select boot device:

E1:  ASUS DVD-E818A6T  (4069MB)
 USB DISK 2.0 (3824MB)
UEFI: (FAT)  USB DISK 2.0 (3824MB)
Enter Setup

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults
```

4. 当启动信息出现时，在五秒钟内按下 <Enter> 键来进入 FreeDOS 弹出窗口。

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority
device automatically. boot:
```

5. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 d:，然后按下 <Enter>，将磁盘 C（光驱）改为磁盘 D（USB 存储设备）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:/> d:
D:/>
```

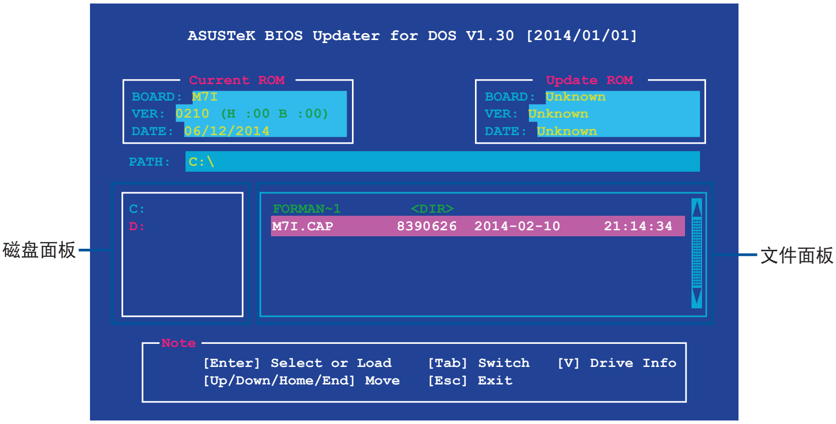
更新 BIOS 文件

请依照以下步骤更新 BIOS 文件：

1. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 bupdater /pc /g，然后按下 <Enter>。

```
D:/> bupdater /pc /g
```

2. 在 BIOS Updater 画面按下 <Tab> 按键从文件面板切换至磁盘面板，然后选择 D:。



3. 按下 <Tab> 按键从磁盘面板切换至文件面板，使用 <Up/Down/Home/End> 按键选择 BIOS 文件然后按下 <Enter>。

4. BIOS Updater 检查所选的 BIOS 文件后，选择 Yes 来确认 BIOS 更新。

由于安全规则，不支持 BIOS 备份功能。

5. 选择 Yes 后按下 <Enter>，当 BIOS 更新完成时，按下 <ESC> 退出 BIOS Updater。

6. 重新启动电脑。

请勿在 BIOS 进行更新时，运行关机或重新启动电脑，以防止 BIOS 更新失败。

请载入 BIOS 程序的默认值以确保系统的兼容性与稳定度。在 3.10 退出 BIOS 程序（Exit menu）菜单 选择 Load Optimized Defaults。

第四章

4.1 安装操作系统

- 本主板支持 Microsoft® Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 32/64-bit 操作系统（OS，Operating System）。
- 由于主板和周边硬件设备的选项设置繁多，本章仅就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息

随货附赠的驱动及应用程序 DVD 光盘包括了数个有用的软件和应用程序，将它们安装到系统中可以强化主板的性能。

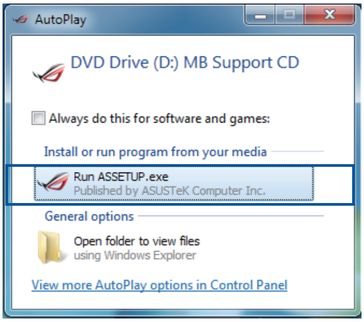
华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘的内容会不定时地更新，但不另行通知。如欲得知最新的信息，请访问华硕的网站 http://www.asus.com.cn。

4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘

当在 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 8.1 操作系统中运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘之前，请先确认您拥有管理员帐号。

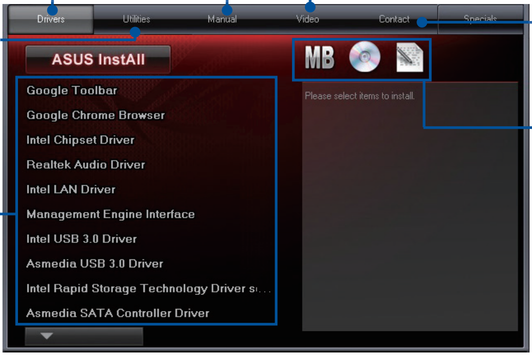
请依照以下步骤来运行驱动及应用程序 DVD 光盘：

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱。
2. 在自动播放（AutoPlay）对话框中点击运行 ASSETUP.exe（Run ASSETUP.exe）。



如果自动播放（AutoPlay）窗口没有出现，那么您也可以到驱动程序及应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

驱动及应用程序 DVD 光盘主菜单

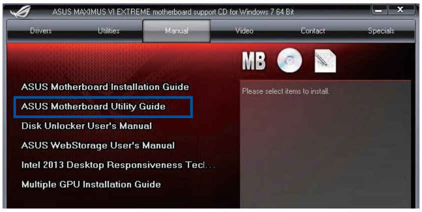


4.2.2 取得软件用户手册

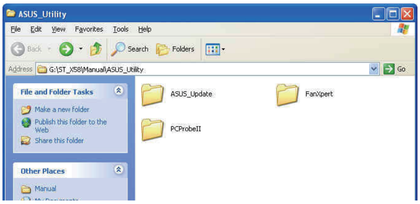
您可在驱动程序 DVD 光盘中找到软件用户手册，请依照以下步骤来取得您需要的软件用户手册。

> 软件用户手册文件为 PDF 格式，在您开启用户手册文件前，请先安装 Adobe® Acrobat® Reader 浏览软件。

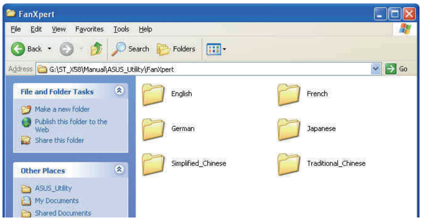
1. 点击 Manual（用户手册）项目，由列表中选择 ASUS Motherboard Utility Guide。



2. 进入 Manual（用户手册）文件夹后，在您需要的用户手册文件夹用鼠标左键点二下。



3. 请由数个语言的用户手册中选择您需要的用户手册。



本章节的图标仅供参考，在驱动程序 DVD 光盘中所包含的软件用户手册，会依照您所购买的型号而有不同。

4.3 软件信息

驱动程序及应用程序光盘中大部分的应用程序都会有安装指导向导来协助您一步一步轻松地安装软件。您也可以由个别软件所提供的在线说明文件或读我文件取得安装方式及其他信息的说明。

4.4 华硕 AI Suite 3 程序

通过友善的用户界面，华硕 AI Suite 3 程序将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以同时操控并运行各项功能及应用程序。

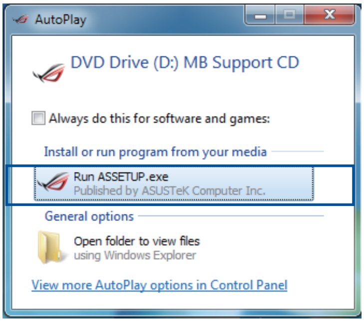
安装华硕 AI Suite 3 程序

- 当您安装 AI Suite 3 至 Windows® 7 或 Windows® 8 操作系统前，请先确认您拥有管理员帐号。
- 如要安装华硕 AI Suite 3 的 Wi-Fi-enabled 功能，请确认您已从应用程序光盘里安装 Wi-Fi 模块驱动程序。如要进行安装驱动程序，请点击 Driver > ASUS Bluetooth 4.0 Wi-Fi Driver，然后依照画面上的提示操作。

请依照下列步骤将华硕 AI Suite 3 程序安装到您的电脑：

Windows® 7 操作系统

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱。
2. 在自动播放（AutoPlay）对话框中点击运行 ASSETUP.exe。



3. 点击应用程序（Utilited）标签页，接着点击 AI Suite 3，然后请依照屏幕指示来完成安装步骤。

Windows 8 与 Windows 8.1 操作系统

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱，然后依照屏幕的指示来完成安装步骤。
2. 从驱动程序及应用程序 DVD 光盘主菜单中选择应用程序（Utilites）标签页，然后点击 AI Suite 3。
3. 请依照屏幕的指示运行。

   若是驱动程序及应用程序 DVD 光盘主菜单没有出现，请参考以下步骤：

   a. 到 开始 画面，然后点击或轻触桌面的应用程序。
   b. 在桌面的左下角点击或轻触 File Explorer ，然后选择 DVD 磁盘并轻触或双击 设置。

运行华硕 AI Suite 3 程序

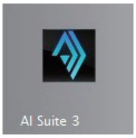
Windows 7 操作系统

从桌面点击 开始 > 所有应用程序 > ASUS > AI Suite 3> AI Suite 3。

您也可以在 Windows 7 的通知任务栏中点击 图标。

Windows 8 与 Windows 8.1 操作系统

在开始画面轻触 AI Suite 3 应用程序，若您使用鼠标，则请在开始画面点击 AI Suite 3 应用程序。

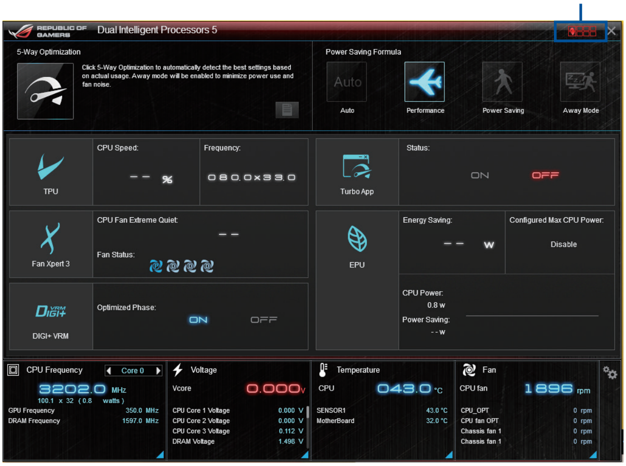


AI Suite 3 主画面

AI Suite 3 主画面提供您轻松进入控制和了解电脑发生了什么状况 - 能提供您将性能做最佳化设置，并同时确保系统的稳定性。

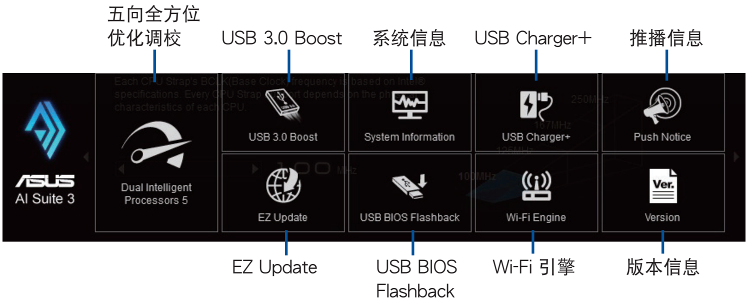
AI Suite 主画面包含一个快速进入的主菜单工具列，可以让您快速开启任何集中在这里的华硕应用程序。点击主画面右上方 图标便可以开启此主菜单工具列。

> AI Suite 3 主画面仅供参考，请以您实际看到的画面为准。



第四章

AI Suite 3 主菜单工具列



- 本章节的画面仅供参考，请以您实际看到的画面为准。
- 请参考驱动及应用程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

第四章

4.4.1 第五代双智能处理器

华硕第五代双智能处理器集成了 TPU、EPU、DIGI+ Power Control、Fan Xpert 2 与 Turbo App 等功能可以激发系统的潜能，通过 AI Suite 3 应用程序友善的用户界面，来自动平衡系统性能、电源节能、层级与风扇设置。

五向全方位优化调校

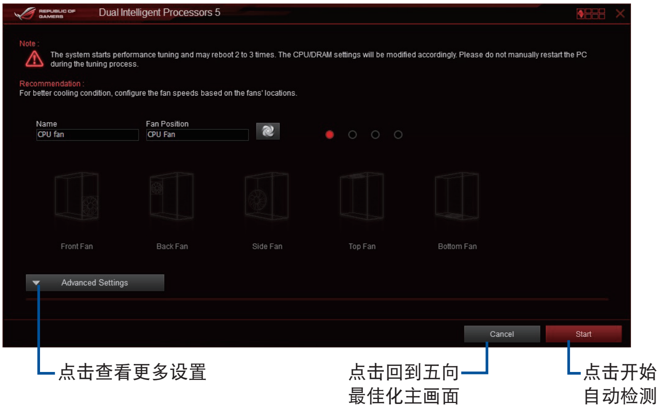
五向全方位优化调校工具程序会根据实时的实际使用状况，动态调整您的电脑以获得最佳的系统状态。该工具程序涵盖最重要的区域例如处理器性能、电源节能、稳定的数字电源、低温且安静的风扇控制，以及应用程序的最佳个性化设置来确保您的电脑已经准备好用来玩游戏、娱乐、有生产力或应付任何工作。

五向全方位优化调校主画面

> ⚠ 在调整过程中请勿卸除风扇。

使用五向全方位优化调校

点击五向全方位优化调校按钮，然后点击 开始（Start） 来依照实际使用状态自动检测最佳设置。



- 自动检测过程中系统可能会重新启动二至三遍。
- 若使用 Windows 8 操作系统，在每次系统重新启动后，点击 桌面 程序来监控自动调整程序。

TPU

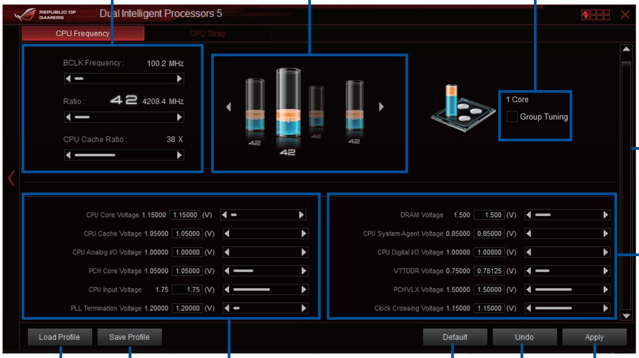
华硕 TPU 可让您手动调整 CPU 频率、CPU 缓存、CPU 核心频率、DRAM 频率，以及相关的电压来增强系统的稳定性并提升性能表现。

在调整 CPU 电压设置之前，请先参考 CPU 说明文件。设置过高的电压，可能会造成 CPU 永久损害；电压设置过低可能会导致系统不稳定。

为求系统稳定，在 TPU 做的所有更改都不会保存至 BIOS 设置中，同时也不会保留至下次启动。请使用 Save Profile 功能保存您自订的超频设置，并在 Windows 启动后手动载入设置文件。

使用 TPU

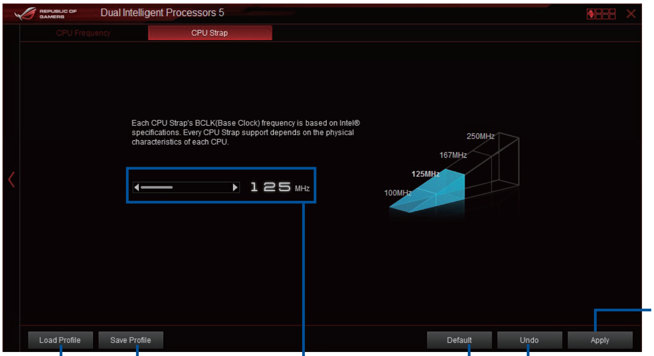
CPU Frequency



- 在使用 TPU 的 CPU Frequency 功能之前，请将 BIOS 程序中的 CPU Ratio Setting 项目设置为 [Auto]。请参考 BIOS 程序设置章节的详细说明。
- CPU Frequency 状态栏显示 CPU 核心的状态，视安装的 CPU 型号而定。

第四章

CPU Strap



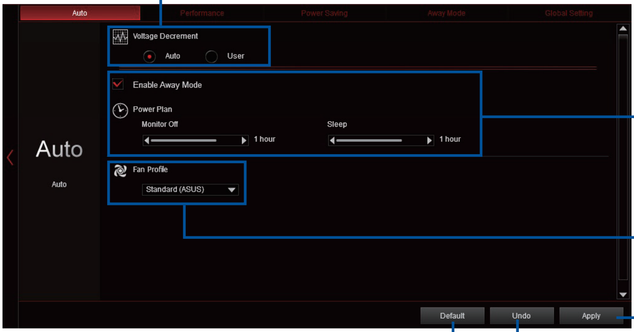
- 超频性能视 CPU 型号与系统设置而定。
- 建议您提供一个更佳的散热环境以避免过热造成主板损害。

EPU

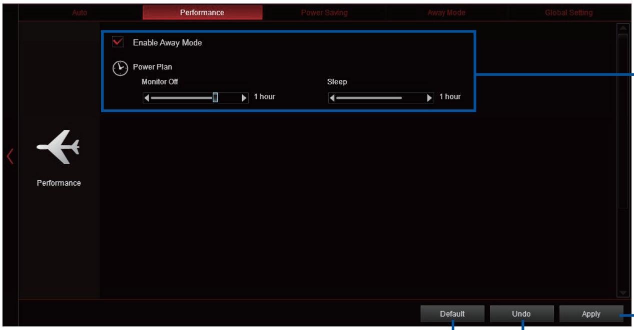
EPU 是实时系统节能芯片，自动检测现在系统的负载并智能地调整电力的使用，提供整个系统的电力最佳化、减少风扇噪音，并延长硬件元件的使用寿命。

使用 EPU

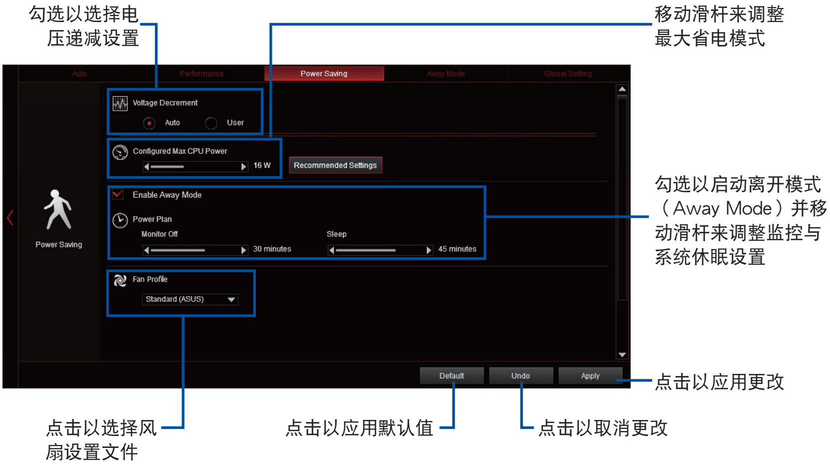
自动模式（Auto）



性能模式（Performance）

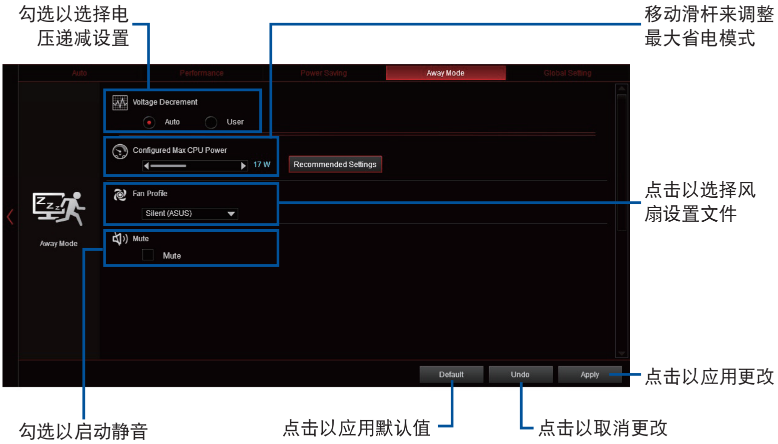


节能模式（Power Saving）



第四章

离开模式（Away Mode）

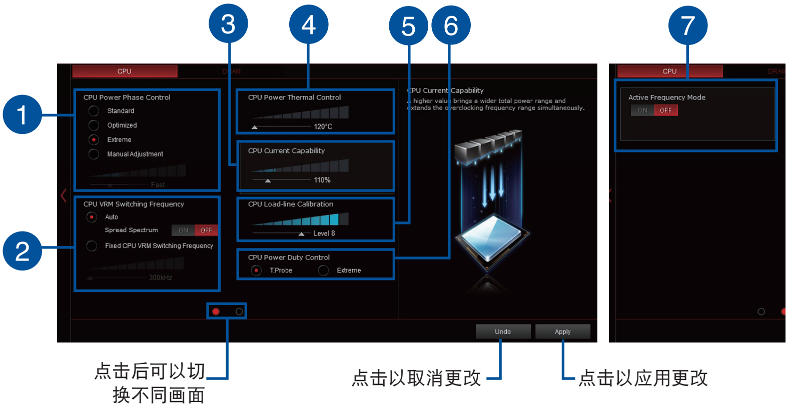


- 当您启动 Configured Max CPU Power 以求高级省电状态时，Windows® 操作系统信息中的 CPU 频率可能会显示为 800 MHz。然而 CPU 频率会根据您手动设置的功率数值而有所不同。您可以根据您偏好的默认值将 CPU 功率调至最低。
- 启动 Configured Max CPU Power 可能会降低在重系统负载情况下的 CPU 供电量并影响 CPU 性能。要将系统恢复至默认值，请重新启动。

DIGI+ Power Control

华硕 DIGI+ Power Control 是革命性创新的数字 VRM 与 DRAM 电压控制器。这些控制器提供极度精准的内存与电压调整来最佳化系统效率、稳定性与运行性能。

调整 CPU Power



1 CPU Power Phase Control

通过在重系统负载情况下增加相式数以得到更快更佳的散热性能；在轻系统负载情况下减少相式数以增加 VRM 性能。

* 当使用 iGPU 时，系统会自动将默认值设置为 [Exreme]

2 CPU VRM Switching Frequency

启动延展频谱（spread spectrum）来增强系统的稳定度。

3 CPU Current Capability

提供超频更充裕的电力供应。较高的数值带来更广的电力范围，并同时扩展超频的频率范围。

4 CPU Power Thermal Control

较高的温度可为 CPU 电源带来更广的散热范围，并扩展超频容许度以提升超频的潜力。

5 CPU Load-line Calibration

调整电压范围来控制 CPU Load-line。较高的数值可以获得系统性能，较低的数值可以提升电力使用效率。

6 CPU Power Duty Control

调整每个 VRM 相式电流与每个零组件的散热状态。

7 Active Frequency Mode

主动式频率模式（Active Frequency Mode）用来提升 CPU 的节能状态。点击 ON 在节省 CPU 电力时获得更快的暂态响应。

调整 DRAM Power

点击以取消更改　　点击以应用更改

1. DRAM Voltage Frequency
   调整 DRAM 切换频率维持系统稳定或增加超频范围。
2. DRAM Current Capability
   较高的数值带来更广的电力供应范围，并同时扩展超频频率范围。

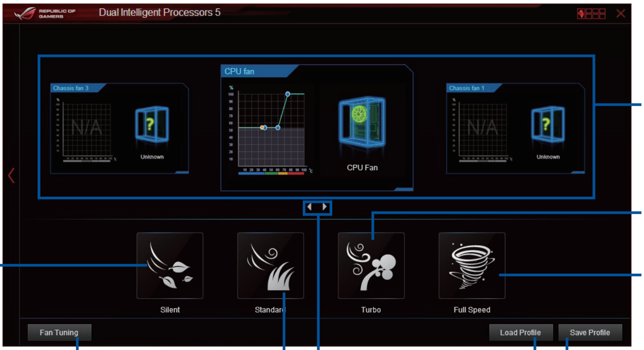
- 实际的性能会依照安装的处理器之规格而不同。
- 请勿卸除散热模块，且散热系统需受到监控。

第四章

Fan Xpert 2

华硕 Fan Xpert 2 会依照风扇的规格与位置，自动检测与调整风扇速度风扇速，提供最佳化的风扇设置。

使用 Fan Xpert 2

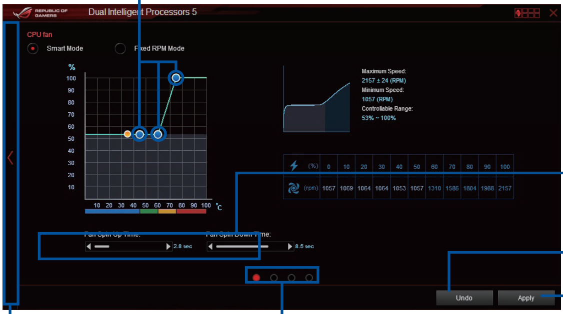


在风扇自动调整过程中请勿卸除风扇。

自订风扇设置

Smart Mode

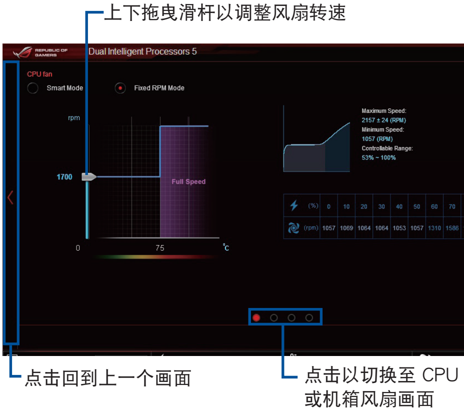
Smart Mode 可让您根据系统温度自订风扇转速与反应速度。



第四章

RPM Mode

RPM Mode 可让您设置当 CPU 温度低于 75℃ 时的风扇转速。

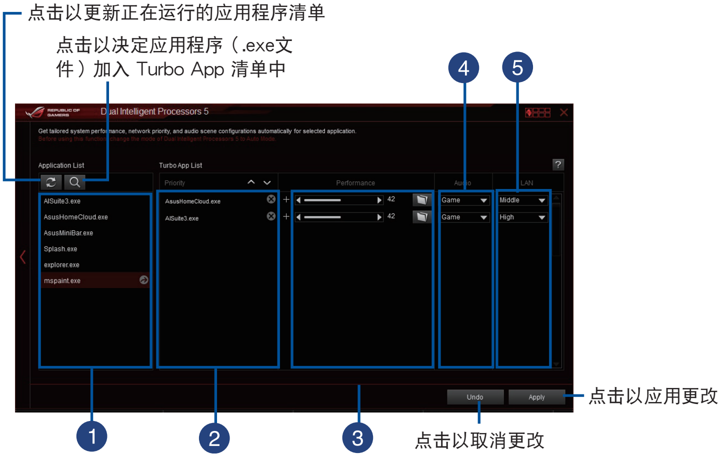


- 当 CPU 温度到达 75℃ 时，风扇会自动以全速运行以保护 CPU。
- 若是风扇有外接控制套件来控制转速，Fan Xpert 2 可能无法检测风扇的转速。
- Fan Xpert 2 仅支持采用 4-pin 或 3-pin 的风扇接口，并不支持 2-pin 风扇。如果您安装 2-pin 风扇，风扇只能以全速运行。
- 若 CPU 或机箱风扇已经更改，请再次运行风扇自动调整程序。

Turbo App（Turbo 应用程序）

本程序可以提供自订系统性能、网络优先顺序与应用程序的音频设置。

当 Turbo App 清单里有某个应用程序，您可以分配 CPU 频率、决定网络优先顺序与定义所选择的音频设置。



1. Applications list pane

   现在当前正在运行的应用程序。

2. Turbo App List pane

   显示加入 Turbo App List 字段中的应用程序。

   * 只有加入 Turbo App List 字段里的应用程序才能被设置。

3. Performance pane

   提供您分配 CPU 性能给选定的应用程序。

4. Audio pane

   提供您手动指派默认音频设置给选定的应用程序。

5. LAN pane

   提供您分配应用程序使用的网络优先顺序。

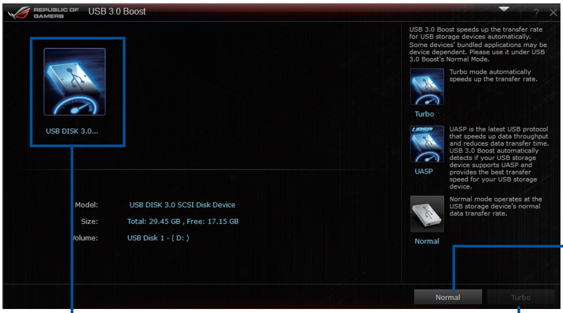
4.4.2 华硕 USB 3.0 Boost 程序

华硕 USB 3.0 Boost 程序可提升 USB 3.0 设备的传输速度，并支持 USB 连接 SCSI 协议（UASP，USB Attached SCSI Protocol）。通过华硕 USB 3.0 Boost 程序，可轻松提升您的 USB 3.0 设备之传输速度。

运行华硕 USB 3.0 Boost 程序

若要运行 USB 3.0 Boost，请点击 AI Sutie 3 主菜单右上方的 图标，然后选择 USB 3.0 Boost。

使用华硕 USB 3.0 Boost 程序



请确认连接在 USB 3.0 端口的 USB 3.0 设备有支持 USB 3.0 Boost，请参考 2.3.1 后侧面板连接端口 以了解更多说明。

- USB 3.0 Boost 会自动检测支持 UASP 的 USB 3.0 设备，若要取得支持 UASP 的 USB 3.0 设备列表，请访问华硕网站 http://www.asus.com.cn。
- 请使用 USB 3.0 设备来获得高性能表现，数据传输的速度会依照 USB 设备的不同而改变。

第四章

4.4.3 USB BIOS Flashback 向导

USB BIOS Flashback 向导可以查看并将最新版 BIOS 程序保存至 USB 存储设备，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬件特色，让您不需重新启动即可更新 BIOS 程序。

运行华硕 USB BIOS Flashback 程序

若要运行 USB BIOS Flashback，请点击 AI Sutie 3 主菜单右上方的 图标，然后选择 USB BIOS Flashback。

只有某些型号的主板搭载 USB BIOS Flashback 功能。

使用 USB BIOS Flashback 程序

设置下载 BIOS 更新的排程

1. 请于 Download Setting（下载设置） 中勾选 Schedule (days)（排程），并选择下次进行下载更新的天数。
2. 请点击 Apply 应用更改，或是点击 Cancel 以取消更改。

第四章

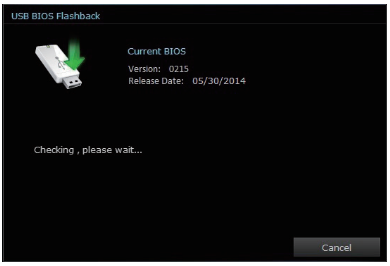
下载最新版 BIOS

> 下载前请先确认已经将支持 USB BIOS Flashback 的 USB 存储设备连接至电脑的 USB 连接端口。请参考 2.3.1 后侧面板连接端口 一节的详细说明。

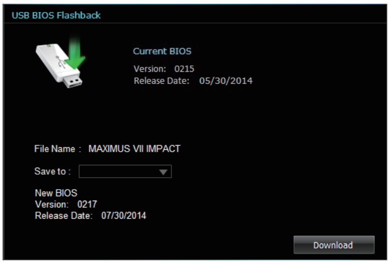
请依照以下步骤下载最新版 BIOS：

1. 在 USB BIOS Flashback 主画面中点击 Check for New BIOS Update 查看是否有 BIOS 固件更新可下载。

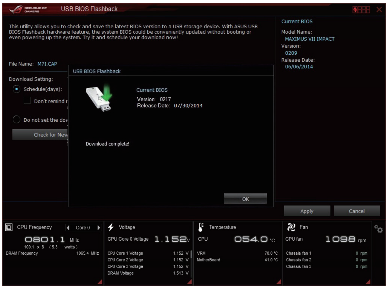
   请等待系统确认最新版的 BIOS 固件版本。



2. 当检测到新版 BIOS 固件时，请由 Save to 点击 ▼，选择 USB 存储设备后请点击 Download。



3 下载完后请点击 OK。



4.4.4 USB Charger+

USB Charger+ 用来快速充电您的便携 USB 设备，即使在电脑关机、睡眠状态或休眠状态仍可进行充电。

在使用 USB Charger+ 之前，请先确认关闭在 BIOS 设置中 Advanced 模式的 Advanced > APM > ErP Ready 的 Erp Ready 选项。

只有某些型号的主板搭载 USB Charger+ 功能。

运行 USB Charger+

若要运行 USB Charger+，请点击 AI Sutie 3 主菜单上方的 图标，然后选择 USB Charger+。

使用 USB Charger+ 程序

请确认将您的 USB 设备连接至支持本程序之 USB 连接端口。请参考 2.3.1 后侧面板连接端口 一节的详细说明。

- USB Charger+ 不支持 USB 集线器、USB 延长线以及一般的 USB 排线。
- 由于特殊设计的因素，USB Charger+ 可能无法辨识某些 ASUS 设备。

第四章

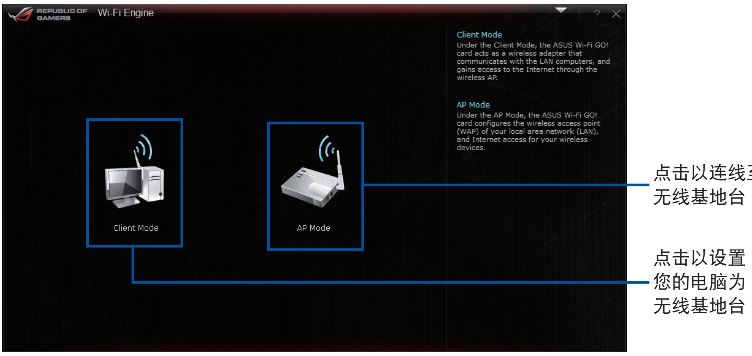
4.4.5 Wi-Fi Engine

这个程序用来连接无线网络，将电脑设置为网络分享的接入点，让其他支持 Wi-Fi 的设备可以连线。

若要运行 Wi-Fi Engine，请点击 AI Suite 3 主菜单右上方 图标，然后点击 Wi-Fi Engine。

> 只有某些型号的主板搭载 Wi-Fi Engine 功能。

使用 Wi-Fi Engine

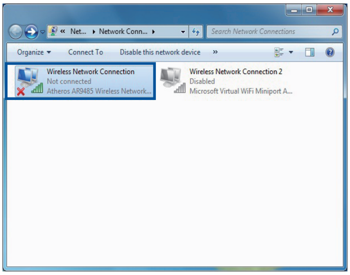


使用 Client Mode（客户端模式）

Client mode（客户端模式）提供您将电脑连线至无线网络。

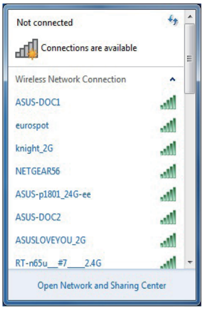
请依照以下步骤来使用 client mode（客户端模式）：

1. 点击 Client Mode（客户端模式）开启 Network Connections（局域网连线）。
2. 从 Network Connections（局域网连线）窗口里选择网络适配器。



第四章

3. 从列表中选择可以连线的网络，选择想要连线的网络。



有些网络连线时需要输入密码才能进行连线。

使用 AP Mode（基地台模式）

AP mode（基地台模式）提供您将系统设成一个接入点（基地台），以供其他无线网络设备连线。

如要使用 AP mode（基地台模式），点击 Wi-Fi Engine 菜单里的 AP Mode。

第四章

4.4.6 EZ Update

EZ Update 应用程序让您可以轻松地自动更新主板的软件、驱动程序以及 BIOS 版本。

通过这个程序，您可以手动更新 BIOS，并选择启动自我检测（POST）时想要用来显示的启动图标。

运行 EZ Update

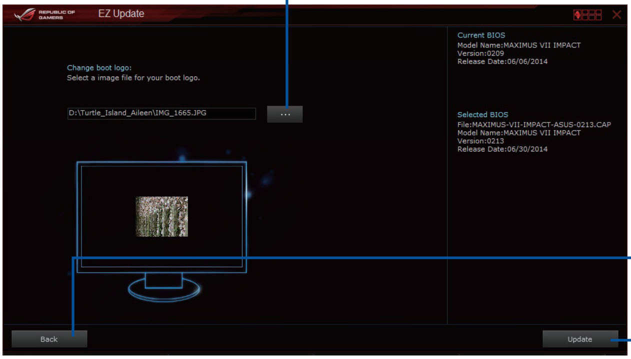
若要运行 EZ Update，请点击屏幕右上方 图标，然后点击 AI Suite 3 主菜单工具列上的 EZ Update。

EZ Update 主画面

第四章

手动更新 BIOS 与选择启动图标

点击以搜索您想使用的启动图标文件



点击以回到 EZ Update 主画面

点击以运行更新 BIOS 与启动图标

在您点击 BIOS Update 按钮后，点击 Flash 开始更新 BIOS 与上传启动图标文件至您的系统。

第四章

4.4.7 推播信息（Push Notice）

这个应用程序让您可以将系统状态的详细信息传送至智能型设备，您也可以使用这个程序传送信息至智能型设备。

> 使用这个应用程序之前，请先确认您的电脑与智能型设备已经完成配对。请参考 配对电脑与智能型设备 一节的详细信息。

启动电脑的推播信息（Push Notice）

若要启动推播信息，请点击 AI Sutie 3 主菜单右上方的 图标，然后选择 Push Notice。

推播信息（Push Notice）主画面

> 您也可以通过屏幕右上角的 Push Notice 快捷方式来启动推播信息功能，请点击 << 然后点击 ，再选择 。

配对电脑与智能型设备

请依照以下步骤配对电脑与智能型设备：

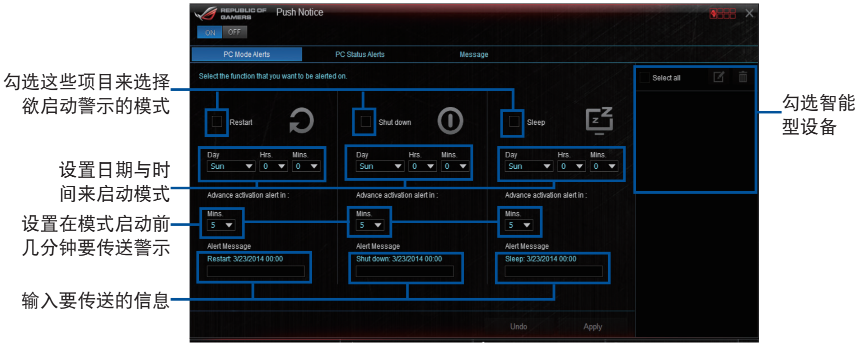
1. 在智能型设备点击 来启动推播信息（Push Notice）。
2. 轻触 Push Scan 然后点击想要配对的电脑名称。

> 若要配对电脑与智能型设备，请先确认二个设备都已经连接至同一个无线网络。

第四章

设置要发出警告的模式

本功能用来设置当电脑重新启动、关机或进入睡眠模式时，传送警示信息至智能型设备。



设置电脑状态警示

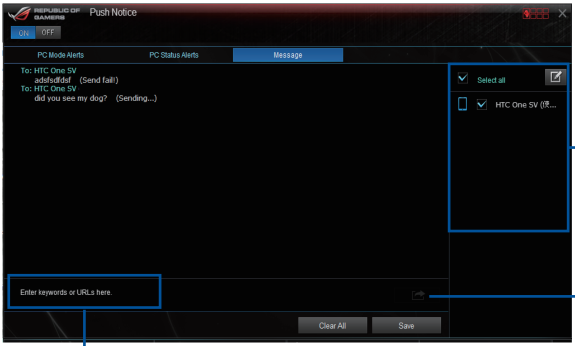
本功能用来将电脑上不正常的状态，如：电压、温度和风扇设置等信息传送警示至智能型设备。

第四章

传送信息至智能型设备

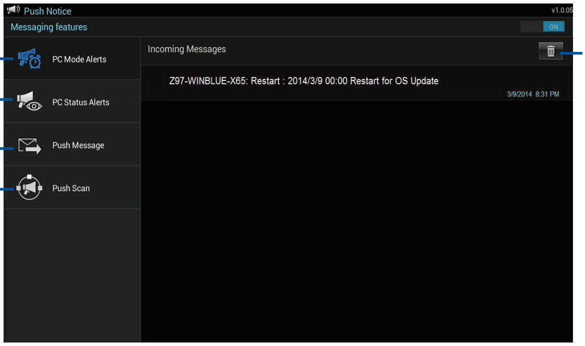
本功能用来传送信息至智能型设备。

> 您也可以通过屏幕右上角的推播信息（Push Notice）信息快捷方式来传送信息，请点击 << 然后点击 ，再选择 。



在智能型设备查看电脑状态

在智能型设备点击 Push Notice 以启动推播信息（Push Notice）。



4.4.8 系统信息

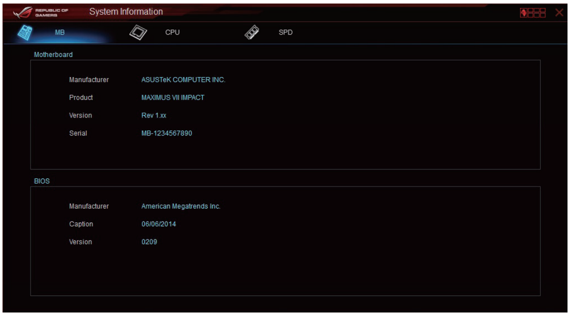
这个程序可以让您获得本主板、处理器与内存设置的详细信息。

运行系统信息

若要运行系统信息，请点击屏幕右上方 图标，然后点击 AI Suite 3 主菜单工具列上的 System Information（系统信息）。

查看主板信息

从系统信息主画面，点击 MB（主板） 标签页来查看主板的相关信息。



查看处理器信息

从系统信息主画面，点击 CPU（处理器） 标签页来查看处理器的相关信息。

查看 SPD 信息

从系统信息主画面，点击 SPD 标签页来查看内存的相关信息。

第四章

4.5 Wi-Fi GO!

Wi-Fi GO! 是华硕独家应用程序，提供您在任何时间、任何地点都能通过智能型设备完全掌控您的电脑。您可以轻易地在电脑与智能型设备间管理云端空间，或是同步与备份文件。

- 若要在不同网域使用 Wi-Fi GO! 功能，请在电脑与智能型设备登入华硕帐号。
- 本章节的画面仅供参考，请以您实际操作的画面为准，请访问华硕网站 http://support.asus.com 获得更新的技术文件。

智能型设备的用户界面可能会因操作系统与屏幕分辨率不同而异。

系统需求

系统需求	电脑	智能型设备
操作系统	Windows® 7/Windows® 8	Android 2.3 或更新版本 iOS5 或更新版本
应用程序	ASUS AI Suite 3	ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote

- 若您使用 Android 智能型设备，请从 Google Play 下载 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程序。若您使用的为 iOS 设备，请从 App Store 下载 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程序。
- 请由主板包装盒内随附的 DVD 光盘或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 安装 Wi-Fi GO! 卡驱动程序与 ASUS HomeCloud 应用程序。
- 若从 Windows® 8 更新至 Windows® 8.1，请确认重新安装 Wi-Fi GO! 卡驱动程序才能完全使用 Wi-Fi GO! 的功能。

智能型设备支持的屏幕分辨率

Wi-Fi GO! & NFC Remote 支持以下智能型设备屏幕分辨率：

屏幕类型	低密度（120, ldpi）	中密度（160, mdpi）	高密度（240, hdpi）	超高密度（320, xhdpi）
屏幕分辨率	1024 x 600	WXGA (1280 x 800)	1536 x 1152	2048 x 1536
		1024 x 768	1920 x 1152	2560 x 1536
		1280 x 768	1920 x 1200	2560 x 1600

4.5.1 登入华硕帐号

Wi-Fi GO! 让您无论何时何地都能完全地控制您的电脑。在电脑与智能型设备创建并登入同一个华硕帐号来使用跨网域功能。

> Remote Desktop 与 File Transfer 支持跨网域使用功能。

创建一个华硕帐号

> 在创建帐号之前请先确认已经连线至互联网。

请依照以下步骤创建华硕帐号：

1. 启动 ASUS HomeCloud 然后点击 。
2. 在 Wi-Fi GO! 画面点击 > 创建一个新的帐号，浏览器会直接连接至华硕网站（www.asus.com.cn）。
3. 在华硕网站点击 登入，然后依照屏幕指示来完成注册。

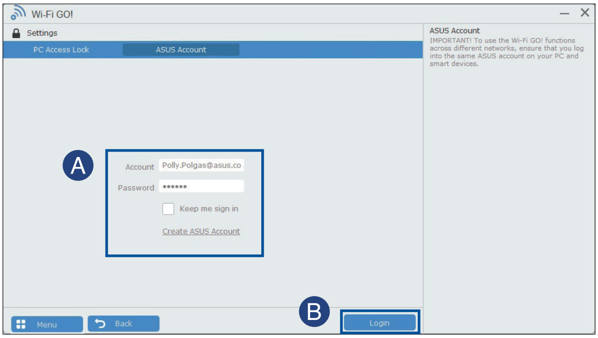
登入华硕帐号

使用电脑登入：

1. 启动 ASUS HomeCloud 然后点击 。

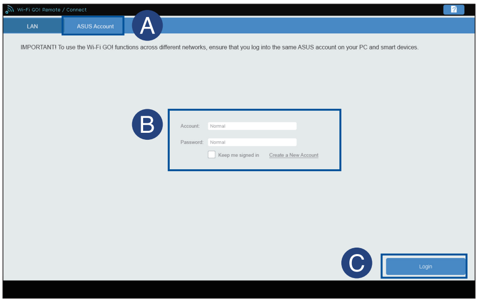
> 第一次在电脑上运行 Wi-Fi GO! 时会出现登入的提示画面，若要关闭这个提示画面并希望以后都不要再出现，请勾选 不要再提示，然后点击 进入登入。

2. 在登入画面输入您的华硕帐号与密码 (A)，然后点击 登入 (B)。



使用智能型设备登入：

1. 在智能型设备启动 然后点击 进入。
2. 在 Wi-Fi GO! & NFC Remote 画面点击 华硕帐号 (A)，输入您的华硕帐号与密码 (B)，然后点击登入 (C)。



- 以同一个华硕帐号登入的所有电脑会显示在设备列表上。
- iOS 系统的跨网域使用功能会在 Wi-Fi GO! & NFC Remote V2.00.00 或更新的版本之后才能使用。

4.5.2 使用 Wi-Fi GO!

若要使用 Wi-Fi GO!，请启动桌面上的 ASUS HomeCloud 然后点击 。

为保护您的 Wi-Fi 应用程序免于未授权遥控存取，请点击 然后设置密码。

在智能型设备运行 Wi-Fi GO! & NFC Remote 程序来使用 Wi-Fi GO! & NFC 遥控控制功能，若要获得更多详细的信息，请参阅以下 Wi-Fi GO! & NFC Remote 的说明。

第四章

Wi-Fi GO! & NFC Remote（智能型设备用程序）

运行 Wi-Fi GO! & NFC Remote

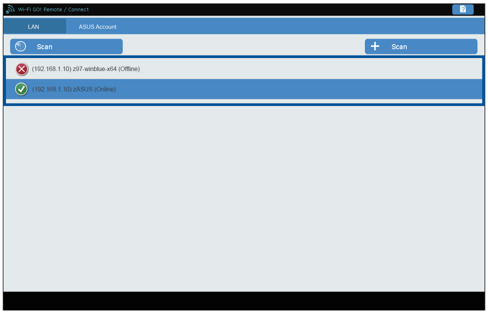
请依照以下步骤使用 Wi-Fi GO! & NFC Remote：

1. 在智能型设备启动 然后点击 进入。

2. 您可以使用以下任一方式连接智能型设备与电脑：
   a. 连接至相同网域，点击 网络。
   b. 使用华硕帐号，点击 华硕帐号 然后输入您的用户名称与密码，再点击 登入。

> 当您使用华硕帐号连接智能型设备与电脑时，只能使用 Remote Desktop 与 File Transfer 功能。

3. 在扫描电脑的列表中，点击想要与智能型设备连线的电脑。



设置完成后，Wi-Fi GO! & NFC Remote 界面会显示在您的智能型设备。

第四章

Wi-Fi GO! & NFC Remote 主画面

以上画面仅供参考，实际画面会随着智能型设备不同而异。

使用网络唤醒功能

若是您想要使用智能型设备唤醒电脑功能，请确认已经启动电脑的网络唤醒（Wake-on-LAN）功能设置。请依照以下步骤设置网络唤醒功能：

1. 在 BIOS 设置中，进入 Advanced > APM Configuration 然后将 Power On By PCI-E/PCI 项目设置为 [Enabled]。
2. 在 Windows® 操作系统中请依照以下步骤进行设置：
   a. 在电脑桌面点击 开始，按鼠标右键点击 电脑 > 管理 来启动电脑管理窗口。
   b. 点击 设备管理器 来查看所有安装的设备。
   c. 点击 网络适配器，在安装的扩展卡按鼠标右键，然后点击 内容 > 电源管理 标签页。
   d. 勾选 允许这个设备唤醒电脑 与 只允许 Magic 封包唤醒电脑。

若使用 802.11ac 规格的 Wi-Fi GO! 卡，网络唤醒功能将会在下一个版本的 Windows® 8 操作系统中开始支持。

第四章

Cloud GO!

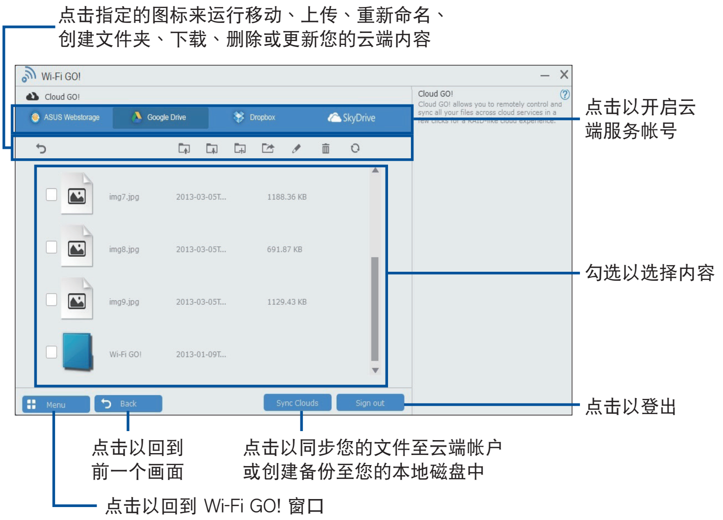
Cloud GO! 让您通过多种云端服务，例如 ASUS WebStorage、Dropbox、Google Drive 与 SkyDrive 来控制与同步文件。

- 在使用 Cloud GO! 时请先确认您的电脑系统与智能型设备的日期与时间设置正确。
- 由于云端保存的限制，您只能上传或同步最高达 100MB 的文件。
- 当您运行文件同步时，会自动将文件同步至每个云端保存的 Wi-Fi GO! 文件夹；此外，您可以在本地磁盘的 Favorites（我的最爱）文件夹中找到文件备份。
- 在电脑先登入云端保存帐号，然后维持登入状态以便让智能型设备遥控。

请依照以下步骤使用 Cloud GO!：

1. 在 Wi-Fi GO! 画面点击 Cloud GO!。
2. 勾选 EULA 然后点击 进入。
3. 进入云端服务帐号后点击 登入。

进入 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 帐后然后点击 登入，Cloud GO! 会导引您至 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 网站让您登入帐号。



Remote Desktop

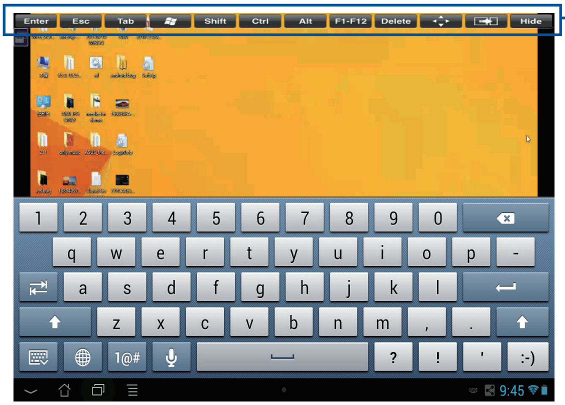
Remote Desktop 让您使用智能型设备实时远端遥控电脑桌面。

> 当使用 Remote Desktop 功能时，系统用户帐号控制（UAC）将被设置为永不通知（Never Notify）。UAC 层级在您离开 Remote Desktop 之后会回到前一次的设置。

请依照以下步骤使用 Remote Desktop：

在智能型设备的 Wi-Fi GO! 画面点击 Remote Desktop。

Windows® 8 的 Remote Desktop 界面



Remote Desktop 功能按键

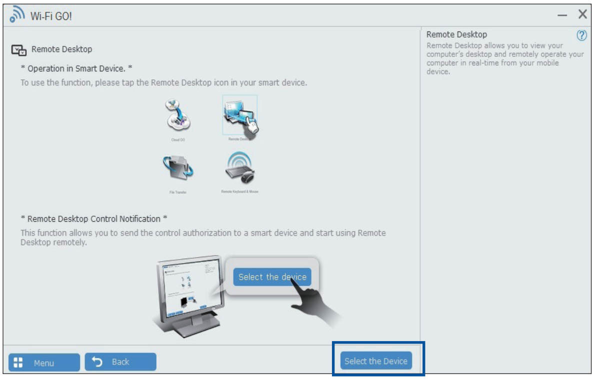
- 选择多指触控模式来支持 Windows® 8/Windows® 8.1 的 Microsoft 多指触控功能。
- 选择鼠标模式来支持缩放与一般鼠标功能。
- 对 Extended Mode（扩展模式）的支持会随着电脑安装的 VGA 驱动程序而有不同。

Remote Desktop Control 通知

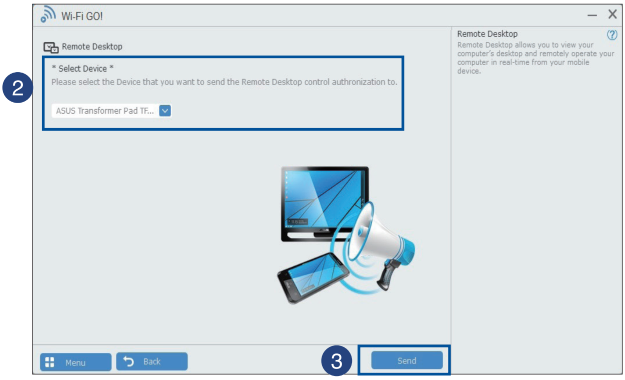
　本功能用来传送控制权至智能型设备，并直接在设备上开始使用 Remote Desktop。

请依照以下步骤使用 Remote Desktop Control 通知：

1. 点击 选择设备。



2. 从下拉式菜单选择设备。
3. 点击 传送 来将 Remote Desktop control 授权传送至选择的设备。



本功能需要系统中安装有 推播信息 功能，您可以在包装盒内附的驱动程序与应用程序光盘中找到推播信息的应用程序安装文件，或是从华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的安装文件。

第四章

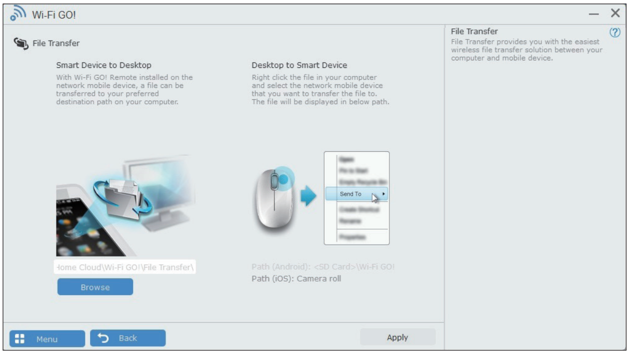
File Transfer

File Transfer 用来在电脑与智能型设备之间，只要在大众专用网络中一指触控即可同步与分享文件。

从电脑传送文件至智能型设备

请依照以下步骤从电脑传送文件至智能型设备：

1. 点击 File Transfer。
2. 点击 设置 来选择要传送文件的目的地。
3. 按鼠标右键然后选择 传送至 > [设备名称]。



4. 传送文件完成后，点击 OK。

- 若要在 iOS 设备接收文件，请进入 设置 > Privacy > Photos，然后启动 Wi-Fi GO! & NFC Remote。
- 若要寻找传送的文件，在 Android 设备中请至 <SD Card>\Wi-Fi GO! 寻找，而 iOS 设备请至相簿寻找。

从智能型设备传送文件至电脑

请依照以下步骤从智能型设备传送文件至电脑：

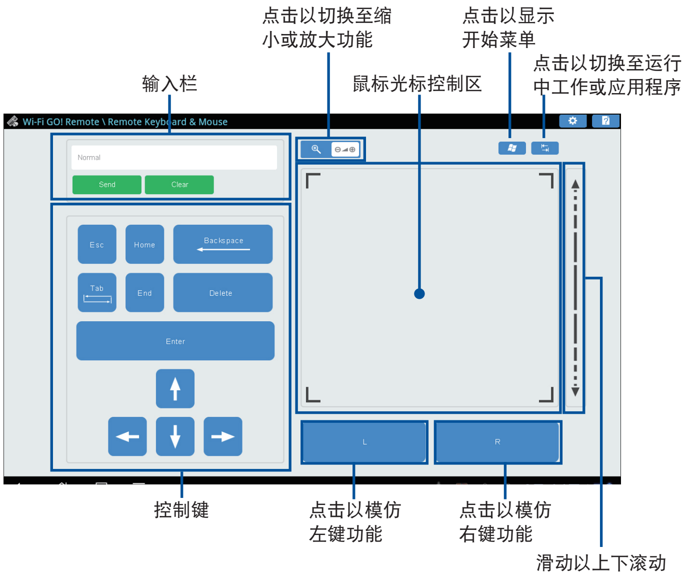
1. 点击 文件传送 > Enter。
2. 勾选欲传送的文件然后点击 传送。

请至 X:\Users\Documents\ASUS HomeCloud\Wi-Fi GO!\File Transfer\ 寻找传送的文件，或是点击 设置 来选择新的保存位置。

第四章

Remote Keyboard & Mouse

Remote Keyboard & Mouse 用来将智能型设备的触控屏幕作为电脑的遥控键盘与鼠标。



第四章

4.6 ASUS Media Streamer

ASUS Media Streamer 让您可以在任何地点都能享受电脑中的多媒体娱乐。您可以使用电脑或智能型设备将电脑中的音乐或最喜欢的电影串流播放至智能型电视。

- 请确认先启动智能型设备中的 DLNA 设置。
- ASUS Media Streamer 支持 NFC 功能。有些功能可能需要安装 NFC EXPRESS 2。请访问 http://www.asus.com.cn 来获得更多关于 NFC EXPRESS 2 的信息。
- 若您使用 Android 智能型设备，请从 Google Play 下载 ASUS Media Streamer 程序。若您使用的为 iOS 设备，请从 App Store 下载 ASUS Media Streamer 程序。

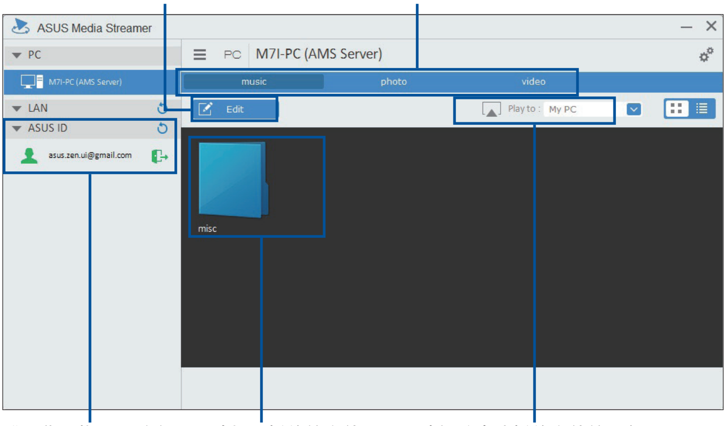
- iOS 系统中的跨网域使用功能要在 Media Streamer V2.00.00 或更新的版本才能使用。
- iOS 系统仅支持 Media Streamer 的照片与影片串流功能。

4.6.1 系统需求

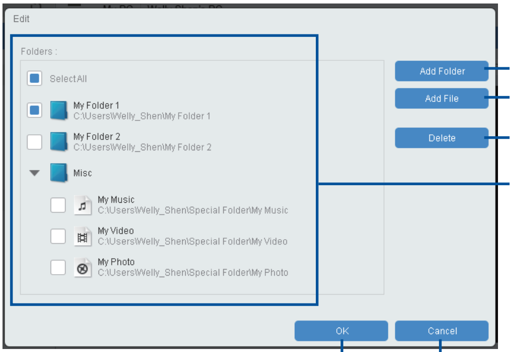
系统需求	电脑	智能型设备
操作系统	Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1	Android 4.0 或更新的版本 iOS7 或更新的版本
应用程序	ASUS HomeCloud	ASUS Media Streamer

4.6.2 使用 ASUS Media Streamer

在电脑桌面点击 ASUS HomeCloud，然后点击 。在智能型设备点击 Media Streamer。



新增与删除文件



以下为 Android 与 iOS 设备支持的文件格式：

- Android：.3gp、.mp4、.m4a、.aac、.ts、.flac、.mp3、.mid、.xmf、.mxmf、.rtttl、.rtx、.ota、.imy、.ogg、.mkv、.wav、.jpg、.gif、.png、.bmp、.webp、.webm。
- iOS：.mov、.mp4、.mpv、.3gp。

第四章

4.7 ROG 音频功能

安装软件

安装主板配件中的驱动及应用程序 DVD 光盘里的 Realtek® Audio Manager 音频程序。

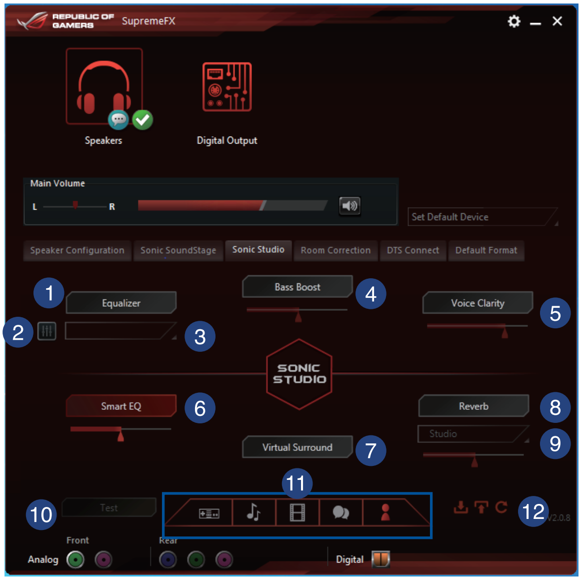
若 Realtek® 音频软件已经安装，您可以在桌面下方工具列上找到 Realtek® HD Audio Manager 图标。请使用鼠标左键双击点击图标以显示 Realtek® HD Audio Manager 音频管理程序。

Realtek® HD Audio Manager 程序

4.7.1 Sonic Studio

Sonic Studio 是一个音频调整软件，此软件提供了包含六项音频设置：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（语音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）与 Virtual Surround（虚拟环绕）功能。虚拟音频通过 2 声道耳机可以做出模拟与提供游戏时的环绕音场效果。

> Sonic Studio 没有独立的安装程序，当您安装 Realtek 音频驱动程序时，本程序将自动安装至您的电脑。



1. Equalizer switch（等化器开关）
点击以启用这项功能，提供您根据自己的喜好调整等化器的参数值。

2. Equalizer advanced settings（等化器高级设置）
本项目仅当 Equalizer switch 启用会才会显示，提供您设置等化器的设置值。您可以手动设置或自订偏好的设置或选择已存在的默认等化器设置值。

3. Equalizer presets（默认等化器）
选择当前或选定的默认等化器。

4. Bass Boost switch（重低音开关）
点击可以增强重低音频果，拖曳滑杆以调整音频的重低音频果。

5. Voice Clarity switch（语音清晰度开关）
启用 Voice clarity 可以将人声读取更清晰，以获得更好的对话/音频通讯质量，或聆听音乐时让人声表现更清晰。

6. Smart EQ (Smart Volume) switch（智能 EQ 音场开关）
提供动态调整 EQ 可以让人听到更多的细节。

7. Virtual Surround switch（虚拟环绕音频开关）
本项目提供您开启耳机的 7.1 声道环绕音频。

8. Reverb switch（回音开关）
Reverb（回音）效果为 Virtual Sound Stage 的一部分，可以让您选择其他回音频果。

9. Reverb presets（默认回音）
点击以选择默认回音，然后设置不同环境空间的回音频果。
当 Reverb switch 项目启用时，本项功能才能使用。

10. Test tone（测试音）
点击后可以开始测试默认设置文件。

11. Preset profiles（默认文件）
可以从游戏、音乐、电影或通讯使用时点击任一默认文件。

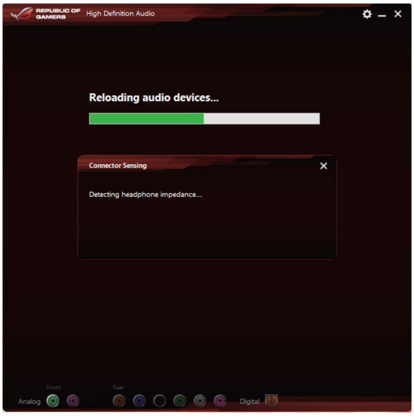
12. Profile import/export（设置文件汇入/汇出）
提供您汇入、汇出或还原设置文件至默认状态。

4.7.2 Sonic SenseAmp

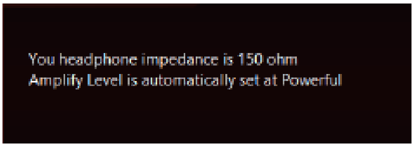
Sonic SenseAmp 是 ROG 独家研发的技术，提供主板内置音频的耳机扩大机（AMP），具备三个 AMP 等级的调整器。可以检测耳机的阻抗与调整对应至内置的扩大机（AMP）。

- Sonic SenseAmp 仅支持于前面板连接使用。
- 将耳机的音量调至最大以获得正确的阻抗检测。

当您将耳机插入耳机孔后，Sonic SenseAmp 会立即弹出交谈窗口并显示“Detecting headphone impedance”（检测到耳机设备）。



在检测好耳机的阻抗后，Sonic SenseAmp 会弹出类似如下的窗口。



当调整检测耳机的阻抗时，请参考下表有关 Sonic SenseAmp 的建议：

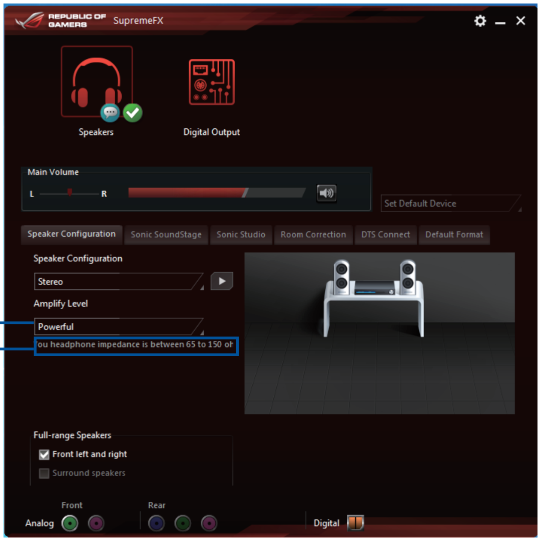
65 ohm 或更低	扩大机等级自动设置为 Performance
65 ohm 至 150 ohm	扩大机等级自动设置为 Powerful
> 150 ohm	扩大机等级自动设置为 Extreme
其他设备	插入的设备会检测为其他设备

第四章

在您关闭弹出窗口后，Sonic SenseAmp 会进入喇叭设置，并且显示调整耳机的阻抗。

点击以手动调整扩大机等级

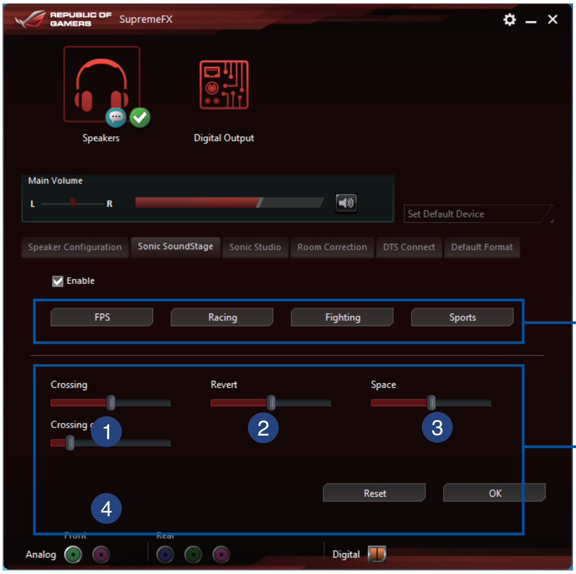
显示耳机的阻抗



4.7.3 Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 为采用硬件基础的虚拟摄影棚完整解决方案，提供了四种游戏默认文件：FPS（第一人称射击）、Racing（赛车）、Combat（格斗）与 Sport（运动）。

- 本项功能仅适用于连接前面板连接耳机输出。
- 您可以通过主板上的 SoundStage 按钮来启用这项功能。请参考 1.2.6 主板上的内置按钮与开关 一节的说明。



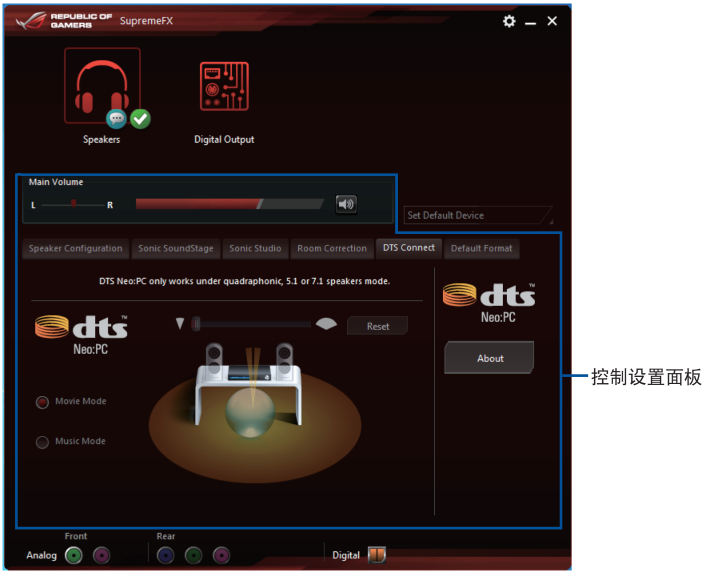
点击四个游戏默认文件的任一设置

手动使用滑杆拖曳以设置该项目

1. Crossing
   移动滑杆来调整跨通道的混和量。
2. Revert
   移动滑杆来还原至主音源。
3. Space
   移动滑杆来调整和虚拟空间声音。
4. Crossing gain
   当 Crossing and Revert 启用时，本项目才会显示。移动滑杆来调整墙壁的硬度。

DTS Connect

DTS Connect 提供包含支持所有音频娱乐的格式，并采用 4、5.1 与 7.1 声道提供不可思议的环绕音频。这项功能并且能让您将电脑与家庭剧院系统连接。



第四章

4.8 Sonic Radar II

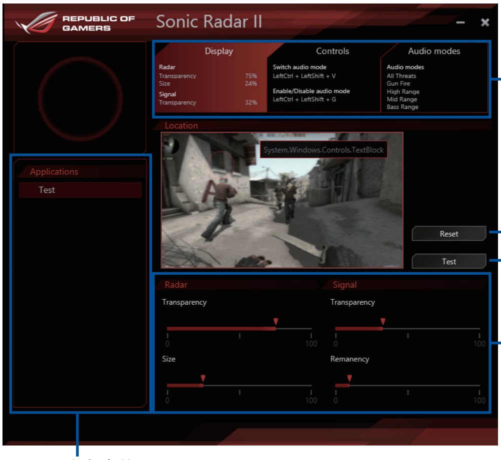
Sonic Radar II 是专为第一人称射击（FPS）游戏设计，可显示声音的精确方向，以及声音从哪边来的强度。具备友善的操作界面，并提供音响扩大器功能以放大所需的声音频果。

- Sonic Radar II 没有独立的安装程序，当您安装 Realtek 音频驱动程序时，本程序将自动安装至您的电脑。
- Sonic Radar II 在安装完成后不会自动启动，您可以从桌面或所有程序菜单来启动这个程序。

您也可以在系统启动后即启动 Sonic Radar II，请从工具列点击 ，然后在 按鼠标右键，再点击 启动 Sonic Radar II（Enable Sonic Radar） 或 在启动时启动（Enable Launch at Startup）。

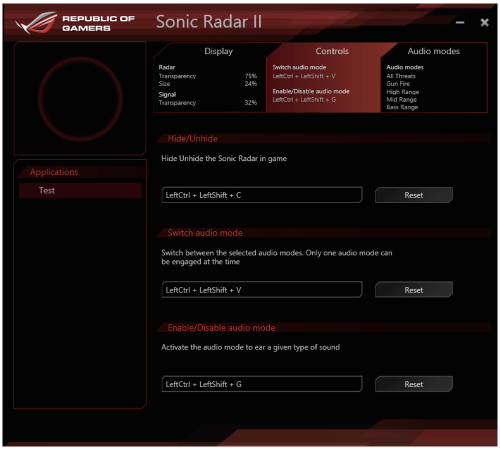
Display Menu（显示菜单）

可提供您自订每个游戏的设置，包含 Transparency（透明度）、Signal（信号）、Size（大小）与 Remanency（剩余磁感）。



Control Menu（控制菜单）

提供您设置快捷键。



Audio Mode/Radar Selection menu（音频模式/雷达选项菜单）

提供您设置增强音频。

点击以选择想要增强的音频

Audio Mode/Radar Selection 可以在游戏进行中使用快捷键开启，请参考 Controls（控制）标签页以了解更多有关快捷键设置的说明。

4.9 GameFirst III

GameFirst III 是一个网络管理软件，提供四种默认封包优先处理设置文件（最佳化、游戏、串流媒体与文件共享），以便于用户的需求。用户也可以手动分配带宽，并调整设置每个应用程序的优先顺序，让运行速度更快、更流畅。

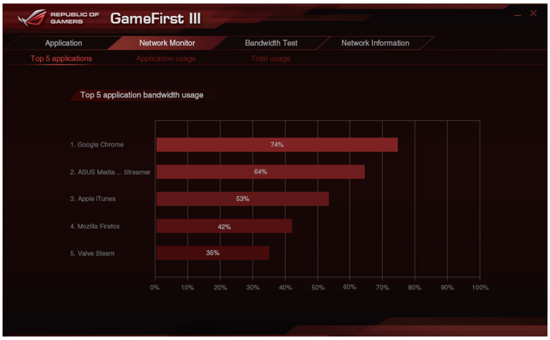
如欲使用 GameFirst III，请使用鼠标左键双击点击桌面上的 图标。

1. Optimization Mode（最佳化模式）
   游戏封包的优先顺序与其他封包也进行最佳化。
2. Game Mode（游戏模式）
   将游戏封包放在最优先顺序。
3. Media Streaming Mode（串流媒体模式）
   将串流媒体封包放在最优先顺序。
4. File Sharing Mode（文件分享模式）
   将文件分享封包放在最优先顺序。

Network Monitor（网络监控）

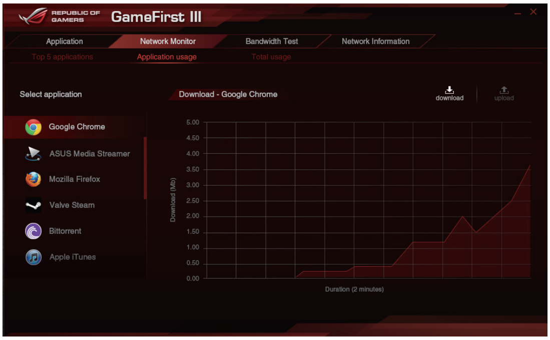
Top 5 application（前 5 名应用程序）

显示当前使用量排名前 5 名消耗带宽量的应用程序。



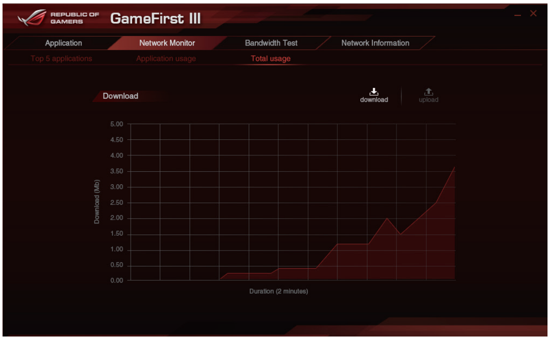
Application usage（应用程序使用状况）

显示当前使用的应用程序之个别的下载和上传带宽。



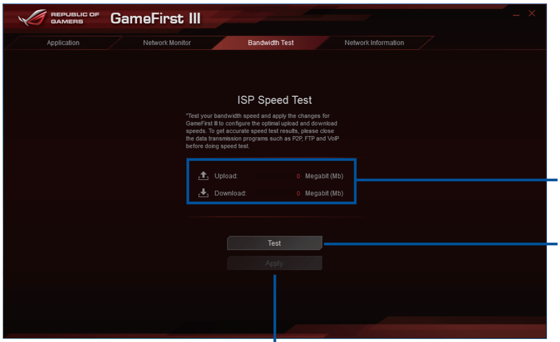
Total usage（总使用量）

显示当前使用的应用程序的总下载和上传带宽量。



Bandwidth Test（带宽测试）

你可以使用这项功能来测试互联网服务供应商M（ISP）速度或在需要时，以手动方式输入想要的上传/下载速度与应用其速度。



Network Information（网络信息）

显示有关物理网卡的相关信息，如 speed（速度）、physical address（物理地址）、IP address（IP 地址）、subnet mask（子网络遮罩）与 default gateway（默认闸道器）

4.10 KeyBot

KeyBot是一个内置的微型处理器，可以瞬间将键盘升级。这项功能可以提供您设置和指派聚集至键盘上指定的按键，便能同时运行特定或多项任务。并且还可以设置电脑在 CPU Level Up、XMP 的唤醒功能，或直接唤醒 BIOS 模式。

请依照以下方式使用 KeyBot：

1. 按下主板上的 KeyBot 按钮。

> 当 KEYBOT_LED 灯号亮灯时，表示 KeyBot 功能已经开启。

2. 将 USB 接口键盘插入支持 KeyBot 功能的 USB 端口。

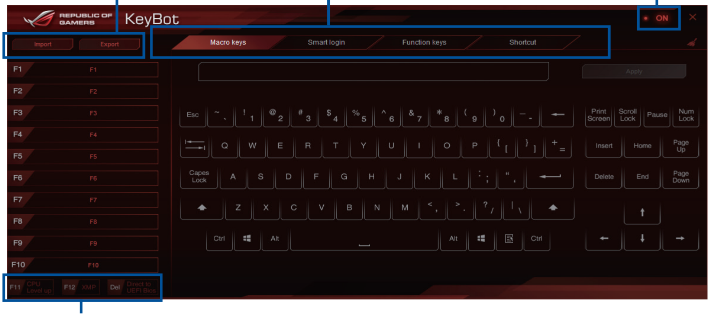
> 请参考 2.3.1 后侧面板连接端口 或 2.2 BIOS 更新 一节的说明，以了解更多有关 KeyBot USB 端口的信息。

3. 使用鼠标左键双击点击桌面上的 图标，以开启 KeyBot 应用程序。

点击以汇入或汇出设置文件

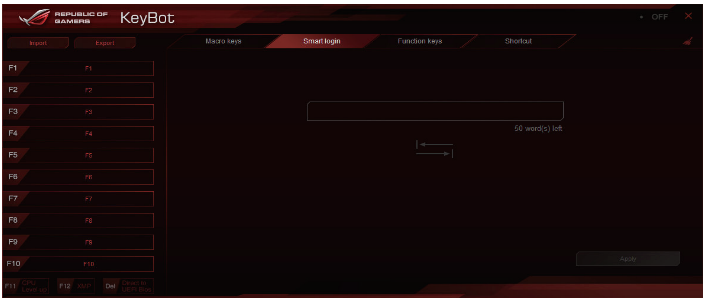
点击以进行 Macro keys、Smart login、Function keys 与 Shortcut 设置

勾选以切换 KeyBot 功能为开（On）/关（Off）



点击以运行特定的任务，或点击其对应的键盘按键

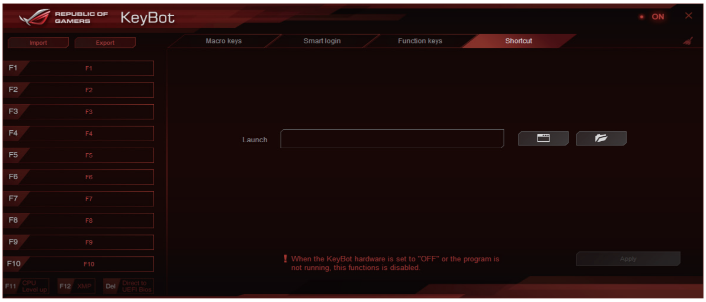
Smart login（智能登入）



第四章

Function Keys（功能键）

Shortcut（快捷键）

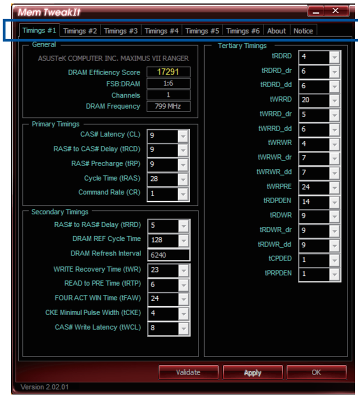


4.11 MemTweakIt

MemTweakIt 是一套软件提供您查看各等级的内存时钟。您可通过 Mem TweakIt 验证您的内存性能分数，并在 ROG 官方网页上与其他用户比较分数排名。

MemTweakIt 功能为根据主板的类型而定，每个芯片具备不同的选项。

要开启此功能，请使用鼠标左键双击桌面上的 图标。



点击标签页以设置内存时钟

点击 About 标签页然后点击 REPUBLIC OF GAMERS 可以进入 ROG 官方网页

点击以离开 MemTweakIt

点击以应用设置

点击以验证设置

第四章

验证和保存您的 MemTweakIt 设置

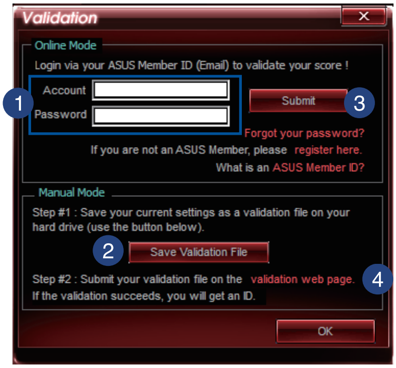
请依照以下方式验证与在线上保存您的设置值：

1. 开启 MemTweakIt 后点击 Validate（验证）。
2. 在 Online Mode（在线模式），输入您的华硕 Account（帐号）与 Password（密码）后，点击 Submit（提交）。

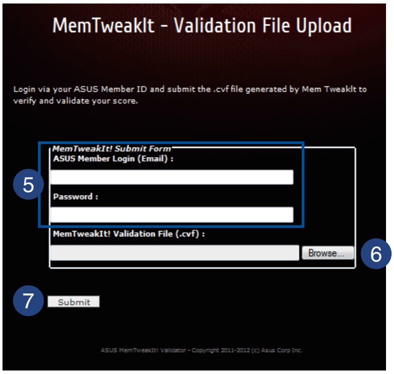
> 您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

手动设置 validate（验证）与保存您的设置值：

1. 开启 MemTweakIt 后，点击 Validate（验证）。
2. 在 Manual Mode（菜单模式）中，点击 Save Configuration File（保存设置文件）。
3. 针对您的设置文件输入一个文件名，然后点击 Save Vaildation File。
4. 点击 validation webpage。



5. 在 MemTweakIt - Validation File Upload 窗口中，输入您的 account ID（帐号）与 password（密码）。
6. 点击 Browse（浏览），找到保存 .cvf 文件的位置后，点击 Open（开启）。
7. 点击 Submit（提交）。



> 您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

第四章

4.12 RAMDisk

RAMDisk 是数据保存软件，使用部分系统内存将它变成一个高速的虚拟磁盘，提供您在此保存缓保存文件案与游戏程序，而能达到立即读取。RAMDisk 允许您自动备份、更新与恢复文件。

> 下列的文件夹并非为最适合的 RAMDisk 最佳化，移动它们至 RAMDisk 可能会对您的系统生成负面的影响。
>
> - Swap file/Page file（分页文件）：Swap file 是一个永久的保存空间，由系统内存的虚拟内存所延伸。移动 Swap file至 RAMDisk 容易发生全部占有的缺点，而可能会影响系统性能。
> - Startup folders（启动文件夹）：当 RAMDisk 在启动时一起载入汇合的文件夹内容时，更改启动文件夹的区域可能会导致系统异常并且关闭载入您的 RAMDisk。

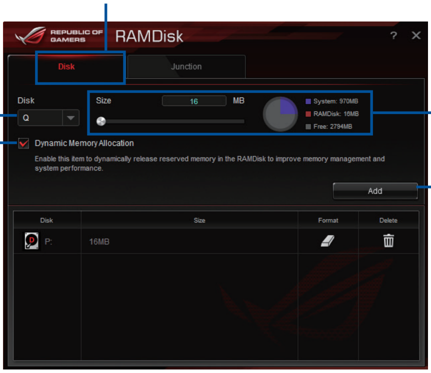
请点击 以开启 RAMDisk。

创建/删除 RAMDisk 磁盘

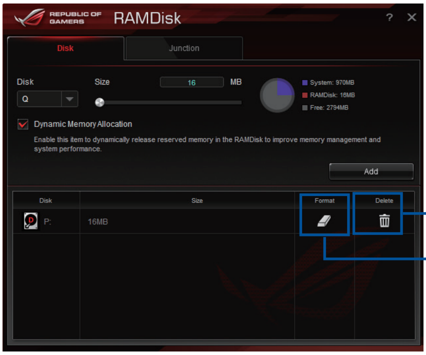
RAMDisk 磁盘提供放置您最爱的应用程序与文件至 RAM（内存）里，这么一来便可以有效的运用内存速度，以获得最佳的读取/写入性能。当您的电脑每次关机时，保存在 RAMDisk 里的文件则会自动进行备份。

> 启动可能需要一段等待时间，视您的 RAMDisk 磁盘大小而定。

创建 RAMDisk 磁盘



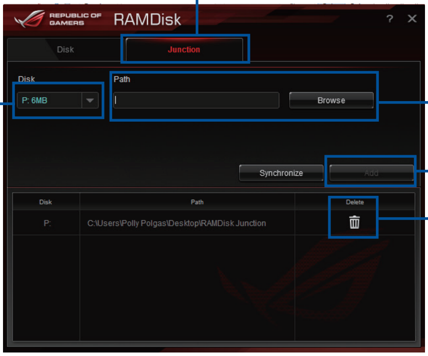
删除或格式化现有的 RAMDisk 磁盘



格式化功能只有在您的磁盘已经启动动态内存分配（Dynamic Memory Allocation）功能时才能使用。

创建/删除一个连接点

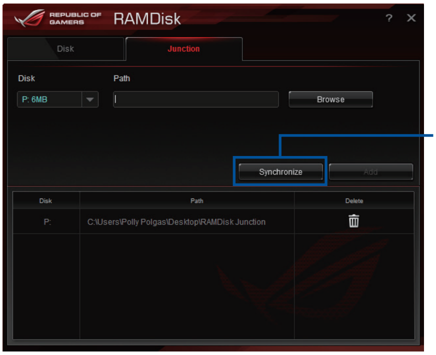
创建一个连接点，可以重新对应 RAMDisk 的原始内容，启用读取需要的应用程序或文件作为原始文件位置。



第四章

同步备份文件

在完成创建连接点（junction point）后，RAMDisk 会自动创建一个文件夹在原始的位置。使用 RAMDisk 以手动方式同步更新这些备份文件。



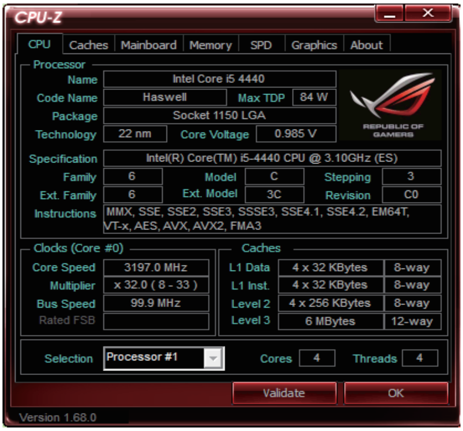
点击 Synchronize（同步）来更新文件

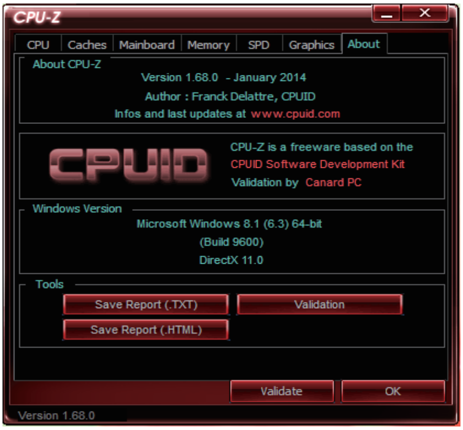
第四章

4.13 ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 为 CPUID 针对 ROG 所量身订做的版本。具备与原来版本相同的功能与可信度，并拥有独特的设计。使用全新外观的 ROG CPU-Z 来确实地回报 CPU 相关信息与展现您的独特性。

如欲开启 ROG CPU-Z，请用鼠标左键双击点击桌面上的 图标。





第五章

5.1 RAID 功能设置

本主板内置 Intel® 芯片组，可以让您通过 Intel® Rapid Storage 技术来设置 RAID 0、1、5 与 RAID 10 磁盘阵列。

> 若您想要使用设置有 RAID 磁盘阵列的硬盘来启动系统，请在安装操作系统到选定的硬盘之前，先将应用程序 DVD 光盘内的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。请参考 5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘 一节的说明。

5.1.1 RAID 定义

RAID 0 的主要功能为「Data striping」，即区块延展。其运行模式是将磁盘阵列系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘，而数据存取方式是平均分散至多颗硬盘，是以并行的方式读取/写入数据至多颗硬盘，如此可增加存取的速度，若以二颗硬盘所建构的 RAID 0 磁盘阵列为例，传输速度约为阵列中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言，RAID 0 模式的磁盘阵列可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为「Data Mirroring」，即数据映射。其运行模式是将磁盘阵列系统所使用的硬盘，创建为一组映射对应（Mirrored Pair），并以平行的方式读取/写入数据至多颗硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的，在读取数据时，则可由本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘阵列最主要就是其容错功能（fault tolerance），它能在磁盘阵列中任何一颗硬盘发生故障的情况时，其它硬盘仍可以继续动作，保持系统不中断运行。即使阵列中某一颗硬盘损毁时，所有的数据仍会完整地保留在磁盘阵列的其它硬盘中。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展，分别记录到三部或以上的硬盘中。而 RAID 5 阵列设置的优点，包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力，与更大的保存容量。RAID 5 阵列模式最适合的使用范畴，可用于交叉处理操作、数据库应用、企业资源的规划，与商业系统的应用。这类型的阵列模式，最少需要三部硬盘方可进行设置。

RAID 10 的主要功能为「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 与 RAID 1 之所长，不但可运用到 RAID 0 模式所提供的高速传输速率，也保有了 RAID 1 模式的数据容错功能，让您不但享有高速的数据传输功能，对于数据的保存也无后顾之忧。

5.1.2 安装 Serial ATA（SATA）硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现，当您要创建阵列模式设置时，请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘阵列。

1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
2. 安装硬盘连接排线，将欲建构磁盘阵列的硬盘连接至主板。
3. 将 SATA 电源线连接到每一部硬盘。

5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID

在您开始创建阵列之前，您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作：

1. 在启动之后系统仍在内存的启动自我测试（Power-On Self Test，POST）时，按下 <Delete> 按键进入 BIOS 设置程序。
2. 进入主菜单（Main）后，选择 Advanced > SATA Configuration 选项，然后按 <Enter> 键。
3. 将 SATA Mode 选项设置为 [RAID Mode]。
4. 保存您的设置值并退出 BIOS 程序。

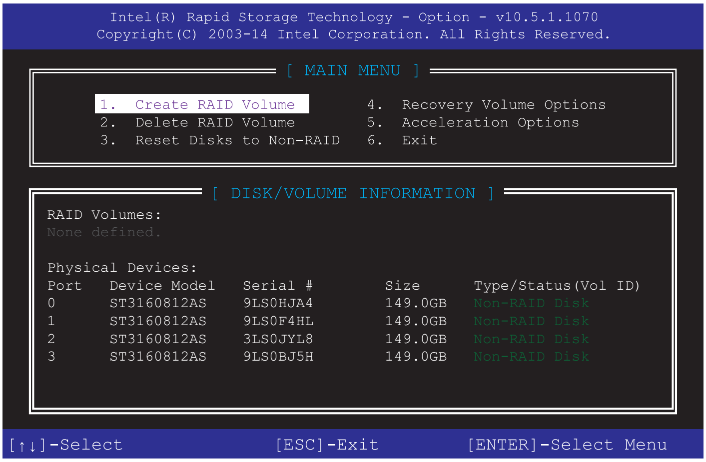
关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入，请参考第三章的相关说明。

由于芯片的限制，当您设置 SATA 连接端口为 RAID 时，所有的 SATA 连接端口均会以 RAID 模式运行。

5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照下列步骤来进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序：

1. 启动您的电脑。
2. 当系统运行开机自检（POST）时，按下 <Ctrl> + <I> 键来进入应用程序主菜单。



在屏幕下方的导览键可让您移动光棒到不同的选项并选择菜单中的选项。

本节中的 RAID BIOS 设置画面仅供参考，所显示的画面与实际设置画面可能稍有不同。

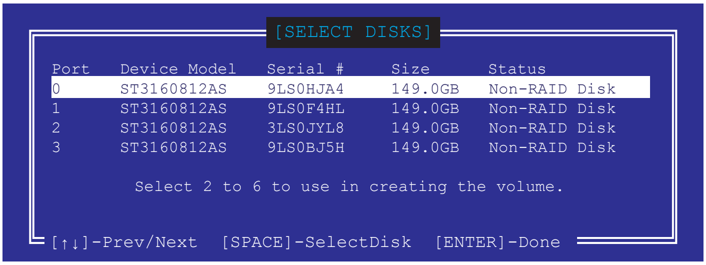
本应用程序可以支持四个硬盘进行 RAID 设置。

创建 RAID 设置

请依照下列步骤创建 RAID 设置：

1. 选择 1. Create RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的画面。

2. 为您的 RAID 磁区键入一个名称，然后按下 <Enter> 按键。
3. 使用向上、向下方向键来选择您想要的 RAID 层级，然后按下 <Enter> 按键。
4. 当 Disk 选项出现，请按下 <Enter> 按键以便选择要进行阵列设置的硬盘设备。接着显示如下图所示的画面。



5. 请使用向上、向下方向键来选择硬盘设备，确认后请按下 <Space> 按键来进行选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当要进行阵列设置的硬盘设备选择完毕后，请按下 <Enter> 按键。
6. 使用向上、向下方向键来选择 RAID 磁盘阵列（RAID 0、RAID 10、RAID 5）要分区的容量，然后按下 <Enter> 按键。分区的数值可由 4KB 递增至 128KB，数据分区的数值应该以硬盘使用的目的来决定。下列为推荐：

   RAID 0: 128KB

   RAID 10: 64KB

   RAID 5: 64KB

> 若此系统欲作为服务器使用，建议您选择较低的磁区大小；若此系统欲作为多媒体电脑用来运行影音的编辑制作，建议您选择较高的磁区大小来获得最佳的性能。

7. 输入您所要的阵列容量，接着按下 <Enter> 按键。本项目默认值是采用最高可容许的磁盘容量。
8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下 <Enter> 按键来创建磁盘阵列，接着便会出现如下图的提示信息画面。

```
WARNING:  ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N)
```

9. 按下 <Y> 键创建阵列并回到主菜单，或是按下 <N> 键回到 CREATE VOLUME MENU（创建阵列标签）菜单。

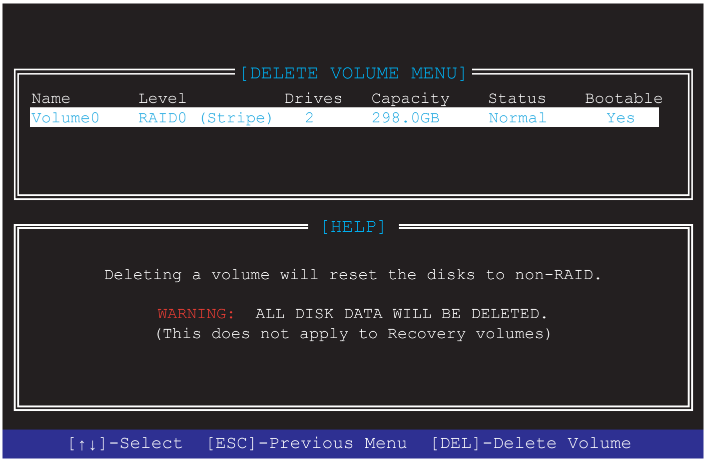
第五章

删除 RAID 阵列

当您要删除 RAID 设置时请小心，保存在硬盘中的数据会被全部删除。

请依照以下步骤删除 RAID 阵列：

1. 选择 2. Delete RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的窗口画面。



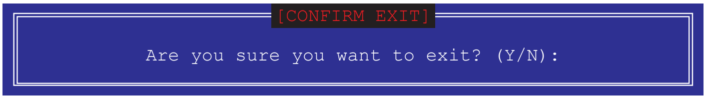
2. 使用向上、向下方向键来选择您想要删除的 RAID 设置，然后按下 <Del> 按键。接着显示如下图所示的画面。

3. 按下 <Y> 键删除 RAID 并回到主菜单，或是按 <N> 键回到 DELETE VOLUME MENU（创建阵列标签）菜单。

离开 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照以下步骤离开应用程序：

1. 选择 5. Exit 然后按下 <Enter> 按键，显示如下图所示的画面。



2. 按下 <Y> 按键来离开应用程序，或是按下 <N> 回到主菜单。

5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘

当您欲在拥有 RAID 设置的硬盘中安装 Windows® 操作系统时，您需要准备一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘。

本主板没有软驱插槽，请使用 USB 软驱来创建 SATA RAID 驱动程序的软盘。

5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在不进入操作系统状态下创建 RAID/SATA 驱动程序软盘：

1. 开启您电脑的电源。
2. 当进行 POST 启动自我检测时按下 <Del> 键进入 BIOS 程序设置。
3. 将光驱设置为主要启动设备。
4. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
5. 保存更改并退出 BIOS 程序设置。
6. 当菜单出现时，点击 制作驱动程序软盘 标签页，按下 <1> 来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
7. 将已格式化的软盘放入 USB 软驱中，并按下 <Enter> 键。
8. 依照屏幕的指示完成驱动程序软盘的创建。

5.2.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘：

1. 启动 Windows 操作系统。
2. 连接 USB 软驱并将软盘放入软驱中。
3. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
4. 点击 制作驱动程序软盘 标签页，接着点击 Intel AHCI/RAID Driver Disk 选项来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
5. 选择 USB 软驱。
6. 依照屏幕指示完成驱动程序软盘的创建。

请将驱动程序软盘切换为防止写入以避免遭受电脑病毒的感染。

5.2.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序

请依照下列步骤在 Windows® 7 或更新的操作系统中安装 RAID 驱动程序：

1. 当安装操作系统时，选择 Load Driver。
2. 将搭载有 RAID 驱动程序的软盘/U 盘安装软驱/USB 连接端口，并点击 Browse。
3. 请选择您的设备后，选择 Drivers > RAID，并选择 RAID 驱动程序文件再按 OK。
4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。

在从 U 盘载入 RAID 驱动程序之前，您必须使用另一台电脑来将应用程序光盘中的 RAID 驱动程序复制到 U 盘。

要在 RAID 模式下设置 Windows® UEFI 操作系统，请先为光驱载入 UEFI 驱动程序。

华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号
电话：+86-21-54421616
传真：+86-21-54420088
互联网：http://www.asus.com.cn/

技术支持

电话：400-620-6655
电子邮件：http://vip.asus.com/VIP2/Services/TechQuery?lang=zh-cn
在线支持：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号
电话：+886-2-2894-3447
传真：+886-2-2890-7798
电子邮件：info@asus.com.tw
互联网：http://www.asus.com

技术支持

电话：+86-21-38429911
传真：+86-21-58668722, ext. 9101#
在线支持：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
传真：+1-510-608-4555
互联网：http://usa.asus.com

技术支持

电话：+1-812-282-2787
传真：+1-812-284-0883
在线支持：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
传真：+49-2102-959931
互联网：http://asus.com/de
在线联络：http://eu-rma.asus.com/sales（仅回答市场相关事务的问题）

技术支持

电话：+49-2102-5789555
传真：+49-2102-959911
在线支持：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

附件二

報驗義務人代碼 Code of the applicant	編號 Number
D33005	

符合性聲明書
Declaration of Conformity

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人：華碩電腦股份有限公司
Obligatory Applicant

地址：台北市北投區立德路 150 號 4 樓
Address

電話：02-2894-3447
Telephone

商品中（英）文名稱：主機板 (Motherboard)
Commodity Name

商品型式（或型號）：MAXIMUS VII IMPACT
Commodity Type （Model）

符合之檢驗標準及版次：CNS 13438 : 95 年完整版 (乙類) (Class B)
Standard(s) and version

試驗報告編號：1470169R-ITTWP01V00
Test Report Number

試驗室名稱及代號：快特電波股份有限公司(SL2-IN-E-0043)
Testing laboratory name and designation number

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：
The form of the DoC marking appears like this

D33005

或
or

D33005

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明書所聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

華碩電腦股份有限公司 施崇棠 驗證登錄申請專用

報驗義務人：________________（簽章）
Obligatory Applicant （Signature）

中 華 民 國 一百零三 年 七 月 十四 日
DATE （year） （month） （day）

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : MAXIMUS VII IMPACT

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :

Date : **July. 31, 2014**

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Motherboard**
Model name :	**MAXIMUS VII IMPACT**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☐**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☐**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature :

Declaration Date: 31/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014